



股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司

一〇八年度年報

刊印日期：中華民國一〇九年四月十日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：蔡榮宗
職 稱：業務行銷中心副總經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：armstro@holtek.com.tw

二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：廖明通
職 稱：財務會計處經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：eliao@holtek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹市科學工業園區研新二路 3 號
電 話：(03)563-1999
分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座
Block A, 3/F Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Rd.
Kowloon, Hong Kong
電 話：852-2745-8288
台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2
電 話：(02)2655-7070
大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司
中國東莞松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢
電 話：86-769-2626-1300

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網 址：www.sinotrade.com.tw
電 話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：游萬淵會計師、曾漢鈺會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓）
網 址：www.kpmg.com.tw
電 話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

七、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一〇八年度年報

目 錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司簡介	
一、設立日期-----	3
二、公司沿革-----	3
參、公司治理報告	
一、組織系統-----	5
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -----	8
三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金-----	11
四、公司治理運作情形-----	17
五、會計師公費資訊-----	37
六、更換會計師資訊-----	37
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形 -----	37
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	38
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊-----	39
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	40
肆、募資情形	
一、資本及股份-----	41
二、公司債-----	45
三、特別股-----	45
四、海外存託憑證-----	45
五、員工認股權憑證-----	45
六、限制員工權利新股-----	45
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	45
八、資金運用計畫執行情形-----	45

伍、營運概況

一、業務內容-----	46
二、市場及產銷概況-----	55
三、從業員工-----	61
四、環保支出資訊-----	61
五、勞資關係-----	61
六、重要契約-----	63

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	64
二、最近五年度財務分析-----	68
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-----	70
四、最近年度財務報告-----	70
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	70
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	70

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	72
二、財務績效-----	73
三、現金流量-----	74
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	74
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	74
六、風險事項分析-----	75
七、其他重要事項-----	77

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	78
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	83
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形-----	83
四、其他必要補充說明事項-----	83
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	83

附錄

附錄一：108 年度合併財務報告及會計師查核報告-----	84
附錄二：108 年度個體財務報告及會計師查核報告-----	144

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

盛群半導體股份有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年面臨中美貿易摩擦、全球經濟成長放緩，加上生產成本提升及終端售價隨市場競爭愈趨降低，同時在中國半導體產業持續高度競爭下，致本公司於 2019 年之營收與獲利未能達成預期目標，顯示公司對市場變動掌握的程度稍嫌不足，內部會針對做不好之處積極檢討與改善。

2019 年本公司全年營收為新台幣（以下同）45.84 億元；較 2018 年的 48.63 億元減少 6%，毛利率維持 49% 以上的水準，歸屬母公司稅後淨利達 9.15 億元，較前一年度 10.64 億元減少 14%，每股稅後盈餘達 4.05 元。2019 年度本公司 MCU IC 營收雖下滑 5% 至 35.10 億元，重點產品之一的觸控應用 MCU 年度出貨數量超過 1.5 億顆，出貨成長 12%；另外，32 位元 MCU 達到年銷約 2,200 萬顆，年成長 33%；加上健康量測／安防／直流無刷馬達 BLDC／影像 AFE 等產品均維持穩定增長，顯示本公司主力專注的產品領域在產品開發、銷售通路、產品品質與技術服務等各方面仍然獲得全球客戶與市場的高度肯定。

以下就 2019 年本公司整體營運概況，分別從產品開發／業務／生產等方面做摘要說明：
產品開發方面：

2019 年本公司產品開發重點主要涵蓋在穿戴產品、無線通訊、健康量測、智能家居及安全防护等應用產品，總計推出了 11 類 99 項產品，包括有 AI 影像／神經網路處理器；車規耐溫到 125°C 的 CAN Bus Controller 以及 CAN Bus MCU；太陽能供電超低功耗的銀行智慧卡及液晶顯示動態密碼的銀行金融卡；安全防护類獨家推出新一代無線煙霧探測報警器 MCU；觸控與近接感應類推出全世界最低功耗之雙按鍵觸控 MCU；健康與量測類推出 8／32 位元 MCU 內核的多款產品；馬達控制類推出以 Arm 系列 M0+ 為內核之 BLDC（直流無刷）MCU、數字舵機 MCU 及馬達用 H-Bridge 驅動器 IC；電源管理類推出單／多節鋰電池 MCU、低功耗無線充電器 MCU、無線通訊 Sub-1 GHz 及 BLE Beacon（藍牙廣播）發射 IC 無線產品；數位傳感器其包括：氣壓、溫／濕度、PIR、煙霧及燃氣探測等及雷射 PM2.5 模塊等產品；無線通訊類及 NB-IoT 通訊類等產品；上述新推出的產品將對盛群 2020 年的營運增添動能。

業務方面：

回顧 2019 年，不論是臺灣／中國大陸及海外地區的銷售均受到中美貿易及部分地區個別經濟景氣波動的影響。臺灣地區因相關產業局限，營收占比持續降低至 10%；海外地區因歐洲經濟遲緩及中南美洲與日本／印度等地區業務些微衰退，整體占比營收仍維持在 14%；大陸地區營收占比高達 76%，主因中國大陸仍為全球消費性電子產品生產製造最大的區域，但本公司在該地區的安全防盜／健康量測／直流無刷馬達／電動自行車充電器／智能門鎖及 TWS 無線藍牙耳機等產品銷售表現依舊亮眼，因此在中國銷售布局與到位的技術服務，仍然是重大關鍵。

生產方面：

2019 年晶圓廠及封裝測試等產能均屬於嚴重短缺的情況，公司與上下游廠商建立長期穩定的關係下，並輔助配合內部所提供的測試與燒錄服務，勉強維持生產交期的穩定，可以說是非常不容易。

2020 年主要營運重點：

展望 2020 年，全球經濟有望復甦、中美貿易戰也將在 2020 年初有轉圜的跡象，對半導體產業發展而言，將會是一個局勢轉折關鍵的一年；但仍將會面對更多大陸本土 IC 設計公司的競爭以及大陸 GDP 有可能持續下滑致消費力道減弱的影響。本公司在 2020 年度經營團隊加快推出計畫中的相關產品以及讓各類數位感測模塊產品導入，同時針對不同應用領域成立後段應用方案公司，並成立各類演算法專責部門，並持續提升產品品質讓公司的產品等級再上一級以增加公司產品的競爭力。

產品開發方面，主要重點包括 32 位元 LCD MCU 與 5V USB M0+ MCU 等／高資源低腳位 8 位元 MCU／健康量測／RF 無線通訊方面，有 2.4GHz、BLE beacon、NFC 等／BLDC 馬達控制有 8／32 位元 MCU／安全防護方面，則著重在感煙、感煙驅動、新國標、感煙聯網等 MCU／圖像辨識／電動車與電動工具充電器／智能玩具與應用感測模塊等，以強化本公司因應不同領域的客戶需求，成為提供一條龍完整方案之供應商角色。

業務方面，2020 年在中國大陸地區因應本土業者的強勢競爭，本公司強化通路體系的技術支持能力與方案開發的能力，以降低客戶開發新產品的進入障礙及人力短缺的問題；另一方面，持續擴大印度在地化銷售推廣與技術服務，並開拓新興發展中國家的新市場與新客戶，積極維護歐美日韓等重點客戶，並提供及時且在地化的產品技術服務，更能明確的反應市場需求。同時建立跨境電子商務網站銷售 MCU 與推廣模組，除增加網路無遠弗屆之銷售點，增加客戶源，並依不同的產品規格需求，提供客戶訂製模組的技術服務，提升 2020 年之市場市佔率，增加營收動能。

生產方面，與長期往來之上下游廠商密切配合，取得廠商合理價格及充足產能的支持，藉由內部管理機制作為生產成本之最佳化的安排，並以滿足客戶訂單需求為優先考量。配合 MCU 應用於車規與家電安全，繼續提升產品品質，並執行各項產品品質認證。另外，2020 年晶圓代工產能仍然屬於供給生態緊俏的局面，對於少量多樣產品的生產廠商而言，將是一大挑戰，該如何能正確地預估客戶需求，將會是產銷單位今年的工作重點。

面對 2020 年本公司隨時因應 MCU 發展趨勢調整執行策略，積極尋找可合作之各類應用領域的專業方案公司，創造更多客戶 Design-in／win 的機會，全體員工各司其職完成在業務推廣／產品開發／生產交貨／品質控管等工作，再加上晶圓代工廠強而有力之緊密合作，配合產品／通路／客戶／市場等天時地利與人和等有利條件，經營團隊將持續以深耕 MCU 領域之策略，秉持研發創新的理念，創造穩定成長的實質獲利回饋給所有股東。

祝福全體股東 健康如意、平安喜樂、財源廣進！

董事長 吳啟勇



總經理 高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

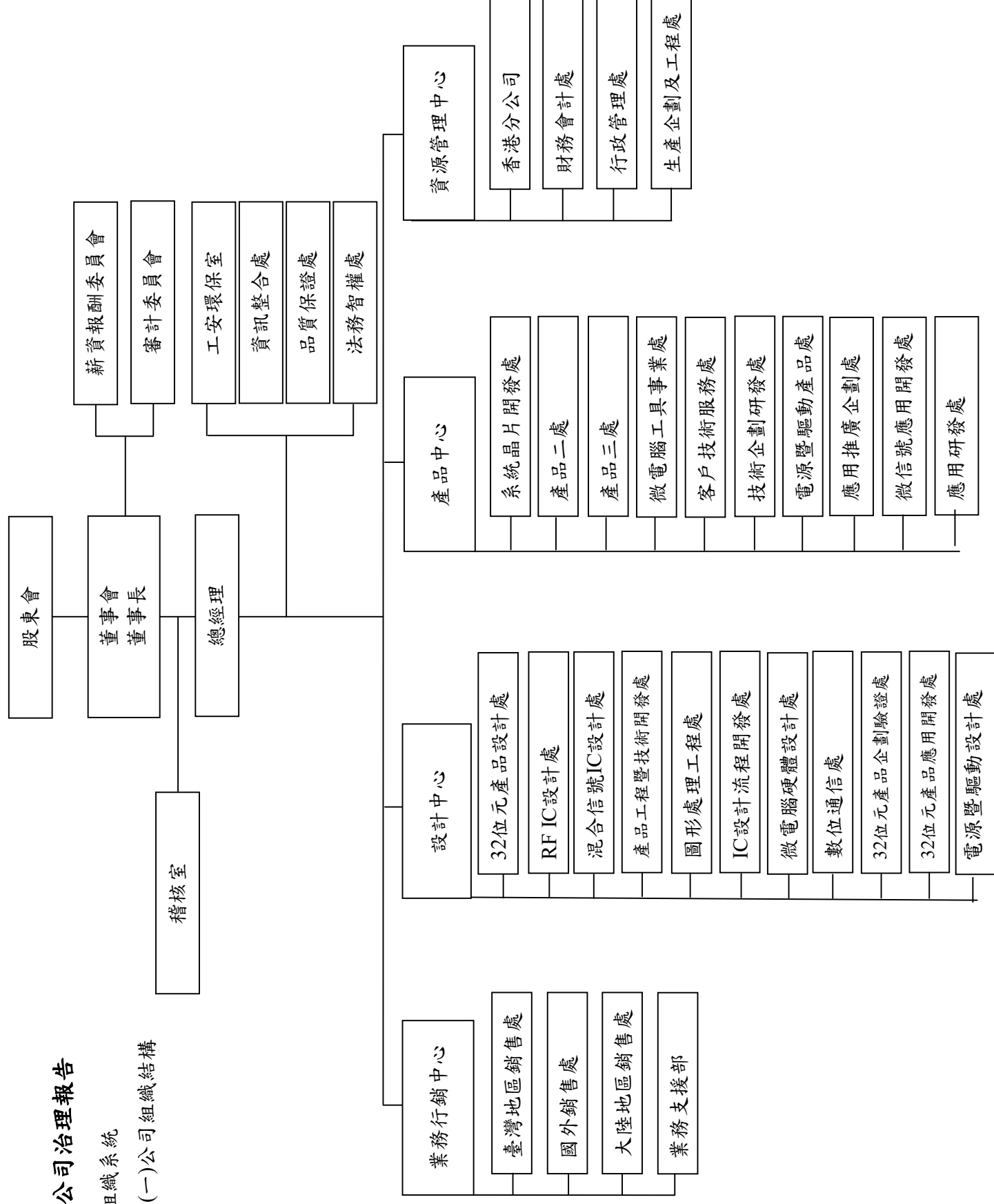
民國八十七年	十月	盛群半導體公司於新竹科學園區成立，設立實收資本額新台幣四億元。
民國八十八年	三月	現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。
民國八十九年	三月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit OTP MCU。
	四月	設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。
	五月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。
		通過國際 ISO 9001 品保認證。
民國九十年	三月	設立上海子公司（盛揚半導體(上海)有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	五月	設立美國子公司（Holtek Semiconductor (USA), Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國九十一年	八月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。
	十月	投資蘇州子公司（金科集成電路(蘇州)有限公司），負責大陸地區生產及出貨服務。
	十一月	股票正式櫃檯買賣。
民國九十二年	七月	通過國際 ISO 14001 環境管理系統驗證。
	八月	取得 SONY "Green Partner" 認證。
	九月	獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。
民國九十三年	九月	股票正式上市買賣。
	十二月	GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。
民國九十四年	六月	取得華碩 "Green Partner" 認證。
	九月	取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。
	十月	取得三星電子 "ECO Partner" 認證。
	十一月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於臺灣地區舉行。
	十二月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
民國九十五年	五月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於大陸地區舉行。
	十一月	通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。
民國九十六年	一月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit Flash MCU。
	五月	通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。
	十二月	Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。
民國九十七年	二月	投資廈門子公司（芯群集成電路(廈門)有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。
民國九十九年	一月	推出公司第一顆整合型 8-bit Touch Flash MCU。
民國一〇〇年	五月	盛揚半導體(上海)有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體(深圳)有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。
	六月	推出公司第一顆 Arm® Cortex™-M3 32-bit Flash MCU。
	七月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十月	推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 18 名。
民國一〇一年	六月	盛揚半導體(深圳)有限公司營運據點遷移，並於東莞松山湖設立子公司

		(合泰半導體(中國)有限公司)，從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國一〇二年	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 14 名。 101 年度新推出產品： (1) Smoke Detector ASSP Flash MCU。(2) Power Bank ASSP Flash MCU。
	九月	合泰半導體(中國)有限公司北京辦事處成立，負責大陸華北地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司杭州辦事處成立，負責大陸華東及華中地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司順德辦事處成立，負責大陸順德地區之銷售及技術服務。
	十一月	通過 WPC 聯盟 Qi 標準。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。 102 年度新推出產品： (1) 20-bit A/D + LCD Flash MCU。(2) Blood Pressure Meter ASSP Flash MCU。(3) Glucose Meter ASSP Flash MCU。
民國一〇三年	七月	推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。 全球第五家擁有 UL 60730-1(家庭用電器用品安全機制)軟體認證的半導體公司。 取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十一月	無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。
	十二月	103 年度新推出產品： (1) 1.8V~5.5V Flash MCU。(2) 24-bit A/D LCD Flash MCU。(3) Wireless Power Transmitter (Qi) ASSP Flash MCU。(4) Body Fat ASSP Flash MCU。
民國一〇四年	三月	獲選第三屆中堅企業潛力企業。
	九月	移動電源微控制器 IC 取得 UL QC2.0 規格認證。
	十二月	盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽邁入第十屆擴大舉辦。 104 年度新推出產品： (1)全球最薄 1mm，擁有超高解析度且唯一量產的光電混合式指紋辨識感測器。(2) Arm® Cortex™-M0+ 之 32 位元 Flash MCU。(3) Fast Charge Power Bank MCU。
民國一〇五年	二月	盛群宣佈與 Sony Mobile 簽署合作意向書。 105 年度新推出產品： (1) 96MHz 高效能 Arm® Cortex™-M3 32 位元 Flash MCU。(2) BLE 透傳模組。(3) Sub-1GHz Tx/Rx SoC & IC。
民國一〇六年	四月	榮獲第三屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。
	七月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 9 名。 106 年度新推出產品： (1) 一系列 Arm® Cortex®-M3 MCU、M0+ 5V MCU 及 Bridge MCU。 (2) A/D NFC™ MCU、Sub-1 GHz 超再生 Rx SoC MCU 及長距離 LoRa®等產品。(3) USB Type-C PD ASSP MCU 及 15W 無線充電 Tx ASSP MCU。
民國一〇七年	十二月	盛群榮獲 GSA 頒發之 107 年最佳財務管理半導體公司獎。
民國一〇八年	四月	榮獲第五屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
資訊整合處	資訊系統開發架構、資安管理規劃、網路/硬體設施管理。
品質保證處	進出貨檢驗，外包廠品質監控與評鑑，品質活動推行，儀器校正作業，產品可靠度測試及客訴服務。
法務智權處	法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。
臺灣地區銷售處	臺灣地區產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	海外地區技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。
32 位元產品設計處	32 位元微處理器之相關 IC/IP 設計開發與整合。
RF IC 設計處	無線射頻接收機系統設計、整合和研發。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP、Memory IC/IP、Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (B)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch-up Cell 標準化。
產品工程暨技術開發處	靜電防護工程與產品工程之評估、管理及驗證等。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)光罩委外製作及圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
32 位元產品企劃驗證處	32 位元微處理器產品企劃工作，制定規格並執行相關功能驗證。
32 位元產品應用開發處	提供 32-bit MCU 平台之軟韌體及應用加值服務。
電源暨驅動設計處	電源驅動 IC 之設計評估及電路設計。
系統晶片開發處	影像及音頻訊號處理之系統技術建立與 SOC 開發。
產品二處	8-bit MCU 之規劃、開發及產品推廣。
產品三處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU、MCU 週邊相關 ASIC 等 IC 產品開發技術，前瞻產品技術之搜尋，關鍵技術研究，關鍵性 IP 建立。 (B)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 的相關規格制定、設計開發、產品驗證及軟、硬體技術支援。
微電腦工具事業處	專案技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。

部 門	主要職掌
客戶技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場與技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及後續產品推廣技術服務等事項。 (B)前瞻產品技術之搜尋、關鍵技術研究、關鍵性 IP 建立與提升產品層次及競爭力。
電源暨驅動產品處	電源驅動 IC 之市場企劃、設計開發及新產品推廣。
應用推廣企劃處	(A)網站美術設計及運作維護。 (B)推廣文件、影片美術設計。 (C)技術文件編譯及翻譯。 (D)產學合作。
微信號應用開發處	傳感器產品應用開發、特定產品專用 ASSP MCU 產品開發、IP 建立。
應用研發處	新產品應用技術前置研發與執行、建立解決方案等。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
財務會計處	財會與稅務管理、轉投資管理、資金管理、客戶信用管理、進出口保稅管理、股務及投資人關係等。
行政管理處	人力資源管理、採購總務管理。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜；產銷協調，訂單交期及訂單監控，配貨出貨及貨源調配安排。

二、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

日期：109 年 3 月 29 日 單位：股

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別	選就任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名
董事長	中華民國	吳啟勇	男	1080529	3年	870907	7,665,809	3.39%	7,665,809	3.39%	2,745,598	12.1%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司董事長	盛群公司董事長 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、BestComm RF Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之 法人董事代表、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、芯 通科技、優方科技、倍創科技等公司之董事長、超豐電子(股)公司獨立董 事	-	-
董事	中華民國	高國棟	男	1080529	3年	870907	6,701,176	2.96%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子科 盛群公司總經理	盛群公司總經理 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Holtek Semiconductor(India) Private Limited、合 泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠捷電子 (東莞)、芯動微電子(杭州)(名稱暫定)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、 欣宏電子等公司之法人董事代表、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨 總經理	-	-
董事	中華民國	張治	男	1080529	3年	930601	1,111,785	0.49%	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所 盛群公司設計及產品中 心執行副總經理	盛群公司設計及產品中心執行副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事 代表	-	-
董事	中華民國	林正鋒	男	1080529	3年	870907	1,842,697	0.81%	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總 經理	盛群公司總經理室副總經理 Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Best Health Electronics Corporation、Best Power Electronics Corporation等公司之法人董事代表	-	-
董事	中華民國	蔡崇宗	男	1080529	3年	1080529	322,684	0.14%	322,684	0.14%	241,580	0.11%	-	-	逢甲大學自動控制系 盛群公司業務行銷中心 副總經理	盛群公司業務行銷中心副總經理 Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Sanitek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、 新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、新鼎電子香港、 New Wave Electronics Holding Ltd.、Tunetek Technology Ltd.、信霖電子商 貿(上海)、信霖電子香港、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青 島)、Forde Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科 技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quanting Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金豪高科、 倍創科技、欣宏電子、鉅威科技等公司之法人董事代表、合泰半導體(中 國)有限公司法人董事代表暨總經理、Holtek Semiconductor (India) Private Limited)法人董事代表暨總經理	-	-
董事	中華民國	王仁宗	男	1080529	3年	930601	2,137,209	0.94%	2,137,209	0.94%	1,500,000	0.66%	-	-	清華大學科管所	定曜科技(股)公司法人董事代表	-	-
獨立 董事	中華民國	呂正樂	男	1080529	3年	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元禎企業(股)公司獨立董事	-	-
獨立 董事	中華民國	邢智田	男	1080529	3年	930601	36,000	0.02%	36,000	0.02%	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機 博士 廣達電腦(股)公司資深 副總暨廣達研究院院長	波若威科技(股)公司獨立董事、和詮科技(股)公司獨立董事	-	-
獨立 董事	中華民國	郭泰豪	男	1080529	3年	1050527	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學電機工程學系教授 南茂科技(股)公司獨立董事	成功大學電機工程學系教授 南茂科技(股)公司獨立董事	-	-

(二)董事所具專業知識及獨立性情形

條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）												兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他與 公司業務所需 之國家考試及 格領有證書之 專門職業及技 術人員	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所需 之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
吳啟勇			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
高國棟			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
張 治			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
林正鋒			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
蔡榮宗			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
王仁宗			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
郭泰豪	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：109 年 3 月 29 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
總經理	中華民國	高國棟	男	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子科	Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Signos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Holtek Semiconductor (India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、芯動微電子(杭州)(名稱暫定)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、欣宏電子等公司之法人董事代表、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理	-	-	-
設計及產品中心執行副總經理	中華民國	張 治	男	87/12/11	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所	金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表	-	-	-
總經理室副總經理	中華民國	林正鋒	男	87/12/11	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系	Signos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Best Health Electronics Corporation、Best Power Electronics Corporation等公司之法人董事代表	-	-	-
業務行銷中心副總經理	中華民國	蔡榮宗	男	99/06/15	322,684	0.14%	241,580	0.11%	-	-	逢甲大學自動控制系	Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Sartek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、新鼎電子香港、New Wave Electronics Holding Ltd.、Trustek Technology Ltd.、信霖電子商貿(上海)、信霖電子香港、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、Forti Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quandeng Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金壽高科、倍創科技、欣宏電子、銘威科技等公司之法人董事代表、合泰半導體(中國)有限公司法人董事代表暨總經理、Holtek Semiconductor (India) Private Limited法人董事代表暨總經理	-	-	-
品質保證處協理	中華民國	吳紹蒿	男	92/06/23	103,845	0.05%	10,080	0.00%	-	-	東海大學物理系	無	-	-	-
設計中心協理	中華民國	吳德傳	男	94/04/15	1,242,317	0.55%	-	-	-	-	成功大學電子研究所	無	-	-	-
設計中心協理	中華民國	余國成	男	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	-	逢甲大學電子系	無	-	-	-
產品中心協理	中華民國	王鈺鈺	男	98/07/01	393	0.00%	-	-	-	-	成功大學電機所	無	-	-	-
產品中心協理	中華民國	王明坤	男	100/04/01	175,349	0.08%	-	-	-	-	臺灣技術學院電子系	BestCommRF Electronics Inc.、芯通科技、芯通電子科技(東莞)、滾達科技、Bestway Electronics Inc.、新緯科技(深圳)、Fine Chip Electronics Inc.、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、安穩普電 Inc.、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、安穩普電子科技(東莞)、JXY Electronics Corporation、深圳市集芯源電子、Best Health Electronics Corporation、悠健電子(東莞)、悠健電子香港、Best Power Electronics Corporation、Best Solution Electronic Inc.、優方科技、優方科技(東莞)、Best Driver-tech Corporation等公司之法人董事代表	-	-	-
產品中心協理	中華民國	劉源河	男	106/01/01	50,422	0.02%	10,000	0.00%	-	-	臺北工業專科學院電子科	無	-	-	-
產品中心協理	中華民國	潘建州	男	108/05/20	109,000	0.05%	8,000	0.00%	-	-	臺灣工業技術學院電機系	無	-	-	-
會計主管	中華民國	廖明通	男	107/06/01	14,000	0.01%	-	-	-	-	中興大學會計系	金科集成電路(蘇州)、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、安穩普電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、新禾(廈門)電子、諾華達電子(深圳)、信霖電子商貿(上海)、振揚電子(青島)、華榮匯電子科技(北京)、全鼎電子(蘇州)、健芳電子科技(上海)、深圳市集芯源電子、優方科技(東莞)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技等公司之法人監察人代表	-	-	-
財務主管				108/02/01									-	-	-

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

日期：108 年 12 月 31 日															單位：新台幣仟元		
職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (註 10)		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註 11)			
		報酬(A) (註 2)	退職退休金 (B)	董事酬勞(C) (註 3)	業務執行費用 (D)(註 4)	薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)(註 6)							
						本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
董事	吳啟勇																
董事	高國棟																
董事	張 治																
董事	林正鋒	0	0	0	9,019	0	0	13,000	0	0	6,650	0	3.13%	3.13%	無		
董事	蔡榮宗																
董事	王仁宗																
獨立董事	呂正樂																
獨立董事	邢智田	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無		
獨立董事	郭泰豪																
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：																	
(1)獨立董事之酬勞，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業通常水準議定之。																	
(2)本公司依據「董事會績效評估辦法」，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。																	
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)獨立董事之酬勞，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業通常水準議定之。

(2)本公司依據「董事會績效評估辦法」，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I	
低於 1,000,000 元	—	—	—	—	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、蔡榮宗、王仁宗 呂正樂、邢智田、郭泰豪	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、蔡榮宗、王仁宗 呂正樂、邢智田、郭泰豪	王仁宗、呂正樂、邢智田 郭泰豪	王仁宗、呂正樂、邢智田 郭泰豪	
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—	
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、蔡榮宗	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、蔡榮宗	
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
100,000,000 元以上	—	—	—	—	
總計	9	9	9	9	

註1：董事姓名應分別列示，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、宿舍、配車等實物提供等等)。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、宿舍、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(二)總經理及副總經理之酬金

日期：108 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註 8)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金(註 9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所有 公司(註 5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	
董事長 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理	吳啟勇	11,235	11,235	0	0	3,220	3,220	6,953	0	6,953	0	2.34%	2.34%	無
	高國棟													
	張 治													
	林正鋒													
	李佩縈(註)													
	蔡榮宗													

註：李佩縈副總經理於 108 年 3 月 29 日因個人規劃辦理退休。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	李佩縈	李佩縈
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	吳啟勇、高國棟、林正鋒 張 治、蔡榮宗	吳啟勇、高國棟、林正鋒 張 治、蔡榮宗
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	6	6

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：108 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長	吳啟勇	0	15,152	15,152	1.66%
	總經理	高國棟				
	設計及產品中心執行副總經理	張治				
	總經理室副總經理	林正鋒				
	資源管理中心副總經理(註3)	李佩縈				
	業務行銷中心副總經理	蔡榮宗				
	品質保證處協理	吳紹菡				
	設計中心協理	吳德傳				
	設計中心協理	余國成				
	產品中心協理	王鈺鈿				
	產品中心協理	王明坤				
	產品中心協理	劉源河				
	產品中心協理(註4)	潘建州				
	會計/財務主管	廖明通				

註1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註2：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註3：李佩縈副總經理於108年3月29日因個人規劃辦理退休。

註4：潘建州協理於108年5月20日原職處長升任本公司協理。

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	支付酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	
	107 年	108 年
董事	3.45%	3.46%
總經理及副總經理	2.56%	2.34%

1.董事酬金給付政策及訂定酬金之程序：

依本公司章程第二十四條規定：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度於上述金額內分配董事酬金，再提交董事會決議。

2.總經理、副總經理及經理人酬金給付政策及訂定酬金之程序

(1)本公司訂有人事薪資制度，總經理、副總經理及經理人之薪資依公司制度予以考核，參考因素主要為執行業務內容、經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著，並送交總經理室會議中予以評定。

(2)本公司章程規定年度分派員工酬勞，由人事單位依據人事薪資制度、績效評估辦法、獎懲辦法及員工守則，參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻度，判斷同仁考績分數的依據可從工作能力(包括工作量/難易度/達成率/效率及品質/知識技能)、管理及溝通能力，再加上當季特殊表現來考量，送交總經理室會議中予以評定。

(3)上述之總經理、副總經理及經理人之薪資及員工酬勞於總經理室會議中予以核定後，呈薪資報酬委員會討論通過並提交董事會決議。

3.給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事酬勞係依據在本公司擔任之職位及對公司營運參與程度與貢獻之價值核發，並參考同業通常水準議定之。

(2)總經理、副總經理及經理人之酬金，係依據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

依據本公司訂定董事會績效評估辦法，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：108 年度董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)	備 註
董 事 長	吳啟勇	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
董 事	高國棟	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
董 事	張 治	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
董 事	林正鋒	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
董 事	李佩縈	4	0	80%	舊任，任期至 108.05.29 止，應出席 5 次
董 事	蔡榮宗	3	0	100%	新任(108.05.29 改選)， 應出席 3 次
董 事	王仁宗	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
獨立董事	呂正樂	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
獨立董事	邢智田	5	3	63%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次
獨立董事	郭泰豪	8	0	100%	連任(108.05.29 改選)， 應出席 8 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 日期	議案內容	所有獨立董事意 見及後續處理
108.01.28 第七屆第 17 次	1.本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.本公司財務主管委任案。 3.MCU Holdings Ltd.增加投資 JXY Electronics Corporation 案。 4.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案暨 107 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估報告。 5.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	左列議案獨立 董事未表示反 對或保留意見，且議案均經 全體董事同意 通過。
108.03.06 第七屆第 18 次	1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司第七屆董事任期將屆，依公司章程規定擬於 108 年股東常會中辦理全面改選第八屆董事(含獨立董事)事宜。 3.討論解除董事競業禁止案。 4.本公司出具內部控制制度聲明書案。 5.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	
108.04.15 第七屆第 19 次	1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。	
108.04.29 第七屆第 20 次	1.本公司處分高聖科技股份有限公司投資案。 2.本公司「董事會議事規則」修訂案。 3.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	
108.07.29 第八屆第 2 次	1.本公司之孫公司盛通科技股份有限公司變更公司名稱案。 2.JXY Electronics Corporation 增加投資深圳市集芯源電子科技有限公司案。	

	3.MCU Holdings Ltd.增加投資 Quanding Technology Holding Ltd.案。 4.本公司之孫公司 Best Health Electronics Corporation 成立香港子公司案。 5.本公司之孫公司優方科技股份有限公司新增大陸投資案。 6.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 7.討論解除董事競業禁止案。 8.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經全體董事同意通過。
108.10.28 第八屆第3次	1.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 2.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 3.討論解除董事競業禁止案。 4.本公司 109 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 5.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 6.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：
董事會評鑑執行情形：

(一) 評估週期：每年執行一次。

(二) 評估期間：108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。

(三) 評估範圍：董事會、薪資報酬委員會及審計委員會。

(四) 評估方式：以董事會內部自評進行績效評估。

(五) 評估內容：

1.董事會績效評估：函括下列五大面向：(1)對公司營運之參與程度。(2)提升董事會決策品質。

(3)董事會組成與結構。(4)董事的選任及持續進修。(5)內部控制。

2.薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估：函括下列五大面向：(1)對公司營運之參與程度。

(2)功能性委員會職責認知。(3)功能性委員會決策品質。(4)功能性委員會組成及成員選任。

(5)內部控制。

3.每年年度結束時收集董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之相關資訊，將問卷回收後，針對評估指標之評分制定，送交董事會報告。

4.本公司於 109 年 2 月完成董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估，經評估 108 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會整體運作良好。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司訂定「董事會議事規則」及「董事會績效評估辦法」，已於 100 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會，並於 105 年 5 月 27 日成立審計委員會，以提升董事會運作效能。

(二)審計委員會參與董事會運作情形：

本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。

審計委員會審議的事項包括：內部控制制度、稽核及會計政策與程序、涉及董事自身利害關係事項、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、公司財務報表、公司併購事項等。

108 年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備 註
獨立董事	呂正樂	7	0	100%	
獨立董事	邢智田	4	3	57%	
獨立董事	郭泰豪	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會 日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
108.01.28 第七屆第 17 次	1.本公司 107 年第 4 季稽核查核報告案。 2.本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司 107 年合併財務報告及個體財務報告案。 4.本公司財務主管委任案。 5.MCU Holdings Ltd.增加投資 JXY Electronics Corporation 案。	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經審計委員會全體委員及全體董事同意通過。
108.03.06 第七屆第 18 次	1.本公司 108 年 1 月份稽核查核報告案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司第七屆董事任期將屆，依公司章程規定擬於 108 年股東常會中辦理全面改選第八屆董事(含獨立董事)事宜。 4.討論解除董事競業禁止案。 5.本公司出具內部控制制度聲明書案。 6.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	
108.04.15 第七屆第 19 次	1.本公司 108 年 2 月份稽核查核報告案。 2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。	
108.04.29 第七屆第 20 次	1.本公司 108 年 3 月份稽核查核報告案。 2.本公司 108 年第 1 季合併財務報告案。 3.本公司處分高聖科技股份有限公司投資案。 4.本公司「董事會議事規則」修訂案。	
108.05.09 第七屆第 21 次	1.本公司 108 年 4 月份稽核查核報告案。	
108.07.29 第八屆第 2 次	1.本公司 108 年 5 月至 6 月份稽核查核報告案。 2.本公司 108 年第 2 季合併財務報告案。 3.本公司之孫公司盛通科技股份有限公司變更公司名稱案。 4.JXY Electronics Corporation 增加投資深圳市集芯源電子科技有限公司案。 5.MCU Holdings Ltd.增加投資 Quanding Technology Holding Ltd.案。 6.本公司之孫公司 Best Health Electronics Corporation 成立香港子公司案。 7.本公司之孫公司優方科技股份有限公司新增大陸投資案。 8.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 9.討論解除董事競業禁止案。	
108.10.28 第八屆第 3 次	1.本公司 108 年第 3 季稽核查核報告案。 2.本公司 108 年第 3 季合併財務報告案。 3.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 4.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 5.討論解除董事競業禁止案。 6.本公司 109 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 7.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 8.本公司 109 年營運計畫書案。	

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 1.本公司每年定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
- 2.本公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會及董事會，說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估計等，會計師針對董事所提問題進行討論及溝通。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂定「公司治理守則」，並揭露於本公司網站與公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司訂定「股東會議事規則」，並設有發言人制度、投資人關係專責人員及法務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事項，並於本公司網站揭露聯繫方式。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司掌握董事、經理人及持股百分之十以上股東之持股情形。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司訂定「對子公司之監理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，且實施必要的控管機制，建立適當的防火牆機制。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)無差異。 1.本公司董事會設置9席董事，擔負公司營運及監督之責，每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法務等，落實執行本公司訂定之「公司治理守則」所訂定董事會成員組成多元化之政策。 2.本公司所選任之董事，皆按照相關法令之規定執行職務，其中具員工身之董事占比為56%、獨立董事占比為33%、外部董事占比為11%，各董事學經歷對本公司營運有明顯之助益，符合本公司訂定董事會成員組成之多元化方針。 3.每位董事所具專業能力如下：

多元化核心項目		性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法務
董事姓名	吳啟勇	男	V	V	V		
	高國棟	男	V	V	V		V

評估項目	運作情形							與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明					
			張 治	男	V	V		
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		林正鋒	男	V	V		
			蔡榮宗	男	V	V		
			王仁宗	男	V	V	V	
			呂正樂	男	V	V	V	
			邢智田	男	V	V	V	
			郭泰豪	男	V	V	V	
			(二)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視法令規定及營運需要決定是否設置其他功能性委員會。 (三) 1.本公司董事會已於105年1月通過「董事會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會之績效評估至少包括下列五大面向：(1)對公司營運之參與程度。(2)提升董事會決策品質。(3)董事會組成與結構。(4)董事的選任及持續進修。(5)內部控制。 2.每年年度結束時收集董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之相關資訊，將問卷回收後，針對評估指標之評分制定，送交董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 3.本公司於109年2月完成董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，經評估108年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作良好。 (四) 1.本公司每年定期審酌簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具超然獨立聲明書，提報至108年3月審計委員會及董事會。 2.本公司經審計委員會及董事會評估簽證會計師無違反職業道德規範公司報第十號所規定之情形，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。					
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資	V		本公司由資源管理中心之股務單位擔任負責公司治理相關事務，主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有之最新法規發展。 108年度業務執行情形如下：					無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?		1.辦理董事會及股東會之會議相關事項。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事持續進修及遵循法令。 4.提供董事執行業務所需之資料。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√	本公司設置投資人關係專責單位，包括股東、客戶、供應商及投資人公司相關資訊及溝通管道，公司網站亦設置利害關係人專區與各專責人員連絡方式，以回應利害關係人關切之議題(請參閱本年報第24頁(註1))，且每年至少一次向董事會報告執行情形。	無差異。
六、公司是否委任專任專業股務代理機構辦理股東會事務?	√	本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	無差異。
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	√	(一)本公司設置中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露財務業務及公司治理資訊。	(一)無差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	√	(二) 1.本公司指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，定期揭露財務業務及公司治理資訊。 2.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料放置於公開資訊觀測站及本公司網站。	(二)無差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	√	(三) 1.本公司於108年1月31日申報107年度財務報告，及分別於108年5月2日申報108年第一季財務報告、108年8月1日申報108年第二季財務報告、108年10月31日申報108年第三季財務報告，皆於規定期限內提前申報。 2.本公司每月於規定期限內提前申報各月份營運情形。	(三)無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)?	√	1.員工權益、僱員關懷：本公司制定各項符合勞工法令規定，以保障員工權益，並定期召開勞資會議，進行有效溝通。本公司設有職工福利委員會定期舉辦活動，包括年節禮券、旅遊、社團活動、員工健康檢查及團體保險等。 2.投資者關係：本公司設有發言人制度及投資人關係專責人員處理股東權益之各項事務。 3.供應商關係：本公司注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。 4.利害關係人之權利：本公司網站揭露利害關係人專區，以回應利害關係人關切之議題。 5.董事進修情形：本公司每年規劃董事進修課程，加強專業知識及實務運作，請參閱本年第33頁。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定內部控制制度並有效執行，以降低各項風險，請參閱本年第75頁~第77頁。 7.公司為董事購買責任保險之情形：本公司經108年10月審計委員會及董事會通過續保董事責任保險案，108年度投保金額為美金伍佰萬元，並依規定申報於公開資訊觀測站。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司公司治理評鑑結果：第一屆、第二屆及第四屆為前20%之公司、第三屆及第五屆為前5%之公司，未來將持續配合主管機關對於公司治理評鑑之推動及改善，以強化公司治理。			

註1、傾聽利害關係人關切議題及以溝通管道回應

本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益，整合內部各組織之努力，有效地實踐企業社會責任的使命。

利害關係人	關切議題	溝通管道或形式
員工	1.員工福利 2.職涯規劃及發展 3.在職訓練	1.公司公告(不定期) 2.行政部溝通管道(不定期) 3.勞資會議(定期) 4.員工意見箱(不定期) 5.職工福利委員會(定期) 6.醫護人員(不定期)
客戶	連絡窗口：行政處主管李修銘經理 電話：(03)5631999 1.產品品質及交期 2.工程技術及應用方案能力 3.供應鏈管理 4.銷售服務及隱私	分機 1303 電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 1.客戶滿意度調查(定期) 2.高階主管客戶拜訪(不定期) 3.客戶稽核(不定期) 4.代理商業務會議(定期)
股東/投資人	連絡窗口：本公司網站設有利害關係人專區，建立業務單位各區域溝通管道、各專責人及電話、e-mail。 1.公司營運概況 2.公司財務資訊 3.公司風險管理 4.公司獲利能力及股利發放 5.公司治理及企業社會責任	1.公司年報(定期) 2.股東常會(定期) 3.每季法人說明會及不定期受邀之投資論壇 4.公司官網設置利害關係人專區(不定期)
供應商	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999 1.無衝突礦產聲明 2.綠色產品落實 3.供應商服務及隱私 4.付款能力及財務風險	分機 1612 電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.供應商會議(定期) 2.高階主管供應商拜訪(不定期) 3.供應商滿意度調查(定期) 4.供應商稽核及品質檢驗(定期) 5.供應商ISO認證(定期)
政府機構	連絡窗口：採購李修銘經理 電話：(03)5631999 1.公司重大訊息 2.法令遵循 3.公司資訊揭露 4.公司治理相關議題 5.勞資關係及兩性平等 6.稅賦繳納 7.產業升級	分機 1303 電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 1.公文(不定期) 2.法規說明會(不定期) 3.公開資訊觀測站(不定期) 4.即時與主管機關溝通(不定期) 5.會計師審計及稅務服務(不定期) 6.法律顧問服務(不定期)
社會大眾	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999 1.社會參與及產學合作 2.社會公益及慈善捐款	分機 1612 電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.產學合作(不定期) 2.提供職訓及在學學生企業實習機會 3.年度盛群盃(定期) 4.弱勢團體捐款及產品採購(不定期)
	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999	分機 1612 電子郵件：ir@holtek.com.tw

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之職責：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件
-----	--

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會由3位獨立董事組成。

(2)第四屆委員任期：108年5月29日至111年5月28日，108年度薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	邢智田	1	3	25%	
委員	呂正樂	4	0	100%	
委員	郭泰豪	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪資報酬委員會 日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
108.01.25 第三屆第14次	1.本公司108年度董事及經理人薪資報酬辦法案。 2.本公司經理人107年度第4季員工季獎金案。 3.本公司經理人107年度年終獎金案。 4.本公司經理人108年度調薪案。 5.本公司經理人108年度第1季每月績效津貼案。 6.本公司經理人108年度每月職等及職位補助案。	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。
108.04.26 第三屆第15次	1.本公司經理人108年度第2季每月績效津貼案。	
108.07.26 第四屆第1次	1.本公司經理人108年度第3季每月績效津貼案。 2.本公司107年度董事酬勞分配。 3.本公司107年度員工酬勞分配。	
108.10.25 第四屆第2次	1.本公司經理人108年度第4季每月績效津貼案。	

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策(請參閱本年第30頁(註2))。
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		本公司由資源管理中心負責推動企業社會責任之運作，並由財務部、品質保證處及工安環保室、應用推廣企劃處、生產企劃及工程處、行政管理處等單位協助，包括訂定及檢討企業社會責任政策、定期蒐集相關法令及社會環境發展議題，制定相關因應行動，且每年至少一次向董事會報告推動與執行成效。
三、環境議題			
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司已取得ISO14001認證，並設有專責單位負責及持續改善，秉持企業永續發展之經營理念。
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司致力提升各項資源之利用效率(如運送包裝再使用)，以污染防治及持續改善為發展基本架構，研發節能省碳之綠色概念產品、改善製程技術降低環境衝擊、導入綠色供應鏈，落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，維護美好地球。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)本公司為純IC設計公司，並無設置製造工廠，在半導體產業供應鏈位居上游，若因在溫室效應的影響下對各種氣候變遷所產生的天然災害、水旱災、風災與環境因子產生重大不利影響，致限水限電、供應鏈中斷、原物料成本上升等外在環境和經營的風險日益明顯，將可能對我們掌握中游貨源及下游客戶交期營運上造成影響，我們將持續關注並符合相關環境保護法規，以有效因應氣候變遷相關風險。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四)本公司為推動節能減碳，預計109年節省1%電力及水費，執行措施如下： 1.辦公室節能措施： (1)隨季節開關空調及設定恆溫於26度，以減低電費，公司同仁也做到隨手關閉電腦、空調與照明電源。 (2)辦公室之照明逐漸改為LED燈管，既能降低燈源發熱量，並達到節能目的。 2.電腦機房節能措施：推行伺服器虛擬化，節省電力及相關設備。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			3.省水措施：給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓，公共洗手間也使用感應式水龍頭，控制用水量可達35%，有效減少不必要的水資源浪費。 4.其他： (1)持續推動文件管理電子化系統，減少紙張使用量。 (2)確實執行廢棄物如廚餘、空碳粉匣、鐵鋁玻璃罐、廢紙與保特瓶等的回收管理與資源分類，並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。
四、社會議題			
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)無差異。 1.本公司支持並遵循責任商業聯盟行為準則(RBA)、聯合國世界人權宣言及聯合國全球盟約等國際公認之人權規範與原則，並以完全遵守其經營所在國家/地區的法規為基本要求。 2.本公司極為重視勞工與商業道德政策推動，透過公司內部網站之宣導，確信每位員工都應該受到公平的對待與尊重，並訂定「性騷擾事件處理辦法」，維護本公司工作場所免於性騷擾之環境，藉此保障本公司所屬員工及求職人員之權益。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二)無差異。 1.本公司章程第24條規定：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 2.本公司由人事單位依據人事薪資制度、績效評估辦法、獎懲辦法及員工守則，評估標準為工作能力(包括工作量/達成率/效率及品質/知識技能)、管理及溝通能力、未來貢獻度，並考量當季特殊表現，送交總經理室會議中予以評定。 3.本公司提供團體保險、優於勞基法之休假、定期免費健康檢查、設置員工餐廳並補助提供員工豐富餐飲服務、年終獎金、員工酬勞，與公司共享營運利潤。 4.本公司成立職工福利委員會，定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院、社團活動等皆有補助。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並	V		(三)無差異。 (三)本公司已取得ISO45001職業安全衛生管理認證，並推動各項員工安全

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
對員工定期實施安全與健康教育？			
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		衛生業務的持續改善活動及安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全，請參閱本年第63頁。 (四)本公司對人才的培育不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由專責單位設計內部訓練課程，提供挑戰及學習的環境，請參閱本年第61頁~第62頁。
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		(五)無差異。 1.本公司產品符合相關法規及國際準則，並訂定「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」、「客戶退貨處理規範」及「檢舉制度」等作業程序，確保消費者權益。 2.本公司訂定「誠信經營守則」，由法務智權處負責制定與執行公司商業機密之作業程序，落實管理與執行。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及實施情形？	V		(六)無差異。 1.本公司依據內部規章執行供應商評估及管理事項，要求供應商遵守本公司對於品質、環保與職業安全衛生的要求，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策。 2.本公司要求供應商進行自評，再依據自評結果執行對供應商稽核，並透過系統或是到廠方式，不定期對供應商實施教育訓練、溝通與宣導，使其能夠達到本公司的要求。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		無差異。 本公司依據國際通用之報告書編製準則，自發性編製企業社會責任報告書，並於本公司網站設置企業社會責任專區，定期揭露相關資訊，目前報告書尚未取得第三方驗證。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，其運作與本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，重要資訊：			定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無差異。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			
請參閱本公司網站企業社會責任專區： http://www.holtek.com.tw/web/guest/responsibility			

註2、本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	環境保護	本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠色化供應鍵管理以確保產業的競爭力，並進行內部教育訓練與宣導，使員工了解到氣候變遷的衝擊影響。
社會	供應鏈風險	因應可能因人為或天然因素導致供應商發生之緊急或意外事件，採取適當應變措施，包括對產品開發、生產、銷售、交期與服務等與客戶權益相關的衝擊： 1.平常措施：維持適當數量之安全庫存，並依各該項產品委工所在地不同分別存放於各地之倉庫或各委工配合廠之倉庫。 2.緊急狀況措施：成立緊急應變小組，進行業務影響評估後，擬定應變及服務等級之計畫，並交付相關部門執行之，直至狀況解除或生產恢復正常。
公司治理	財務風險	1.利率變動影響：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。 2.匯率變動影響：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施： (1)業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。 (2)除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。 (3)開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。
	資訊安全風險	本公司由資訊整合處負責全公司資訊安全規劃，並依據資訊安全政策以控管及維持公司營運及會計等重要運作之功能，控管作業如下： 1.端點保護：包括防毒軟體、保持作業系統與軟體的隨時更新，以有效降低漏洞與風險。 2.網路保護：包括新世代防火牆、郵件保護及防駭機制。 3.資料保護：重要資料透過備份系統，在備份完成後立即將備份資料傳送一份到異地。 4.健檢機制：透過自我檢測及委外檢測，確保公司內的伺服器安全。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	V	(一)無差異。 (二)無差異。 (三)無差異。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	V	(一)無差異。 (二)無差異。 (三)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		時，由專責人員處理。 (四)本公司已建立完整的會計制度及內部控制制度，針對具較高不誠信行為風險之營業活動，由內部稽核部門定期稽查，並向審計委員會及董事會報告稽核結果。 (五)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「同仁廉潔守則」，提供所有董事、經理人及公司同仁遵循。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V		(一)無差異。 (二)無差異。 (三)無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。			

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

請參閱本公司網站(<http://www.holtek.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事、會計主管及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
董事	高國棟	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
董事	張 治	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
董事	林正鋒	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
董事	蔡榮宗	108/08/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		108/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度防範內線交易宣導會	3
		108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
董事	王仁宗	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
獨立董事	呂正樂	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
獨立董事	邢智田	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/11/28	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看經濟實質法及全球反避稅對公司治理的影響	3
獨立董事	郭泰豪	108/03/06	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		108/08/06	社團法人中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
		108/08/06	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
會計主管	廖明通	108/11/14 ~ 108/11/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	李文德	108/04/15 ~ 108/04/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公開發行公司內部稽核人員持續進修班	12

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半



有限公司

內部控制聲明書

日期：一〇九年三月五日

本公司民國一〇八年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇八年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇九年三月五日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.108 年度股東會之重要決議

股東會重要決議	執行情形
承認事項 1.通過本公司民國 107 年度營業報告書及財務報告。 2.通過本公司民國 107 年度盈餘分派案。	1.決議通過。 2.決議通過每股配發現金股利 4.208 元，訂定 108 年 8 月 19 日為除息基準日，於 108 年 8 月 29 日發放現金股利，發放金額為 951,715,786 元。
討論及選舉事項 1.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 2.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 6.選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。 7.通過本公司董事競業禁止解除案。	1.決議通過每股配發現金 0.492 元，訂定 108 年 8 月 19 日為除息基準日，於 108 年 8 月 29 日發放現金股利，發放金額為 111,274,754 元。 2.決議通過，已向主管機關辦理公司章程修訂案，並於 108 年 6 月 10 日取得核准函。 3.決議通過，依規定申報至公開資訊觀測站。 4.決議通過，依規定申報至公開資訊觀測站。 5.決議通過，依規定申報至公開資訊觀測站。 6.第八屆董事當選名單：吳啟勇、高國棟、張 治、林正鋒、蔡榮宗、王仁宗、呂正樂(獨立董事)、邢智田(獨立董事)、郭泰豪(獨立董事)，已向主管機關辦理變更登記，並於 108 年 6 月 10 日取得核准函。 7.決議通過，業於 108 年 5 月 29 日發布重大訊息。

2.108 年度及截至年報刊印日止之董事會：

日期	重要決議
108.01.28 第七屆第 17 次	1.本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.本公司 107 年合併財務報告及個體財務報告案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司財務主管委任案。 5.本公司發言人及代理發言人派任案。 6.本公司之香港分公司總經理派任案。 7.本公司之香港分公司變更銀行帳戶簽署案。 8.MCU Holdings Ltd.增加投資 JXY Electronics Corporation 案 9.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案暨 107 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估報告。 10.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
108.03.06 第七屆第 18 次	1.本公司 107 年度營業報告書案。 2.本公司 107 年度盈餘分派案。 3.本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.本公司第七屆董事任期將屆，依公司章程規定擬於 108 年股東常會中辦理全面改選第八屆董事(含獨立董事)事宜。 6.討論解除董事競業禁止案。

日期	重要決議
	7.本公司 108 年股東常會召開日期案。 8.本公司出具內部控制制度聲明書案。 9.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性。
108.04.15 第七屆第 19 次	1.審查本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人提名案。 2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 4.本公司 108 年股東常會召集事由修訂案。
108.04.29 第七屆第 20 次	1.本公司處分高聖科技股份有限公司投資案。 2.本公司「董事會議事規則」修訂案。 3.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
108.05.09 第七屆第 21 次	1.本公司經理人委任案。
108.05.29 第八屆第 1 次	1.選任本公司第八屆董事長案。 2.本公司第四屆薪資報酬委員會委任案。
108.07.29 第八屆第 2 次	1.訂定本公司 107 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 2.訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案。 3.本公司之孫公司盛通科技股份有限公司變更公司名稱案。 4.JXY Electronics Corporation 增加投資深圳市集芯源電子科技有限公司案。 5.MCU Holdings Ltd.增加投資 Quanding Technology Holding Ltd.案。 6.本公司之孫公司 Best Health Electronics Corporation 成立香港子公司案。 7.本公司之孫公司優方科技股份有限公司新增大陸投資案。 8.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 9.討論解除董事競業禁止案。 10.討論解除經理人競業禁止案。 11.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
108.10.28 第八屆第 3 次	1.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 2.本公司轉投資關聯企業擬成立香港子公司案。 3.討論解除董事競業禁止案。 4.本公司 109 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 5.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 6.本公司 109 年營運計畫書案。 7.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
109.02.05 第八屆第 4 次	1.本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.本公司 108 年合併財務報告及個體財務報告案。 3.BestComm RF Electronics Inc.增加投資芯通電子科技(東莞)有限公司案。 4.MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Motor Control Technology Corporation(名稱暫定)及芯動微電子(杭州)有限公司(名稱暫定)案。 5.討論解除董事競業禁止案。 6.討論解除經理人競業禁止案。 7.本公司「內部控制制度」修訂案。 8.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
109.03.05 第八屆第 5 次	1.本公司 108 年度營業報告書案。 2.本公司 108 年度盈餘分派案。 3.本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 4.討論解除董事競業禁止案。 5.本公司 109 年股東常會召開日期案。 6.本公司出具內部控制制度聲明書案。 7.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

公司有關人士辭職解任情形彙總表

109 年 4 月 10 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
財務主管	李佩縈	93/05/11	108/02/01	因個人規劃辦理退休
財務主管	廖明通	108/02/01	-	內部職務調整

五、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓 名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度 設計	工商 登記	人力 資源	其他	小 計		
安侯建業聯合 會計師事務所	游萬淵 曾漢鈺	3,320	0	0	0	620	620	108/01/01~108/12/31	稅務 服務

(二) 更換會計師事務所且更換年度所付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	108 年度		當年度截至 109 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳啟勇	—	—	—	—
董事兼總經理	高國棟	—	—	—	—
董事兼副總經理	張 治	—	—	—	—
董事兼副總經理	林正鋒	—	—	—	—
董事兼副總經理	李佩縈(註 1)	—	—	—	—
董事兼副總經理	蔡榮宗	—	—	—	—
董事	王仁宗	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	9,000	—	—	—
獨立董事	郭泰豪	—	—	—	—
協 理	吳紹菡	—	—	—	—
協 理	吳德傳	—	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿	—	—	—	—
協 理	王明坤	—	—	—	—
協 理	劉源河	—	—	—	—
協 理	潘建州(註 2)	—	—	67,000	—
會計主管	廖明通	2,000	—	—	—
財務主管	廖明通(註 3)	2,000	—	—	—
大股東(註 4)	聯華電子(股)公司	(2,414,000)	—	—	—

註 1：於 108 年 5 月 29 日任期屆滿。

註 2：於 108 年 5 月 20 日原職處長升任本公司協理。

註 3：於 108 年 2 月 01 日擔任財務主管職務。

註 4：於 108 年 6 月 24 日解任大股東身分。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

109 年 3 月 29 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	22,144,257	9.79%	—	—	—	—	無	無	
吳啟勇	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	—	—	章安華	配偶	
渣打託管 i S h a r e s I V 有限公 司	7,200,000	3.18%	—	—	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
啟盛投資(股)公司 代表人：陳佳宏	5,815,703	2.57%	—	—	—	—	無	無	
柏鼎投資有限公司 代表人：章安華	4,624,841	2.04%	—	—	—	—	吳啟勇	配偶	
財團法人國家文化 藝術基金會 代表人：林曼麗	4,538,000	2.01%	—	—	—	—	無	無	
德銀託管奎特外國 價值小型資本基金 專戶	4,380,500	1.94%	—	—	—	—	無	無	
花旗(台灣)商業銀 行受託保管挪威中 央銀行投資專戶	3,999,000	1.77%	—	—	—	—	無	無	
德銀託管富邦現代 生命保險自營帳投 資專戶	3,893,000	1.72%	—	—	—	—	無	無	

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：108 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	15,253	100%	—	—	15,253	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
MCU Holdings Ltd.	500	100%	—	—	500	100%
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	6	0.10%	6,479	99.90%	6,485	100%
盛凌投資股份有限公司	42,983	100%	—	—	42,983	100%

註：係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：89 年 5 月 15 日台財證(一)第 36989 號函核准。
 註 2：90 年 4 月 3 日台財證(一)第 116941 號函核准。
 註 3：91 年 5 月 17 日台財證(一)第 126989 號函核准。
 註 4：92 年 6 月 27 日台財證(一)第 0920128586 號函核准。
 註 5：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。
 註 6：94 年 6 月 24 日金管證(一)第 0940125322 號函核准。
 註 7：92 年 4 月 1 日台財證(一)第 0920110590 號函核准。
 註 8：92 年 8 月 22 日台財證(一)第 0920138382 號函核准。
 註 9：95 年 6 月 29 日金管證(一)第 0950127323 號函核准。
 註 10：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。
 註 11：96 年 6 月 25 日金管證(一)第 0960031838 號函核准。
 註 12：97 年 7 月 9 日金管證(一)第 0970034273 號函核准。
 註 13：98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。
 註 14：94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。
 註 15：96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

109 年 3 月 29 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合計
人 數	1	10	83	17,411	165	17,670
持有股數	502,000	13,204,000	44,590,106	106,222,913	61,649,181	226,168,200
持股比率(%)	0.22%	5.84%	19.71%	46.97%	27.26%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

109年3月29日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	4,301	259,769	0.12
1,000 至 5,000	10,644	20,790,570	9.19
5,001 至 10,000	1,328	10,226,951	4.52
10,001 至 15,000	423	5,319,332	2.35
15,001 至 20,000	291	5,365,721	2.37
20,001 至 30,000	202	5,009,841	2.22
30,001 至 50,000	172	6,728,606	2.98
50,001 至 100,000	133	9,412,195	4.16
100,001 至 200,000	71	10,120,114	4.48
200,001 至 400,000	32	8,758,894	3.87
400,001 至 600,000	21	10,231,618	4.52
600,001 至 800,000	10	7,110,721	3.14
800,001 至 1,000,000	6	5,275,345	2.33
1,000,001 股以上	36	121,558,523	53.75
合 計	17,670	226,168,200	100.00

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

109年3月29日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79%
吳啟勇		7,665,809	3.39%
渣打託管 i S h a r e s I V 有限公司		7,200,000	3.18%
高國棟		6,701,176	2.96%
啟盛投資股份有限公司		5,815,703	2.57%
柏鼎投資有限公司		4,624,841	2.04%
財團法人國家文化藝術基金會		4,538,000	2.01%
德銀託管奎特外國價值小型資本基金專戶		4,380,500	1.94%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶		3,999,000	1.77%
德銀託管富邦現代生命保險自營帳投資專戶		3,893,000	1.72%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

年 度		107 年	108 年	當年度截至 109 年 3 月 31 日
項 目				
每 股 市 價	最 高	88.00	78.70	77.70
	最 低	55.50	56.20	55.00
	平 均	72.45	68.99	68.42
每 股 淨 值	分配前	18.68	18.04	—
	分配後	13.98	註 5	—
每 股 盈 餘	加權平均股數(仟股)	226,168	226,168	226,168
	每股盈餘	4.70	4.05	—
每 股 股 利	現金股利	4.70	註 5	—
	無 償 配 股	盈餘配股	—	—
		資本公積配股	—	—
	累積未付股利(註 1)		—	—
投 資 報 酬 分 析	本益比(註 2)	15.41	17.03	—
	本利比(註 3)	15.41	註 5	—
	現金股利殖利率(註 4)	6.49%	註 5	—

註 1：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 2：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。註 3：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 4：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 5：108 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 108 年度盈餘分配中，以未分配盈餘分配，股東紅利新台幣 825,061,594 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金股利新台幣 3.648 元，另以法定盈餘公積分配，法定盈餘公積新台幣 90,919,616 元，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金新台幣 0.402 元，前述以未分配盈餘及法定盈餘公積分配予股東，以現金發放合計新台幣 915,981,210 元，合計每股擬配發現金新台幣 4.05 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依上述公司章程規定比例提供員工及董事酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)經董事會通過分派 108 年度員工及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣 109,967,512 元及董事酬勞新台幣 12,018,612 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

107 年度員工酬勞提列金額為新台幣 129,225,211 元、董事酬勞提列金額為新台幣 14,248,357 元，與本公司董事會擬議內容並無差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司為國內專業微控制器 IC 設計領導廠商，營業範圍主要包括微控制器 IC 及其週邊 IC 之設計、研發與銷售，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

年度 產品別	108 年度
微控制器 IC	76%
週邊 IC	24%
合 計	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司自有開發重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、RF IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、語音 IC 產品、健康量測產品、安防產品、馬達控制產品、物聯網及金融相關產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性特殊需求的滿足。

另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類之市場需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) AEC-Q100 高溫 105°C 車規 Flash MCU 認證規劃，正式向車用電子領域邁進。
- (2) 24 位元 Delta Sigma A/D with LCD 型 Flash MCU。
- (3) 新一代 Touch Key Flash MCU，增強 MCU 抗干擾能力達到 CS 動態 3V Pass 要求。
- (4) 針對穿戴式裝置開發極低功耗之觸控 Flash MCU。
- (5) 各種醫療量測 MCU 及解決方案。
- (6) 半橋電磁爐/微波爐專用 MCU 及解決方案。
- (7) 快速充電與識別專用 MCU 及解決方案。
- (8) 中功率無線充電器專用 MCU 及解決方案。
- (9) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (10) 動力型電池充電器專用 MCU 及解決方案。
- (11) AC 電源穩壓 AVR 專用 MCU 及解決方案。

- (12) 安防及消防產品專用 MCU 及解決方案(例：CO / GAS 偵測器、煙感火災報警器)。
- (13) 超低 RTC 耗電流的標準型 Flash MCU。
- (14) 高資源、大程序空間的標準型 8 位元 Flash MCU。
- (15) CAN Bus Flash MCU 及解決方案。
- (16) TDC 超聲波流量計 ASSP MCU。
- (17) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (18) RF Sub-1GHz 及 OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案。
- (19) 新一代低功耗藍牙(BLE) Arm® Cortex® -M0+ Flash MCU。
- (20) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (21) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (22) 32 位元 MCU 產品推出以 Arm® Cortex® -M0+及 M3 核心之 Flash 微控制器。
- (23) 金融機具之高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識處理器及其解決方案。
- (24) 高精度生物檢測前置類比處理器(AFE)暨可編程數位濾波器(DF)及快速傅立葉轉換(FFT)。
- (25) AI 影像辨識處理器及其解決方案。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場：

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計，因中美貿易摩擦，2019 年全球半導體市場全年總銷售值達 4,121 億美元，較 2018 年(4,688 億美元)衰退 12.1%，為 2001 年以來全球半導體產業出現的最大跌幅；2019 年總銷售量達 9,320 億顆，較 2018 年衰退 7.2%；2019 年 ASP 為 0.442 美元，較 2018 年衰退 5.3%，雖至第四季中美貿易談判較為順利，總體經濟漸趨穩定，未來全球景氣是否扭轉仍待觀察。

另外，市場研究機構 IC Insights 研究報告，2019 年 MCU 單位量達到 269 億顆，年減約 4%；2019 年 MCU 營收達到 165 億美元，年減約 6%，另外，依據工研院產科國際所統計，由於 32 位元 MCU 產品因更符合物聯網高性能低功耗之需求，2019 年 32 位元 MCU 產品銷售金額所占比率由 23.9%增加至 24.5%，年增 0.6%，相對 8 位元 MCU 產品銷售金額於 2019 年減少 0.2%，並預估在 2023 年，因處理高性能運算應用的設計要求越來越高，感測器和各式智慧型裝置連接到互聯網，32 位元 MCU 將更快速地擴張至各應用領域。

(2) 臺灣半導體產業市場：

依據工研院產科國際所統計 2019 年台灣 IC 產業產值達新台幣 26,656 億元，較 2018 年成長 1.7%。其中，IC 設計業產值為新台幣 6,928 億元，較 2018 年成長 8.0%；IC 製造業為新台幣 14,721 億元，較 2018 年衰退 0.9%，其中，晶圓代工為新台幣 13,125 億元，較 2018 年成長 2.1%，記憶體與其他製造為新台幣 1,596 億元，較 2018 年衰退 20.4%；IC 封裝業為新台幣 3,463 元，較 2018 年成長 0.5%；IC 測試業為新台幣 1,544 億元，較 2018 年成長 4.0%。

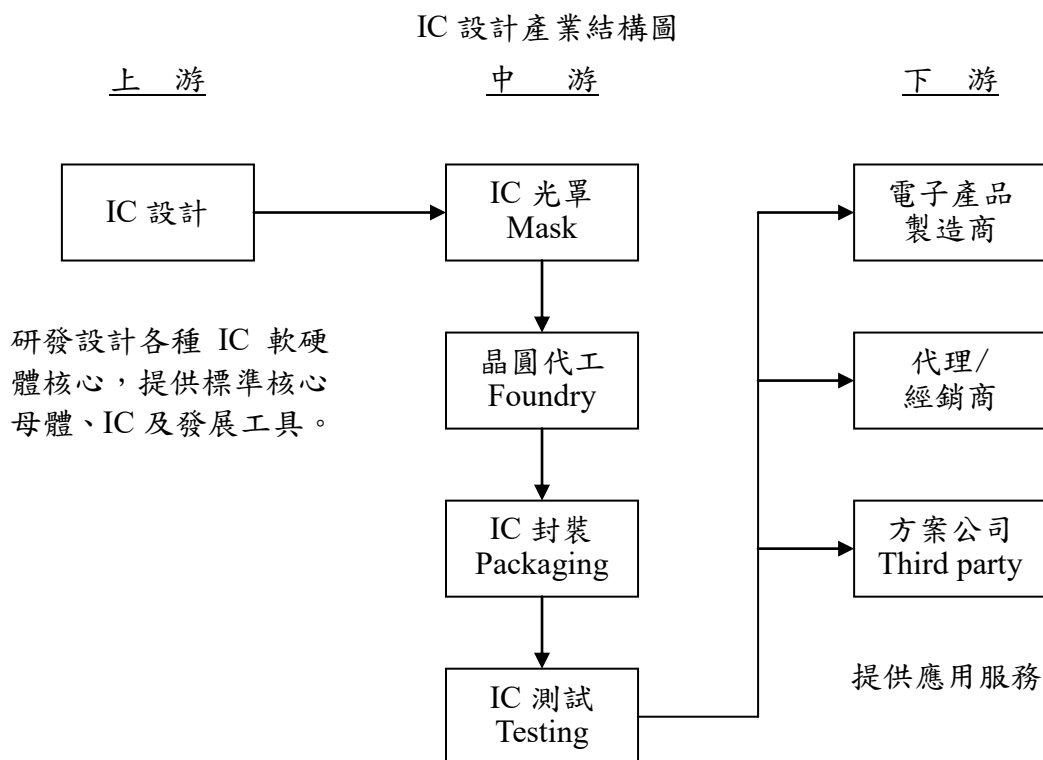
展望 2020 年，TSIA 認為雖新型冠狀病毒(COVID-19)因素造成上半年的需求趨緩，但預測台灣整體 IC 設計業 2020 年的產值預計將達新台幣 7,227 億元，較

2019 全年成長 4.3%。

(3) 中國半導體產業市場：

根據中國半導體行業協會統計，2019 年中國積體電路設計業銷售額為人民幣 3,085 億元，較去年增長 19.7%，惟中國半導體行業協會理事長魏少軍表示，中國 IC 設計產業面臨內需強勁惟自給供給不足的狀況，國內積體電路產業生產偏重於中低階產品，高階產品仍倚賴海外進口之態勢，未來中國將持續著重於高端技術研發的投入，以實現產品升級，並佐以建構完整之供應鏈，持續為客戶創造價值，提升全球市場競爭力。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、健康量測及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用途
微控制器(MCU)產品	1. Arm® Cortex® -M 為核心之系列 32 位元 Flash MCU。 2. HT8 為核心之系列 8 位元 Flash MCU。 3. BS 系列 8 位元觸控 Flash MCU。
RF SoC 微控制器(MCU)產品	1. 無線對講機、電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控、無線門鈴、和安全防盜等。 2. 低功耗藍牙(BLE)透傳控制的健康量測產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。 3. Sub-1GHz 展頻無線通信 LoRa 模塊產品、智能四錶等 IoT 產品及應用。
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鍵 MCU。

主要產品	用 途
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、PDF Data Logger 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音&家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器及定電流 LED 顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、感煙器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(刮鬍刀、鼻毛刀、潔面儀、電動剪髮器)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、信用卡動態驗證碼(DCV)、NFC 儲值卡、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身分證等有掃瞄辨識需求之相關金融機具，例：點驗鈔機、清分機、ATM 機、EPD Flash MCU、Ultra-Low Power Flash MCU、及身分證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 Wi-Fi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 Flash MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。並輔以 AI 圖像辨識處理器，提供鈔票、車牌、人臉、物件、手勢等辨識系統方案。
安防產品類	感煙/感溫火災探測報警器、PM2.5 感測器、CO/GAS 探測報警器及 PIR/uWave 感測器等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、紅外線測溫、霧化器、接近感應器等。

4. 競爭情形

由於中國成立公司的門檻低，加上中國政府發布《國家積體電路產業發展推進綱要》和《中國製造 2025》，為中國 IC 產業實現跨越式發展注入了強大動力，截至 2019 年，中國已有約 1,780 家設計企業 IC 設計公司，數量增加 4.8% (較去年增加 82 家)，台灣面對的同業競爭壓力隨之升高。另以產品應用部分予以分析，2019 年於通訊、智慧卡、電腦、導航及消費性電子等五個應用之中國 IC 設計業者數量增加。

因 8 位元 MCU 在 IoT 及可穿戴設備等提供穩定、可靠、及易維護之特性，全球 MCU 廠商仍持續加大 8 位元 MCU 之拓展力度，8 位元 MCU 每年依然佔有全球 MCU 市場的 35% 以上市佔率，另外，市場機構 Mordor Intelligence 預估，至 2023 年，MCU 市場將增長至接近百億美元，年複合增長率為 5.11%，主要應用於汽車、消費產品、家用電器、醫療保健、工業電子、資料處理及通信等產業，8 位元 MCU 因可執行簡易資料處理，將與生活越來越密不可分。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	108 年度
研發費用	793,025
營業收入	4,584,105
研發費用佔營業收入比率(%)	17%

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20% 投入新產品與新技術研發，藉由新產品的

持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升。

2019 年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V~5.5V 低工作電壓 Flash 型系列：支援更低的工作電壓，內建 AD 及 LCD 功能，適用電池類產品。
- B. 內建多級運算放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器、自動感應水龍頭等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming)燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 低功耗標準型系列(TinyPower™ MCU): 本系列產品具備與國際大廠同等級之低功耗能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。
- E. 健康量測產品: 鎖定血壓、精準血糖儀、血氧、體溫、體重與體脂肪、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與語音介面以及 BLE 通信，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- F. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 之開發，從控制方式可分成 PWM 舵機與 UART 舵機，皆已完成調參平台開發，用戶可使用該平台輕易達成舵機產品開發。在機器人之 UART 舵機的通訊協定也已開發完成，已被智能機器人大廠評估。
- G. 無刷直流馬達(Brushless DC, BLDC) Motor 控制專用 MCU：除一般 8bit ASSP MCU 外，新推出 32bit BLDC MCU FOC 方案。本系列產品鎖定節能風扇、空氣淨化器、園林工具、吸塵器、電動工具、冰箱散熱風扇，皆達各產品所需之功能及效果並成功導入客戶量產。
- H. 無線充電產品系列：除已開發完成 5W 無線充電低功率產品外，新增符合 WPC 中功率無線充電 ASSP MCU，可完全符合 Qi 15W 中功率需求。
- I. 多路 RGB LED 彩燈 MCU 之開發: 可恆流驅動 RGB LED，實現數百萬種 RGB 顏色變化，很適合應用在智能音箱、滑鼠墊、電競耳機、電競滑鼠等產品上，增加產品流光溢彩的絢麗效果。
- J. 安防產品: 已經開發完成感煙探測報警器、CO/燃氣偵測報警器、PIR/微波感應專用 MCU，產品均整合多級運算放大器、雙通道 IR LED 驅動器、溫度傳感器、ADC、顯示驅動器等功能，可以大幅減少安防產品外部零器件的使用。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(寬溫運作範圍達到-40℃~+85℃)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) Arm® Cortex® M series 32 位元 MCU

- A. Arm® Cortex®- M0+為核心寬工作電壓 2.5V~5.5V 之 Flash MCU。
- B. Arm® Cortex®- M3 為核心操作速度可達 96MHz 之 Flash MCU。
- C. Arm® Cortex®- M0+為核心操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU。
- D. LED RGB 多彩串列燈條控制 Flash MCU：32 位元 M0+ 操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU，工作電壓 2.5V~5.5V，其內建高效能 4 路串列燈條控制器與多組 PWM timer 且整合 PDMA 讓控制更為流暢，適用於電競鍵盤、滑鼠、LOGO 燈及燈串等應用。
- E. LCD Flash MCU：32 位元 M0+ 操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU，工作電壓 1.65V~3.6V，內建 USB 2.0 FS、LCD 控制器、多組 PWM timer、AES-128、PDMA、UART/USART、RTC 與 12-bit 的 ADC 與 DAC，適用於多項消費性與工業產品等 LCD 顯示應用。

(3) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + Voice Flash MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，軟體語音解壓縮技術，並內置 HOLTEK 電容式觸控按鍵使用，及軟體 LCD 功能，減化客戶應用技術門檻及整合多項分離 IC 器件應用，提高產品的便利性及完整性。
- C. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12-bit 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- D. 超聲波霧化器 Flash MCU：內建自動追頻、無水上電、缺水檢測等功能，能配合各種不同頻率之霧化片（100KHz、1.7MHz、2.4MHz、3MHz 等），完整支援霧化器所需，有效降低客戶成本。
- E. 完成 2.0 代動力型充電器控制 Flash MCU：內建二組 OPA、DAC，經由軟體改變 DAC，MCU 透過 OPA 控制一次側 PWMIC，進行電池恆壓(CV)/恆流(CC)硬體控制，適用於 e-bike 或電動工具鉛酸/鋰電池充電器產品。
- F. 電源管理暨驅動產品：
 - (A) 高耐壓/高精準度/低功耗/大電流驅動線性穩壓器：工作電壓高達 40V，超高±1%精準度，低於 1uA 工作電流及最高達 500mA 相關線性穩壓產品，可廣泛使用於消防安全、工業控制、金融商品、車用電子等應用領域，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) 低功耗/大電流驅動升壓型轉換器：超低 0.7V 工作電壓，最高達 3A 輸出電流，適用於乾電池及鋰電池相關應用產品，如電動刮鬍刀、健康醫療檢測、行動電源、無線聯網的水/電能/燃氣/熱能錶應用等，可延長電池壽命及提供系統穩定可靠電源。
 - (C) 高耐壓/大電流驅動降壓型轉換器：工作電壓高達 52V，最大 3A 輸出

電流，可廣泛使用於智能電錶、電動機車、無線路由器等應用領域，提供系統穩定可靠電源。

- (D) 低功耗/低成本交流-直流電壓轉換器：最大耐壓達 700V，精簡外圍線路提供具成本競爭力方案，廣泛使用於小家電領域產品，如電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲等。
 - (E) 直流馬達驅動 IC：可使用在水表、燃氣表、熱量錶的閥門控制以及電子門鎖等直流馬達驅動應用產品。達到馬達電壓最高 24V，驅動峰值電流最大 2.5A 能力，並提供完整 IC 自我保護功能。
 - (F) 多節鋰電池保護模擬前端 IC：應用於手持電動工具、吸塵器、噴水器等裝置，搭配 Holtek MCU 可提供低成本、高整合完整鋰電池保護方案。
 - G. Remote Control Encoder IC：可使用在汽車防盜、機車/電動車防盜、家庭防盜及大門、窗簾、門鈴、家電之遙控。
 - H. 超聲波流量計 ASSP MCU：整合 TDC 等類比 IP 並提供通訊介面(SPI/UART/I²C)，內建流量演算法及溫度量測等相關技術，降低客戶應用技術門檻，提高產品之便利性。
 - I. 完成快速無線充電 ASIC MCU 開發，針對無線充電特殊規格設計，可應用於多線圈與 10W 無線充電方案。
 - J. 完成 400mA 線性充電 IP 開發，此 IP 與 8-bit MCU SoC 整合後，可應用於鋰電池各項產品。
 - K. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，以提高產品的便利性及完整性。
 - L. 雙核 32 位元 DSP IC：整合雙核 DSP、影像處理加速器、類神經網路及 DDR 控制器等，提供影像辨識如鈔票、證件、人臉、車牌等相關辨識應用方案。
- (4) 電腦週邊產品
- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
 - B. USB Bridge 系列 IC。
 - C. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。
 - D. USB 2.0 Low Speed MCU 系列。
 - E. PDF Data Logger MCU。
 - F. 電競鍵盤及滑鼠 RGB LED ASSP Flash MCU。
- (5) 無線產品
- A. 無線對講機控制器及射頻整合芯片：內建無線電射頻、DSP、與音頻類比電路之 SoC Flash MCU，適用於類比式專用及 FRS 對講機。
 - B. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
 - C. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 接收超再生及超外差模式電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。

- D. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾能力、雙向傳輸等應用。
- E. 低功耗藍牙(BLE) MCU：整合高性能的射頻、調製解調器及 32 位元 M0+Flash MCU，並內建 DC/DC 及 LDO，支援寬廣範圍的單電源供電，適用於低功耗的健康醫療產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。
- F. NFC Tag Flash MCU & NFC Reader controller。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司經營團隊擁有超過 30 年豐富的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援，同時在臺灣/中國/美國/印度建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略：

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略：

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的彈性選擇。一次購足的便利性以及優異的性能與價格比，使客戶的產品具有強大之市場競爭力。
- B. 以策略性產品作為消費市場發展主軸，導入利基型產品，提供差異化服務。
- C. 本公司以整體系統成本的角度出發，協助客戶降低整體成本以達到雙贏的目的。

(4)研發策略：

本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術及重要關鍵技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準，已進行 105°C 高溫 AEC-Q100 認證，並朝車用電子規範產品延伸，另外針對較特定應用之產品，或直接進行功能的改良，提高產品之良率，進入更大的潛在市場。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以智慧家電、健康量測、PC 相關周邊、安防、馬達控制與金融相關領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質及快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功地將 HOLTEK 微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，並另積極布局 32 位元 MCU 以擴大全球市佔率，2019 年 32 位元 MCU 出貨量約 2,200 萬顆，成長高達 33%，未來 32 位元 MCU 應用範圍涵蓋的功能面將會更廣泛，並在各種不同的領域，搭配不同的專業合作方案夥伴，擴展生態系統，透過引入創新的設計方案，加速開發該應用之終端客戶所需產品。

(2)生產策略：

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢，提升良率及市場競爭力。

(3)產品策略：

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階或高附加價值之應用領域，如高階大小家電、工業設備、安全防护、車用電子及物聯網等設備領域。

(4)研發策略：

提升產品設計能力，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，大幅提高產品的良率，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市之時間並提高價格競爭力。

(5)產品發展項目：

- A. 開發 32 位元 Arm 核心 MCU 標準系列，搭配周邊包括 LCD 驅動、/USB UART/SPI/I2C/I2S 通訊介面、PWM 驅動、CMOS 感測器、高速高精度 A/D 和 D/A 轉換器、比較器、運算放大器等功能。
- B. 開發 32 位 Arm 核心 MCU 專用範圍，用於圖像識別、電機控制、指紋識別、健康測量、音樂合成。整合 AES 加解密功能、CRC 運算功能、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器、多通道音樂合成器等周邊，適合多種應用領域如：物聯網終端裝置、可穿戴設備、多媒體產品及無線應用、音樂合成器等領域。
- C. 開發全系列標準的 8 位元 Flash MCU，包括 A/D 和 D/A 轉換器、LCD 和 LED 驅動程式、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器等語音應用
- D. 增加 8 位 Flash 專用 MCU 的範圍，用於健康測量、個人護理、電機驅動、觸控開關、安防產品、物聯網產品、有線和無線充電器產品、家用電器、電腦週邊設備、超聲波應用等領域。
- E. 開發低功耗藍牙(BLE)射頻、2.4GHz 雙向傳輸、Sub 1GHz 射頻 SoC 快閃記憶體 MCUs、編碼器/解碼器等無線設備。
- F. 擴大電源管理設備的範圍，包括高電流 LDOs、高輸出電流之 DC/DC 同步升壓轉換器、高效率 AC-DC 轉換器等。
- G. 開發低中高壓 3 相馬達門驅動器(Gate Driver)、驅動器(Driver) IC。
鋰電池包管理 IC (BMS)、充電器 IC，BLDC 無刷馬達 MCU 等電動工具、

風扇、電動自行車、滑板車等應用。

H. 開發 AI 圖像辨識 IC：提供鈔票、車牌、人臉、物件及手勢等相關辨識的應用。

I. MCU 整合 AFE 電路，結合各類傳感器應用，開發 Smart Sensor 產品，擴展產品應用領域。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司銷售地區分佈如下表所示：

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	107 年度		108 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
臺灣地區	484,264	10	449,626	10
中國地區	3,716,948	76	3,474,535	76
其他海外地區	661,595	14	659,944	14
合計	4,862,807	100	4,584,105	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。

根據 IC Insights 預測，2019 年 MCU 營收將達 165 億美元，依本公司 2019 年度 MCU 總銷貨金額為新台幣 35.10 億元，約 1.16 億美金(新台幣對美元匯率以 30.2424 計算)，於 MCU 市場的營收占有率約 0.7%，另外，2019 年本公司 MCU 總出貨量 6.53 億顆，相對 2018 年減少 3%，相對 IC Insights 預測 2019 年全球 MCU 出貨量 269 億顆，已達 2% 以上之 MCU 市場的出貨量占有率，預估 2020 年，隨著應用面廣度的拓展，推升 MCU 需求面，將持續提升既有的市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1)供需狀況

由於 MCU 的易用性、即時運行和低功耗特性，可為智慧、安全且不斷發展的 IoT 市場提供最高性能且經濟高效的嵌入式解決方案。由於整體半導體市場自 2018 年下旬開始轉弱，成長幅度趨緩，2019 年因中美貿易摩擦，廠商觀望氛圍濃厚，致間接影響接單狀況，惟仰賴物聯網及可穿戴式裝置，如 TWS(真無線藍牙耳機)等應用需求，以多元化的產品，及時提供終端客戶所需產品。

(2)未來成長性

根據 IC Insights 研究報告，從 2018 年到 2023 年 MCU 出貨量五年內複合增長率約為 4%，且預估到 2020 年，將有超過 30 億個物體連接在一起，大量的

電子產品急需智能化升級，本公司以 MCU 和 RF 以及 Sensor 集成，並提供低功耗藍牙(BLE)模組、LoRa 模組以及 Sub-1GHz 等無線通訊模組因應，未來進一步若人工智慧透過物聯網滲透到生活中，面對所謂「AIoT」時代來臨，全球 MCU 廠商更是需要全新的技術需求才能迎接如此龐大的市場挑戰，以迎向更多元之市場需求。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1)研發能力強，產品領先群倫：

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2)更新輔助設計器材與測試設備：

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3)完整的全球行銷網路：

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、北京、成都、青島、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4)上游工廠關係穩固：

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5)管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

(A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加

IC 功能與客戶產品的競爭力，提高對手競爭障礙。

(B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。

(C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

(A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。

(B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。

(C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。

(D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。

(E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。

(F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

(A) 多年經驗累積之優良研發技術。

(B) 強大的研發團隊。

(C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。

(D) 發展產品多元化，減少景氣波動度影響。

D. 整體環境支援

(A) 產業支援集中，可增強經營效益。

(B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。

(C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。

B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。

C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。

D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。

E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智財權實力，努力提升產品之主導性。

F. 面臨大陸設計業的蓬勃發展，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。

G. IC 設計人才普遍缺乏，且培訓時間較長，加上市場產品汰換迅速，經由與

大專院校合作延攬優秀人才，並定期舉辦教育訓練培訓研發人才，提供良好的工作環境及晉升管道，維持低人才流動率。

- H. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外，產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

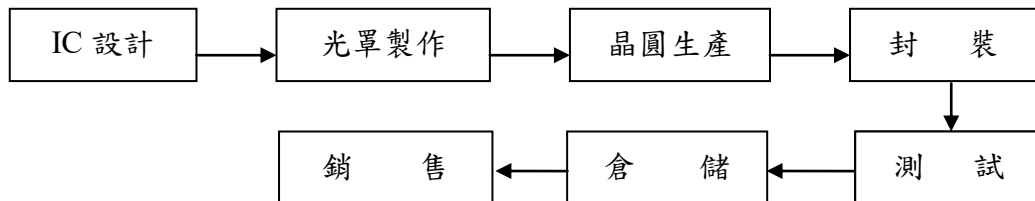
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康護理產品、汽機車、工業儀錶控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 LED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、教育娛樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

- (1)本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2)晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3)封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確保封裝產能無虞。

(4)測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5)倉儲作業

A. 主要儲存物品：

- (A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。
- (B) 測試狀態分為：已測/未測。
- (C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

- (A) 自動倉儲作業。
- (B) 儲存物品之品質維護。
- (C) 貨物進出的管理與正確性。
- (D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三)主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四)最近二年度任一年度中占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

107 年度					108 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	878,732	34	無	A	919,365	38	無
2	B	354,956	14	無	B	346,198	14	無
3	C	283,560	11	無	C	288,436	12	無
4	D	226,991	9	無	D	261,231	11	無
	其他	806,558	32	無	其他	606,749	25	無
	進貨淨額	2,550,797	100		進貨淨額	2,421,979	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2.最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

107 年度					108 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	635,592	13	(註 2)	欣宏	589,840	13	(註 2)
2	CROWN RICH	544,069	11	(註 2)	CROWN RICH	523,944	11	(註 2)
	其他	3,683,146	76		其他	3,470,321	76	
	銷貨淨額	4,862,807	100		銷貨淨額	4,584,105	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：本公司子公司採權益法評價之被投資公司。

(五) 最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產 量值 主要商品	年 度	107 年度			108 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC		--	667,826	1,867,614	--	638,791	1,826,612
週邊 IC		--	405,805	536,009	--	364,188	486,246
開發工具及設計收入 等其它		--	136	6,110	--	349	5,130
總 計		--	1,073,767	2,409,733	--	1,003,328	2,317,988

註：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制，生產量的多寡係依據當年度之銷售預估。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	年 度	107 年度				108 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC		42,333	346,059	630,511	3,365,495	41,510	325,189	611,312	3,184,832
週邊 IC		44,603	126,566	355,294	999,633	36,217	109,598	340,299	934,177
開發工具及設計 收入等其它		35	11,639	788	13,415	28	14,839	350	15,470
總 計		86,971	484,264	986,593	4,378,543	77,755	449,626	951,961	4,134,479

三、從業員工：最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

日期：109 年 3 月 31 日

年 度		107 年底	108 年底	當年度截至 109 年 3 月 31 日
員工 人數	工 程 人 員	566	601	606
	管 理 人 員	145	150	144
	生產測試人員	41	48	48
	合 計	752	799	798
平 均 年 歲		35.78	35.96	35.95
平 均 服 務 年 資		7.01 年	7.28 年	7.43 年
學歷 分布 比率	博 士	0.7%	0.4%	0.4%
	碩 士	27.9%	27.5%	28.4%
	大 專	64.2%	64.7%	64.7%
	高中(含以下)	7.2%	7.4%	6.5%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。

為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：桌球社、羽球社、瑜珈社、桌遊社、游泳社等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政管理處及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1)職前訓練(新人訓練)：

A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解本公司企業文化及經營理念、人事規章、智慧財產權、品質政策、環保政策、工業安全與

衛生及消防安全等實施之訓練。

B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2)在職訓練：

A.部門自辦訓練：各部門針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。

B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、工安衛生培訓課程、法務智權培訓課程及電腦培訓等多元而充實的訓練課程。

C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。

D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。

E.108 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人數
一般管理	120	95
專業技術	235	646
新人訓練	12	40

(3)在職進修：

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4)自我發展：

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1)退休金提繳：

A.本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 2 %提撥退休基金，並以專戶存於臺灣銀行。

B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6%之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2)實施情形

本公司勞資雙方依法組織「退休準備金監督委員會」，每季定期由勞資雙方召開勞工退休準備金監督委員會議，負責管理監督及審核退休準備金之提撥、存儲、支用等事宜。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季定期召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5.員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6.工作環境與員工安全保護措施

本公司於 2006 年取得國際 OHSAS18001 職業安全衛生管理認證，並於 2019 年完成新版 ISO45001 職業安全衛生管理認證，每季定期召開職業安全衛生委員會議，推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。

(1)門禁安全：除大樓之保全人員 24 小時守衛外，各出入口及角落地區設有監視攝影器，並加強夜間、假日保安全管理，以保障員工人身安全。

(2)消防安全：

A.定期委請廠商進行保養及維修消防設備(例：消防警報器、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄。

B.每年定期舉辦消防演習及緊急避難措施，推行全員預防認知責任。

(3)環境安全：為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季委請廠商進行抽樣檢測飲用水機之大腸桿菌群，定期實施辦公室清潔與消毒作業，並於坐式廁所提供 75% 酒精，以確保工作環境安全與舒適。

(4)員工健康檢查：本公司每年定期委託醫療機構特別至公司安排員工各項身體健康檢查，並設有專門之醫護人員提供醫護服務，以及每二個月安排專業醫師至公司看診及舉辦健康講座，注重員工身心健康。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學工業 園區管理局	90/03/15~109/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術授權	Arm Limited	96/06/25~永久	Arm® Cortex®-M3 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	Arm Limited	102/09/24~永久	Arm® Cortex®-M0+ 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~107/03/31	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	Arm Limited	107/12/28~永久	Arm® Cortex®-M4 with FPU 及 system IP products Corstone-101 技術授權	不得違反相關法令之規定

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
流 動 資 產		3,824,522	3,928,641	4,179,054	4,322,111	3,984,290
不 動 產、廠 房 及 設 備		463,561	442,570	414,729	398,515	358,515
無 形 資 產		—	—	—	—	—
其 他 資 產		775,954	763,556	770,487	834,874	1,030,863
資 產 總 額		5,064,037	5,134,767	5,364,270	5,555,500	5,373,668
流 動 負 債	分 配 前	854,700	977,382	1,068,788	1,079,483	932,568
	分 配 後	1,662,120	1,768,971	1,996,078	2,142,474	(註 2)
非 流 動 負 債		163,141	173,262	196,636	251,918	361,677
負 債 總 額	分 配 前	1,017,841	1,150,644	1,265,424	1,331,401	1,294,245
	分 配 後	1,825,261	1,942,233	2,192,714	2,394,392	(註 2)
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170	4,052,665
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	159,281	142,309	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,591,692	1,568,678	1,699,004	1,832,565	1,680,336
	分 配 後	784,272	777,089	771,714	769,574	(註 2)
其 他 權 益		32,280	(24,311)	(31,756)	(37,386)	(31,662)
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		18,233	18,793	27,607	24,929	26,758
權 益 總 額	分 配 前	4,046,196	3,984,123	4,098,846	4,224,099	4,079,423
	分 配 後	3,238,776	3,192,534	3,171,556	3,161,108	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
營 業 收 入	3,967,840	4,157,788	4,614,917	4,862,807	4,584,105
營 業 毛 利	1,948,478	2,018,145	2,189,460	2,406,974	2,235,715
營 業 損 益	846,550	833,690	943,311	1,110,730	986,738
營 業 外 收 入 及 支 出	100,153	84,273	126,479	134,859	81,078
稅 前 淨 利	946,703	917,963	1,069,790	1,245,589	1,067,816
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	818,321	792,722	935,987	1,070,366	922,313
停 業 單 位 損 失	—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)	818,321	792,722	935,987	1,070,366	922,313
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(25,886)	(56,403)	(11,703)	(76,197)	1,233
本 期 綜 合 損 益 總 額	792,435	736,319	924,284	994,169	923,546
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	806,806	784,218	926,188	1,063,990	914,902
淨利歸屬於非控制權益	11,515	8,504	9,799	6,376	7,411
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	780,920	727,815	914,470	987,931	916,486
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	11,515	8,504	9,814	6,238	7,060
每 股 盈 餘	3.57	3.47	4.10	4.70	4.05

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(二) 國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
流 動 資 產		3,238,852	3,299,082	3,470,083	3,546,143	3,077,656
不 動 產、廠 房 及 設 備		185,281	177,908	165,050	151,248	135,756
無 形 資 產		—	—	—	—	—
其 他 資 產		1,541,722	1,540,790	1,595,737	1,749,444	2,003,504
資 產 總 額		4,965,855	5,017,780	5,230,870	5,446,835	5,216,916
流 動 負 債	分 配 前	778,756	883,701	968,014	1,002,792	813,085
	分 配 後	1,586,176	1,675,290	1,895,304	2,065,783	(註 2)
非 流 動 負 債		159,136	168,749	191,617	244,873	351,166
負 債 總 額	分 配 前	937,892	1,052,450	1,159,631	1,247,665	1,164,251
	分 配 後	1,745,312	1,844,039	2,086,921	2,310,656	(註 2)
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170	4,052,665
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	159,281	142,309	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,591,692	1,568,678	1,699,004	1,832,565	1,680,336
	分 配 後	784,272	777,089	771,714	769,574	(註 2)
其 他 權 益		32,280	(24,311)	(31,756)	(37,386)	(31,662)
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		—	—	—	—	—
權 益 總 額	分 配 前	4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170	4,052,665
	分 配 後	3,220,543	3,173,741	3,143,949	3,136,179	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)				
	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
營業收入	3,601,285	3,695,728	4,130,794	4,358,758	4,052,932
營業毛利	1,719,836	1,734,684	1,895,447	2,084,309	1,851,161
營業損益	810,424	786,319	880,236	1,051,333	852,499
營業外收入及支出	119,254	115,062	171,629	181,577	194,313
稅前淨利	929,678	901,381	1,051,865	1,232,910	1,046,812
繼續營業單位 本期淨利	806,806	784,218	926,188	1,063,990	914,902
停業單位損失	—	—	—	—	—
本期淨利(損)	806,806	784,218	926,188	1,063,990	914,902
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(25,886)	(56,403)	(11,718)	(76,059)	1,584
本期綜合損益總額	780,920	727,815	914,470	987,931	916,486
淨利歸屬於 母公司業主	806,806	784,218	926,188	1,063,990	914,902
淨利歸屬於非控制權益	—	—	—	—	—
綜合損益總額歸屬於 母公司業主	780,920	727,815	914,470	987,931	916,486
綜合損益總額歸屬於 非控制權益	—	—	—	—	—
每股盈餘	3.57	3.47	4.10	4.70	4.05

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
104	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
105	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
106	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
107	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
108	游萬淵、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
財務 結構 (%)	負債占資產比率	20	22	23	24	24
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	873	900	988	1,060	905
償債 能力 (%)	流動比率	447	402	391	400	427
	速動比率	378	349	335	339	353
	利息保障倍數	—	—	—	—	775
經營 能力	應收款項週轉率(次)	5.85	5.91	5.78	5.66	5.60
	平均收現日數	62	62	63	64	65
	存貨週轉率(次)	3.71	3.90	4.39	3.93	3.51
	應付款項週轉率(次)	4.29	4.12	4.15	4.04	4.28
	平均銷貨日數	98	94	83	93	104
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	8.34	9.18	10.77	11.96	10.8
	總資產週轉率(次)	0.78	0.81	0.86	0.88	0.85
獲利 能力	資產報酬率(%)	16	15	18	19	17
	權益報酬率(%)	20	20	23	26	22
	稅前純益占實收資本額比率(%)	42	41	47	55	47
	純益率(%)	20	19	20	22	20
	每股盈餘 (元)	3.57	3.47	4.10	4.70	4.05
現金 流量	現金流量比率(%)	90	95	65	114	96
	現金流量允當比率(%)	110	111	111	104	94
	現金再投資比率(%)	(1)	2	(2)	6	(3)
槓桿 度	營運槓桿度	1.90	1.99	1.97	1.85	1.91
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)						
1、現金再投資比率較107年度下降，主要係108年度營業活動之淨現金流入減少所致。						

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	19	21	22	23	22
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2,174	2,229	2,467	2,776	1,895
償債能力 %	流動比率	416	373	358	354	379
	速動比率	352	325	308	300	321
	利息保障倍數	—	—	—	—	891
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.66	5.92	5.87	5.68	5.11
	平均收現日數	64	62	62	64	71
	存貨週轉率(次)	4.09	4.30	4.93	4.46	4.42
	應付款項週轉率(次)	4.35	4.11	4.13	4.02	4.44
	平均銷貨日數	89	85	74	82	83
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	19.05	20.35	24.09	27.56	22.20
	總資產週轉率(次)	0.73	0.74	0.79	0.80	0.78
獲利能力	資產報酬率(%)	16	16	18	20	17
	權益報酬率(%)	20	20	23	26	22
	稅前純益占實收資本額比率(%)	41	40	47	55	46
	純益率(%)	22	21	22	24	23
	每股盈餘 (元)	3.57	3.47	4.10	4.70	4.05
現金流量	現金流量比率(%)	88	95	59	116	85
	現金流量允當比率(%)	103	102	103	97	97
	現金再投資比率(%)	(2)	1	(5)	5	(8)
槓桿度	營運槓桿度	1.76	1.83	1.85	1.72	1.84
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析) 1、長期資金占不動產、廠房及設備比率較 107 年度下降，主要係 108 年度使用權資產增加所致。 2、現金流量比率較 107 年度下降，主要係 108 年度營業活動之淨現金流入減少所致。 3、現金再投資比率較 107 年度下降，主要係 108 年度營業活動之淨現金流入減少所致。						

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：請參閱本年報第 71 頁。

四、最近年度財務報告：請參閱本年報附錄一，第 84 頁~第 143 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：

請參閱本年報附錄二，第 144 頁~第 197 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

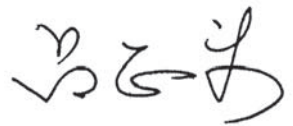
盛群半導體股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所游萬淵及曾漢鈺會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

盛群半導體股份有限公司一〇九年股東常會

審計委員會召集人：呂正樂



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 五 日

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	107 年度	108 年度	增 減 變 動	
			金額	%
流 動 資 產	4,322,111	3,984,290	(337,821)	(8)
不 動 產、廠 房 及 設 備	398,515	358,515	(40,000)	(10)
其 他 資 產	834,874	1,030,863	195,989	23
資 產 總 額	5,555,500	5,373,668	(181,832)	(3)
流 動 負 債	1,079,483	932,568	(146,915)	(14)
非 流 動 負 債	251,918	361,677	109,759	44
負 債 總 額	1,331,401	1,294,245	(37,156)	(3)
股 本	2,261,682	2,261,682	0	0
資 本 公 積	142,309	142,309	0	0
保 留 盈 餘	1,832,565	1,680,336	(152,229)	(8)
股 東 權 益 總 額	4,224,099	4,079,423	(144,676)	(3)
重大變動項目說明：				
1、其他資產及非流動負債較 107 年度期末增加，主要係使用權資產及租賃負債增加所致。				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	107 年度	108 年度	增(減)金額	變 動 比例%
營業收入淨額	4,862,807	4,584,105	(278,702)	(5.73)
營業成本	2,455,833	2,348,390	(107,443)	(4.38)
營業毛利	2,406,974	2,235,715	(171,259)	(7.12)
減:未實現銷貨利益之變動	12,624	(17,754)	(30,378)	(240.64)
已實現營業毛利	2,394,350	2,253,469	(140,881)	(5.88)
營業費用	1,283,620	1,266,731	(16,889)	(1.32)
營業利益	1,110,730	986,738	(123,992)	(11.16)
營業外收入及利益	134,859	81,078	(53,781)	(39.88)
稅前淨利	1,245,589	1,067,816	(177,773)	(14.27)
所得稅利益(費用)	(175,223)	(145,503)	(29,720)	(16.96)
本期淨利	1,070,366	922,313	(148,053)	(13.83)
其他綜合損益(稅後淨額)	(76,197)	1,233	77,430	101.62
本期綜合損益總額	<u>994,169</u>	<u>923,546</u>	<u>(70,623)</u>	(7.10)
本期淨利歸屬母公司業主	1,063,990	914,902	(149,088)	(14.01)
本期淨利歸屬非控制權益	6,376	7,411	1,035	16.23
綜合損益歸屬母公司業主	987,931	916,486	(71,445)	(7.23)
綜合損益歸屬非控制權益	6,238	7,060	822	13.18

增減比例變動分析說明：

- 1、聯屬公司間未實現銷貨利益較 107 年度減少，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益較 107 年度減少所致。
- 2、營外外收入及利益較 107 年度減少，主要係採用權益法認列之關聯企業利益之份額減少所致。
- 3、其他綜合損益較 107 年度增加，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益增加所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 108 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,517,632	899,149	(1,410,785)	1,005,996	—	—
108 年度現金流量變動情形分析：					
1、營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2、投資活動：存放三個月以上定存增加，致產生投資活動淨現金流出。					
3、籌資活動：發放股東現金紅利，致產生籌資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,005,996	900,000	(950,000)	955,996	—	—
109 年現金流量情形分析：					
1、營業活動：係預期營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2、籌資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利，致產生籌資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，108 年度依權益法認列之投資收益淨額為 73,241 仟元。

1. 轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
2. 未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1)業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2)除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3)開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。
- 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電產品、健康量測、安全防護、電腦週邊、工業控制、車用電子、儀表顯示等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 15%~20%作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20%作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並

且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。

2.本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.資訊系統損害對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司由資訊整合處負責全公司資訊安全規劃，並依據資訊安全政策以控管及維持公司營運及會計等重要運作的功能，定期向總經理室報告執行情形。

控管作業如下：

(1)端點保護：端點指的是個人電腦與伺服器，其保護機制有：

A.防毒軟體：在個人電腦與伺服器安裝防毒軟體，以攔阻病毒與惡意程式，亦阻擋員工瀏覽惡意網站、釣魚網站等。

B.保持更新：作業系統與軟體的漏洞為資安問題的根本原因之一，保持作業系統與軟體的隨時更新，以有效降低漏洞與風險。

(2)網路保護：

A.新世代防火牆：因應越來越嚴峻的資安挑戰，傳統的防火牆已不敷使用，本公司引進新世代的防火牆，可依照應用程式類型來控管，更加安全。亦包含入侵預防系統，可監視網路或網路裝置的網路資料傳輸行為的電腦網路安全裝置，能夠即時的中斷、調整或隔離一些不正常或是具有傷害性的網路資料傳輸行為。

B.郵件保護：郵件寄到公司伺服器前，會先經過中華電信「郵件守門員」，可篩選掉垃圾、有病毒、勒索等郵件。

C.防駭機制：引進 FireEye 威脅防護平台(Threat Prevention Platform)，此為專為對抗網路犯罪及 APT 滲透攻擊(advanced persistent threat)所打造的防護解決方案，可提供應對高階網路威脅的自動威脅取證及動態惡意軟體防護服務。

(3)資料保護：

- A.備份資料：重要資料透過備份系統，每天晚上備份，本公司採用的備份媒體為硬碟，備份速度快且能卻可確保備份資料一定能還原。
- B.異地備份：透過網路與備份系統的 NetBackup Auto Image Replication 機制，在備份完成後立即將備份資料傳送一份到異地。

(4)健檢機制：

- A.自我檢測：每半年透過弱掃軟體來掃描伺服器，以找出伺服器的安全漏洞，並解決漏洞。
- B.委外檢測：與資安顧問公司合作，每年不定期透過網路收集封包、分析，以確保公司內的伺服器的安全；內部網路部份則配置 Deep Discovery Advisor(DDI)，對內部網路的可疑行為進行分析。若有資安問題可進而再向資安顧問小組請求協助，由熟悉 APT 攻擊的專家依據偵測、分析資料來鑑識，以處理之。

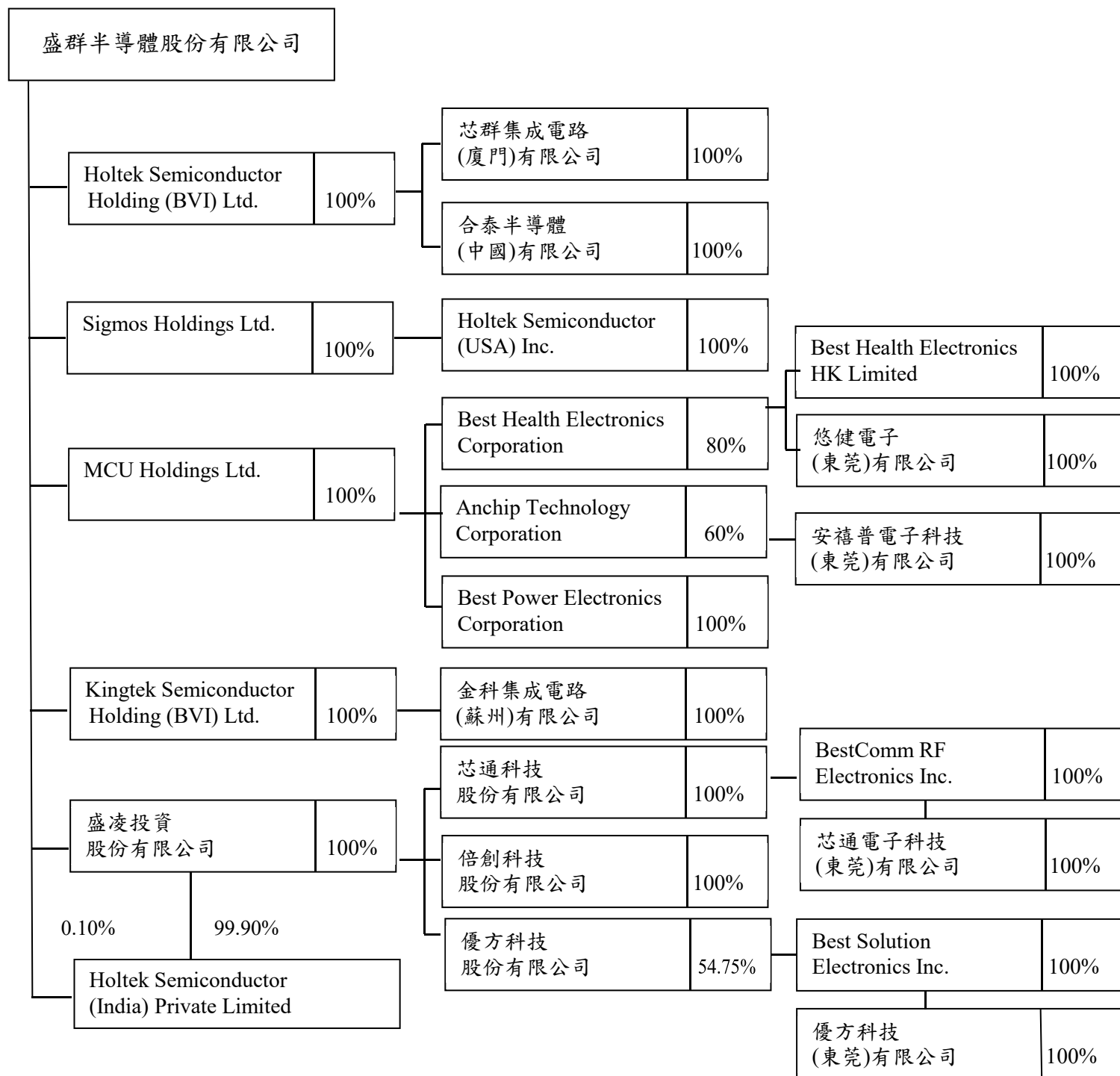
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1.關係企業組織圖



(二)關係企業基本資料

日期：108 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$15,253,360	投資海外各項事業
Sigmos Holdings Ltd.	89.12		US\$200,000	
MCU Holdings Ltd.	91.05		US\$500,000	
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01		US\$2,000,000	
盛凌投資(股)公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$429,826,000	專營投資業務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.02	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	US\$3,500,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
合泰半導體(中國)有限公司	101.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	RMB\$62,000,000	積體電路買賣及技術服務
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	90.05	19 Hammond, Suite 513, Irvine, CA 92618, USA	US\$200,000	積體電路買賣及技術服務
Best Health Electronics Corporation	106.06	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$6,000,000	投資海外各項事業
悠健電子(東莞)有限公司	106.09	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 301	RMB\$5,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
Best Health Electronics HK Limited	108.09	15/F., BOC Group Life Assurance Tower 136 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong	RMB\$300,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
Anchip Technology Corporation	104.11	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$1,000,000	投資海外各項事業
安禧普電子科技(東莞)有限公司	105.11	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 401	RMB\$300,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
Best Power Electronics Corporation	107.05	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$2,000,000	投資海外各項事業
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	蘇州工業園區星漢街 5 號 D 幢 3 樓 7/8 單元	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
芯通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$40,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
BestComm RF Electronics Inc.	103.03	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$3,000,000	投資海外各項事業
芯通電子科技(東莞)有限公司	107.01	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 201	RMB\$2,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
倍創科技(股)公司	105.05	新竹市金山十一街 20 巷 18 號 1 樓	NT\$10,000,000	MCU 模組之銷售及技術服務
優方科技(股)公司	97.05	臺北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2	NT\$20,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Best Solution Electronics Inc.	97.08	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$200,000	投資海外各項事業
優方科技(東莞)有限公司	108.10	中國東莞市松山湖園區新竹路 4 號 9 棟 407 室、408 室	RMB\$1,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	107.04	1004, 10 th Floor, Prestige Meridian 1, MG Road Bengaluru – 560001	INR\$6,485,000	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務及一般投資業務。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：108 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	15,253,360	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
Sigmos Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	200,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：林正鋒		
MCU Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	500,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：林正鋒		
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
盛凌投資(股)公司	董事長	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	42,982,600	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：張治		
	監察人	盛群半導體(股)公司代表人：廖明通		
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	6,485,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：蔡榮宗		
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：古旭納		
	總經理	蔡榮宗	-	-
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	張家志	-	-
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：蔡榮宗		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	蔡榮宗	-	-
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：高國棟	200,000	100%
	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：蔡榮宗		
	總經理	王耀德	-	-
Best Health Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：林正鋒	4,800	80%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
Anchip Technology Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤	600	60%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：周玲娜	400	40%
	董 事	毛強		
Best Health Electronics HK Limited	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：王明坤	300,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
悠健電子(東莞)有限公司	董事長	Best Health Electronics Corporation 代表人：洪祥歲	-	100%
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：高國棟		
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：王明坤		
	監察人	Best Health Electronics Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	洪祥歲	-	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	董事長	Anchip Technology Corporation 代表人：毛強	-	100%
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：王明坤		
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：周玲娜		
	監察人	Anchip Technology Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	毛強	-	-
Best Power Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：林正鋒	2,000	100%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	-	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇		
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	監察人	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	高國棟	-	-
芯通科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	4,000,000	100%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：王明坤		
	監察人	盛凌投資(股)公司代表人：廖明通		
	總經理	李文義	-	-
BestComm RF Electronics Inc.	董 事	芯通科技(股)公司代表人：吳啟勇	30,000	100%
	董 事	芯通科技(股)公司代表人：王明坤		
芯通電子科技(東莞)有限公司	董事長	BestComm RF Electronics Inc.代表人：李文義	-	100%
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：高國棟		
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：王明坤		
	監察人	BestComm RF Electronics Inc.代表人：廖明通		
	總經理	蕭見通	-	-
倍創科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	1,000,000	100%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：蔡榮宗		
	監察人	盛凌投資(股)公司代表人：廖明通		
	總經理	葉秉霖	-	-
優方科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	800,000	40%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：王明坤		
	董 事	欣宏電子(股)公司代表人：林既貴	737,500	36.875%
	監察人	新耕投資有限公司代表人：周玲娜	212,500	10.625%
	總經理	樂正平	125,000	6.25%
Best Solution Electronics Inc.	董 事	優方科技(股)公司代表人：王明坤	200,000	100%
優方科技(東莞)有限公司	董事長	Best Solution Electronics Inc.代表人：樂正平	-	100%
	董 事	Best Solution Electronics Inc.代表人：王明坤		
	董 事	Best Solution Electronics Inc.代表人：林既貴		
	監察人	Best Solution Electronics Inc.代表人：廖明通		
	總經理	樂正平	-	-

(六)關係企業營運概況

日期：108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	475,831	608,165	0	608,165	411,096	(92)	94,549	6.20
芯群集成電路(廈門)有限公司	113,551	259,168	140,004	119,164	418,878	10,726	10,359	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	879,687	482,793	396,894	1,045,110	92,518	84,616	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	23,030	0	23,030	0	0	798	3.99
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	6,898	23,774	744	23,030	25,477	904	798	0.40
MCU Holdings Ltd.	16,333	710,248	0	710,248	0	(115)	73,761	147.52
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	127,433	0	127,433	0	0	11,287	5.64
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	272,883	145,489	127,394	412,191	12,720	11,288	註 2
盛凌投資(股)公司	429,826	507,793	60	507,733	0	(2)	7,625	0.18
優方科技(股)公司	20,000	62,080	23,424	38,656	77,901	9,993	10,644	5.32
優方科技(東莞)有限公司	4,284	4,928	2,466	2,462	0	(1,823)	(1,823)	註 2
Best Solution Electronics Inc.	6,140	26,748	0	26,748	266,498	6,058	3,625	18.13
芯通科技(股)公司	40,000	16,391	2,604	13,787	6,110	(3,228)	(7,824)	(1.96)
BestComm RF Electronics Inc.	14,054	6,189	0	6,189	9,442	890	(4,548)	(151.60)
芯通電子科技(東莞)有限公司	9,214	3,313	2,258	1,055	4,850	(5,254)	(5,246)	註 2
倍創科技(股)公司	10,000	9,719	699	9,020	4,656	(880)	(875)	(0.88)
Anchip Technology Corporation	5,071	7,817	0	7,817	19,730	2,727	3,891	3,891.04
安禧普電子科技(東莞)有限公司	1,521	11,047	9,432	1,615	25,082	977	980	註 2
Best Health Electronics Corporation	26,410	30,686	0	30,686	71,013	8,350	5,195	865.78
悠健電子(東莞)有限公司	23,057	21,536	11,894	9,642	30,352	(5,153)	(5,118)	註 2
Best Health Electronics HK Limited	1,299	3,764	695	3,069	5,583	1,795	1,796	5.99
Best Power Electronics Corporation	8,844	8,746	0	8,746	0	(39)	149	74.37
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	2,948	1,840	357	1,483	3,561	(205)	(121)	(0.02)

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，108.12.31 兌美元 29.97、人民幣 4.277；印度盧比 0.4209。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

(七)關係企業合併財務報表：請參閱本年報第 85 頁。

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

附錄一：

108 年度合併財務報告及會計師查核報告

聲 明 書

本公司民國一〇八年度(自一〇八年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董 事 長：吳啟勇



日 期：民國一〇九年二月五日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司及其子公司(盛群集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如合併財務報告附註三(一)所述，盛群半導體股份有限公司及其子公司於民國一〇八年一月一日首次適用國際財務報導準則公報第十六號「租賃」，並採用修正式追溯法無須重編比較期間資訊。本會計師未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群集團民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳合併財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列一關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群集團是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五。相關說明請詳合併財務報告附註六(五)(重要會計項目說明—存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群集團評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群集團既訂之會計政策；執行存貨備抵跌價提列之回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

其他事項

盛群半導體股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群集團民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

游萬勛



曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號

民國一〇九年二月十四日

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併財務報告

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 4,584,105	100	4,862,807	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十六)、七及十二)	2,348,390	51	2,455,833	51
營業毛利	2,235,715	49	2,406,974	49
5910 未實現銷貨利益之變動	(17,754)	-	12,624	-
已實現營業毛利	2,253,469	49	2,394,350	49
營業費用(附註六(十二)及(十六)及十二)：				
6100 推銷費用	121,421	3	115,839	2
6200 管理費用	355,351	8	381,627	8
6300 研究發展費用	793,025	17	783,088	16
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(四))	(3,066)	-	3,066	-
	1,266,731	28	1,283,620	26
營業淨利	986,738	21	1,110,730	23
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	(6,449)	-	15,471	1
7060 採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(七))	73,241	2	97,105	2
7100 利息收入	15,666	-	14,568	-
7130 股利收入	-	-	7,715	-
7510 利息費用(附註六(十))	(1,380)	-	-	-
	81,078	2	134,859	3
稅前淨利	1,067,816	23	1,245,589	26
7950 所得稅費用(附註六(十三))	145,503	3	175,223	4
本期淨利	922,313	20	1,070,366	22
其他綜合損益：				
8300 不重分類至損益之項目				
8310 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	(5,175)	-	(5,618)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	37,144	1	(58,603)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(1,035)	-	(1,124)	-
	33,004	1	(63,097)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(25,369)	(1)	(16,569)	-
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(14,257)	-	(521)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(7,855)	-	(3,990)	-
	(31,771)	(1)	(13,100)	-
8300 本期其他綜合損益	1,233	-	(76,197)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 923,546	20	\$ 994,169	21
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	914,902	20	1,063,990	22
8620 非控制權益	7,411	-	6,376	-
	922,313	20	1,070,366	22
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	916,486	20	987,931	21
8720 非控制權益	7,060	-	6,238	-
	923,546	20	994,169	21
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.05		\$ 4.70	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.01		\$ 4.66	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘	合計	國外營運 機構財務 報表換算 之兌換 金額	其他權益 透過其他 綜合損益 按公允價 值衡量之 金融資產 淨額	合計	歸屬於 母公司 業主之 權益總計	非控制 權益	權益總計
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	1,699,004	(31,756)	-	(31,756)	4,071,239	27,607	4,098,846
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	-	-	67,290	67,290	67,290	-	67,290
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	1,699,004	(31,756)	67,290	35,534	4,138,529	27,607	4,166,136
本期淨利	-	-	-	-	1,063,990	1,063,990	-	-	-	1,063,990	6,376	1,070,366
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,494)	(4,494)	(12,962)	(58,603)	(71,565)	(76,059)	(138)	(76,197)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,059,496	1,059,496	(12,962)	(58,603)	(71,565)	987,931	6,238	994,169
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	92,202	-	(92,202)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,445	(7,445)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(104,942)	-	(822,348)	(927,290)	-	-	-	(927,290)	-	(927,290)
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	1,355	1,355	-	(1,355)	(1,355)	-	-	-
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,916)	(8,916)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	737,289	34,399	1,060,877	1,832,565	(44,718)	7,332	(37,386)	4,199,170	24,929	4,224,099
本期淨利	-	-	-	-	914,902	914,902	-	-	-	914,902	7,411	922,313
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,140)	(4,140)	(31,420)	37,144	5,724	1,584	(351)	1,233
本期綜合損益總額	-	-	-	-	910,762	910,762	(31,420)	37,144	5,724	916,486	7,060	923,546
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	106,088	-	(106,088)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,987	(2,987)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(111,275)	-	(951,716)	(1,062,991)	-	-	-	(1,062,991)	-	(1,062,991)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,231)	(5,231)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,102	37,386	910,848	1,680,336	(76,138)	44,476	(31,662)	4,052,665	26,758	4,079,423

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,067,816	1,245,589
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	82,813	57,598
攤銷費用	73,185	55,025
預期信用減損(迴轉利益)損失	(3,066)	3,066
利息費用	1,380	-
利息收入	(15,666)	(14,568)
股利收入	-	(7,715)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(73,241)	(97,105)
聯屬公司間未實現銷貨(損失)利益變動	(17,754)	12,624
其他不影響現金流量之損費淨額	6,092	6,893
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(2,853)	97,382
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)減少(增加)	26,200	(4,751)
存貨增加	(47,553)	(71,144)
其他營業資產增加	(2,435)	(18,577)
應付票據及帳款(減少)增加	(102,845)	19,821
淨確定福利負債減少	(2,798)	(1,953)
其他營業負債(減少)增加	(10,722)	8,904
營運產生之現金流入	978,553	1,291,089
收取之利息	15,469	14,576
收取之股利	55,570	51,763
支付之利息	(1,380)	-
支付之所得稅	(149,063)	(126,976)
營業活動之淨現金流入	899,149	1,230,452
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	2,972
取得採用權益法之投資	(2,741)	-
處分採用權益法之投資	830	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	1,567	-
取得不動產、廠房及設備	(31,873)	(47,892)
處分不動產、廠房及設備	-	797
存出保證金減少(增加)	2,164	(3,320)
其他金融資產增加	(197,621)	(57,110)
其他非流動資產增加	(89,610)	(66,068)
收取之股利	-	7,715
投資活動之淨現金流出	(317,284)	(162,906)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(17,822)	-
發放股東現金股利	(1,062,991)	(927,290)
非控制權益變動	(5,231)	(11,823)
籌資活動之淨現金流出	(1,085,044)	(939,113)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,457)	(2,529)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(511,636)	125,904
期初現金及約當現金餘額	1,517,632	1,391,728
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,005,996	1,517,632

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一〇八年度及一〇七年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇九年二月五日經提報董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇八年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇八年生效之國際財務報導準則編製合併財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會發布之生效日</u>
國際財務報導準則第16號「租賃」	2019年1月1日
國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」	2019年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	2019年1月1日
國際會計準則第19號之修正「計畫修正、縮減或清償」	2019年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	2019年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	2019年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則對合併財務報告未造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

1. 國際財務報導準則第十六號「租賃」

國際財務報導準則第十六號「租賃」(以下簡稱國際財務報導準則第十六號)取代現行國際會計準則第十七號「租賃」(以下簡稱國際會計準則第十七號)、國際財務報導解釋第四號「決定一項安排是否包含租賃」(以下簡稱國際財務報導解釋第四號)、解釋公告第十五號「營業租賃：誘因」及解釋公告第二十七號「評估涉及租賃之法律形式之交易實質」。

合併公司採修正式追溯法過渡至國際財務報導準則第十六號，相關會計政策變動之性質及影響說明如下：

(1) 租賃定義

合併公司先前係依據國際財務報導解釋第四號於合約開始日判斷一項協議是否屬或包含租賃。變更會計政策後則係以國際財務報導準則第十六號之租賃定義評估合約是否屬或包含租賃，會計政策詳附註四(十一)。

過渡至國際財務報導準則第十六號時，合併公司選擇採用權宜作法豁免評估初次適用日前之交易是否為租賃，亦即，將先前已辨識為租賃之合約直接適用國際財務報導準則第十六號之規定。先前已依據國際會計準則第十七號及國際財務報導解釋第四號辨識非屬租賃之合約則不再重新評估是否為租賃。因此，國際財務報導準則第十六號所規定之租賃定義僅適用於初次適用日及之後所簽訂或變更之合約。

(2) 承租人

合併公司為承租人之交易，先前係依據租賃合約是否已移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬評估其分類。於國際財務報導準則第十六號下，則針對租賃合約於資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。

合併公司選擇將承租公務車及員工宿舍等適用短期租賃及低價值資產之認列豁免。

先前於國際會計準則第十七號下分類為營業租賃之合約於過渡時，租賃負債係以剩餘租賃給付現值衡量，並使用初次適用日合併公司增額借款利率折現。使用權資產則以租賃負債之金額，調整與該租賃有關之所有預付或應付之租賃給付金額衡量。

此外，合併公司採用以下權宜作法過渡至國際財務報導準則第十六號：

- a. 針對具有類似特性之租賃組合採用單一折現率。
- b. 依其於初次適用日前刻依據國際會計準則第三十七號「負債準備、或有負債及或有資產」有關虧損性合約之評估結果，作為對使用權資產減損評估之替代方法。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- c.針對租賃期間於初次適用日後12個月內結束之租賃，適用豁免而不認列使用權資產及租賃負債。
- d.不將原始直接成本計入初次適用日之使用權資產衡量中。
- e.於租賃合約包含租賃延長或終止選擇權下，決定租賃期間時，採用後見之明。

(3)出租人

合併公司無須針對其為出租人之交易於過渡至國際財務報導準則第十六號時進行任何調整，而係自初次適用日起適用國際財務報導準則第十六號處理其出租交易。

(4)對財務報告之影響

過渡至國際財務報導準則第十六號時，合併公司於初次適用日認列使用權資產及租賃負債之金額均為105,155千元。租賃負債係以合併公司初次適用日之增額借款利率將租賃給付折現，所使用之利率其加權平均數為1.4%。

初次適用日之前一年度揭露之營業租賃承諾金額與初次適用日認列之租賃負債金額調節如下：

	108.1.1
107.12.31合併財務報告揭露之營業租賃承諾金額	\$ 49,870
認列豁免：	
短期租賃	(4,250)
可合理確定將行使之租賃延長或終止之選擇權	71,165
	\$ 116,785
以108.1.1增額借款利率折現後之金額	\$ 105,155
107.12.31認列之融資租賃負債金額	-
於108.1.1認列之租賃負債金額	\$ 105,155

2.國際財務報導解釋第二十三號「所得稅務處理之不確定性」

新解釋闡明於評估具不確定性之租稅處理對課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率之影響時，應假設租稅主管機關將依法審查相關金額，並且於審查時已取得所有相關資訊。

若評估後認為租稅主管機關很有可能接受一項具不確定性之租稅處理，則應以與租稅申報時所使用之處理一致之方式決定課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率；反之，若並非很有可能，則得以最有可能金額或期望值兩者較適用者，反映每一項具不確定性之租稅處理之影響。

適用新準則對合併公司並無重大影響。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇八年七月二十九日金管證審字第1080323028號令，公開發行以上公司應自民國一〇九年起全面採用經金管會認可並於民國一〇九年生效之國際財務報導準則。國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報導準則第7號之修正「利率指標變革」	2020年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大之定義」	2020年1月1日
合併公司評估適用上述新認可之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大變動。	

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

理事會已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日
合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。	

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

(二)編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

(1)依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- (2)依公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值金融資產；及
(3)淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2.功能性貨幣及表達貨幣

合併公司每一個體均係以各營運所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2.列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			108.12.31	107.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 %	100 %
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	投資控股公司	80 %	80 %
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Best Health	Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	製造及銷售與技術服務	100 % (註1)	- % (註1)
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	投資控股公司	60 %	60 %
Anchip	安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
MCU	Best Power Electronics Corp. (Best Power)	投資控股公司	100 % (註2)	100 % (註2)
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			108.12.31	107.12.31
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	製造及銷售與技術服務	100 % (註3)	100 % (註3)
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註4)	54.75 % (註4)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	投資控股公司	100 %	100 %
Best Solution	優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	製造及銷售與技術服務	100 % (註5)	- % (註5)
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	芯通科技股份有限公司(芯通)	製造及銷售與技術服務	100 % (註6)	100 % (註6)
芯通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	投資控股公司	100 %	100 %
BestComm	芯通電子科技(東莞)有限公司(芯通東莞)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %

註1：合併公司於民國一〇八年第三季設立之100%子公司。

註2：合併公司於民國一〇七年第三季設立之100%子公司。

註3：係盛凌投資持有99.9%股權及盛群持有0.1%股權。

註4：係盛凌直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

註5：合併公司於民國一〇八年第四季設立之100%子公司

註6：係盛通科技於民國一〇八年八月變更公司名稱。

3.未列入合併財務報告之子公司：無。

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。於後續每一報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

對國外營運機構之貨幣性應收或應付項目，若尚無清償計畫且不可能於可預見之未來予以清償時，其所產生之外幣兌換損益視為對該國外營運機構淨投資之一部分而認列為其他綜合損益。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具

應收帳款及所發行之債務證券原始係於產生時認列。所有其他金融資產及金融負債原始係於合併公司成為金融工具合約條款之一方時認列。非透過損益按公允價值衡量之金融資產(除不包含重大財務組成部分之應收帳款外)或金融負債原始係按公允價值加計直接可歸屬於該取得或發行之交易成本衡量。不包含重大財務組成部分之應收帳款原始係按交易價格衡量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

1. 金融資產

金融資產之購買或出售符合慣例交易者，合併公司對以相同方式分類之金融資產，其所有購買及出售一致地採交易日或交割日會計處理。

原始認列時，金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。合併公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始自下一個報導期間之首日起重分類所有受影響之金融資產。

(1) 按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

該等資產後續以原始認列金額加減計採有效利息法計算之累積攤銷數，並調整任何備抵損失之攤銷後成本衡量。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。

(2) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

合併公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資後續公允價值變動列報於其他綜合損益。前述選擇係按逐項工具基礎所作成。

屬權益工具投資者後續按公允價值衡量。股利收入(除非明顯代表部分投資成本之回收)係認列於損益。其餘淨利益或損失係認列為其他綜合損益且不重分類至損益。

權益投資之股利收入於合併公司有權利收取股利之日認列(通常係除息日)。

(3) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。合併公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

該等資產後續按公允價值衡量，其淨利益或損失(包含利息收入)係認列為損益。

持有供交易及以公允價值基礎管理並評估績效之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(4)金融資產減損

合併公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，合併公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據合併公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若合約款項逾期超過九十天，合併公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予合併公司時，合併公司視為該金融資產發生違約。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，合併公司視為該債務證券之信用風險低。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

衡量預期信用損失之最長期間為合併公司暴露於信用風險之最長合約期間。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即合併公司依據合約可收取之現金流量與合併公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除。

當合併公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。對公司戶，合併公司係以是否合理預期可回收之基礎個別分析沖銷之時點及金額。合併公司預期已沖銷金額將不會重大迴轉。然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合合併公司回收逾期金額之程序。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業，或既未移轉亦未保留所有權之幾乎所有風險及報酬且未保留該金融資產之控制時，始將金融資產除列。

合併公司簽訂移轉金融資產之交易，若保留已移轉資產所有權之所有或幾乎所有風險及報酬，則仍持續認列於資產負債表。

2.金融負債

(1)負債之分類

合併公司發行之債務係依據合約協議之實質與金融負債定義分類為金融負債。

(2)金融負債

金融負債係分類為攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。金融負債若屬持有供交易、衍生工具或於原始認列時指定，則分類為透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係以公允價值衡量，且相關淨利益及損失，包括任何利息費用，係認列於損益。

其他金融負債後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。利息費用及兌換損益係認列於損益。除列時之任何利益或損失亦係認列於損益。

(3)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。當金融負債條款修改且修改後負債之現金流量有重大差異，則除列原金融負債，並以修改後條款為基礎按公允價值認列新金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司目前有法律上有可執行之權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(九)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，僅在非關係人投資者對關聯企業之權益範圍內，認列於企業財務報表。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

合併公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備項目係依成本(包括資本化之借款成本)減累計折舊及任何累計減損衡量。

不動產、廠房及設備之重大組成部分耐用年限不同時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分利益或損失係認列於損益。

2.後續成本

後續支出僅於其未來經濟效益很有可能流入合併公司時始予以資本化。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值計算，並採直線法於每一組成部分之估計耐用年限內認列於損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築：20~40年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司於每一報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，並於必要時適當調整。

(十一)租賃

民國一〇八年一月一日開始適用

1.租賃之判斷

合併公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。為評估合約是否係屬租賃，合併公司針對以下項目評估：

- (1)該合約涉及使用一項已辨認資產，該已辨認資產係於合約中被明確指定或藉由於可供使用之時被隱含指定，其實體可區分或可代表實質所有產能。若供應者具有可替換該資產之實質性權利，則該資產並非已辨認資產；且
- (2)於整個使用期間具有取得來自使用已辨認資產之幾乎所有經濟效益之權利；且
- (3)於符合下列情況之一時，取得主導已辨認資產之使用之權利：
 - 客戶在整個使用期間具有主導已辨認資產之使用方式及使用目的之權利。
 - 有關該資產之使用方式及使用目的之攸關決策係預先決定，且：
 - 客戶在整個使用期間具有操作該資產之權利，且供應者並無改變該等操作指示之權利；或
 - 客戶設計該資產之方式已預先決定其整個使用期間之使用方式及使用目的。

於租賃成立日或重評估合約是否包含租賃時，合併公司係以相對單獨價格為基礎將合約中之對價分攤至個別租賃組成部份。惟，於承租土地及建物時，合併公司選擇不區分非租賃組成部分而將租賃組成部分及非租賃組成部分視為單一租賃組成部分處理。

2.承租人

合併公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，合併公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用合併公司之增額借款利率。一般而言，合併公司係採用其增額借款利率為折現率。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1)固定給付，包括實質固定給付；
- (2)取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3)預期支付之殘值保證金額；及
- (4)於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1)用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2)預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3)標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4)對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5)租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

合併公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對公務車及員工宿舍租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，合併公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

3.出租人

合併公司為出租人之交易，係於租賃成立日將租賃合約依其是否移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬分類，若是則分類為融資租賃，否則分類為營業租賃。於評估時，合併公司考量包括租賃期間是否涵蓋標的資產經濟年限之主要部分等相關特定指標。

若協議包含租賃及非租賃組成部分，合併公司使用國際財務報導準則第十五號之規定分攤合約中之對價。

民國一〇七年十二月三十一日以前適用

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十二)無形資產

1.認列及衡量

研究活動相關支出於發生時認列為損益。

發展支出僅於其能可靠衡量、產品或流程之技術或商業可行性已達成、未來經濟效益很有可能流入合併公司，及合併公司意圖且具充足資源以完成該發展且加以使用或出售該資產時，始予以資本化。其他發展支出則於發生時認列於損益。原始認列後，資本化之發展支出以其成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。

合併公司取得其他有限耐用年限之無形資產，係以成本減除累計攤銷與累計減損後之金額衡量。

2.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產之未來經濟效益時始予以資本化。

3.攤銷

攤銷係依資產成本減除估計殘值計算，並自無形資產達可供使用狀態起，按直線法於其估計耐用年限內認列為損益。

合併公司於每一報導日檢視無形資產之攤銷方法、耐用年限及殘值，並於必要時，適當調整。

(十三)非金融資產減損

合併公司於每一報導日評估是否有跡象顯示非金融資產(除存貨及遞延所得稅資產外)之帳面金額可能有減損。若有任一跡象存在，則估計該資產之可回收金額。

為減損測試之目的，係將現金流入大部分獨立於其他個別資產或資產群組之現金流入之一組資產作為最小可辨認資產群組。企業合併取得之商譽係分攤至預期可自合併綜效受益之各現金產生單位或現金產生單位群組。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則認列減損損失。

商譽以外之非金融資產則僅在不超過該資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)之範圍內迴轉。

(十四)收入認列

客戶合約之收入

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。合併公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。合併公司依主要收入項目說明如下：

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

1.銷售商品

合併公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。合併公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或合併公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

合併公司於交付商品時認列應收帳款，因合併公司在該時點具無條件收取對價之權利。

2.財務組成部分

合併公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，合併公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供服務期間內認列為費用。

2.確定福利計畫

合併公司對確定福利計畫之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或以前期間服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算，並減除任何計畫資產之公允價值。

確定福利義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司可能有利時，認列資產係以從該計畫退還提撥金或對該計畫減少未來提撥金之形式可得之任何經濟效益之現值為限。計算經濟效益現值時，係考量任何最低資金提撥要求。

淨確定福利負債之再衡量數包含精算損益、計畫資產報酬(不包括利息)，及資產上限影響數之任何變動(不包括利息)係立即認列於其他綜合損益，並累計於保留盈餘。合併公司決定淨確定福利負債之淨利息費用，係使用年度報導期間開始時所決定之淨確定福利負債及折現率。確定福利計畫之淨利息費用及其他費用係認列於損益。

計畫修正或縮減時，所產生與前期服務成本或縮減利益或損失相關之福利變動數，係立即認列為損益。合併公司於清償發生時，認列確定福利計畫之清償損益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.短期員工福利

短期員工福利義務係於服務提供時認列為費用。若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)所得稅

所得稅包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括依據當年度課稅所得(損失)計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅或應收退稅款之調整。其金額係按報導日之法定稅率或實質性立法之稅率衡量預期將支付或收取款項之最佳估計值。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期暫時性差異迴轉時之稅率衡量，採用報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減；或在變成很有可能有足夠課稅所得之範圍內迴轉原已減少之金額。

(十七)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十八)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際財務報導準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，合併公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(五)。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。合併公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

合併公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。

衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十九)金融工具。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
現金及活期存款	\$ 377,517	355,036
定期存款	<u>628,479</u>	<u>1,162,596</u>
	<u><u>\$ 1,005,996</u></u>	<u><u>1,517,632</u></u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
受益憑證	<u>\$ 491,203</u>	<u>486,555</u>

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少3,930千元及3,892千元。

(三)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
未上市(櫃)公司股票		
Unitech Capital Inc. (Unitech)	\$ 68,627	60,848
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	206,714	161,110
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	<u>26,964</u>	<u>43,203</u>
	<u><u>\$ 302,305</u></u>	<u><u>265,161</u></u>

合併公司持有該等權益工具投資為長期策略性投資且非為交易目的所持有，故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

合併公司於民國一〇七年度出售部分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，處分價款2,972千元，處分時累計評價利益為1,355千元，已自其他權益轉至保留盈餘。

合併公司於民國一〇八度及一〇七年度收取之股利收入分別為0千元及7,715千元。

信用風險及市場風險資訊請詳附註六(十九)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	108.12.31	107.12.31
應收票據	\$ 1,122	278
應收帳款	103,959	107,785
應收關係人款	692,373	749,789
	797,454	857,852
減：備抵損失	(7,393)	(10,459)
	<u>\$ 790,061</u>	<u>847,393</u>

合併公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。合併公司應收款項之預期信用損失分析如下：

	108.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 785,756	0.5%~1.5%	6,808
逾期90天以下	11,698	5%	585
合計	<u>\$ 797,454</u>		<u>7,393</u>

	107.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 840,254	0.5%~1.5%	7,232
逾期90天以下	3,215	5%	161
合計	<u>\$ 843,469</u>		<u>7,393</u>

民國一〇七年十二月三十一日因個別客戶應收帳款14,383千元，經評估有違約風險，故針對該客戶提列3,066千元預期信用損失；截至民國一〇八年十二月三十一日，該客戶業已依付款計畫支付款項，故迴轉3,066千元之預期信用損失。

合併公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	108年度	107年度
期初餘額	\$ 10,459	7,393
認列之減損損失	-	3,066
減損損失迴轉	(3,066)	-
期末餘額	<u>\$ 7,393</u>	<u>10,459</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)存貨

	108.12.31	107.12.31
原料及物料	\$ 200,819	179,234
在製品	328,445	285,285
製成品及商品	<u>153,345</u>	<u>190,347</u>
	<u><u>\$ 682,609</u></u>	<u><u>654,866</u></u>

營業成本組成明細如下：

	108年度	107年度
銷貨成本	\$ 2,342,531	2,448,406
報廢成本	<u>5,859</u>	<u>7,427</u>
	<u><u>\$ 2,348,390</u></u>	<u><u>2,455,833</u></u>

(六)其他金融資產－流動

	108.12.31	107.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 955,724	760,610
受限制銀行存款	5,218	3,712
其他	<u>25,904</u>	<u>19,853</u>
	<u><u>\$ 986,846</u></u>	<u><u>784,175</u></u>

合併公司於民國一〇八年度及一〇七年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十九)。

(七)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	108.12.31	107.12.31
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 551,476	550,555
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(83,786)</u>	<u>(101,540)</u>
	<u><u>\$ 467,690</u></u>	<u><u>449,015</u></u>

合併公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於合併公司之合併財務報告中所包含之金額：

	108年度	107年度
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之份額：		
繼續營業單位本期淨利	\$ 73,241	97,105
其他綜合損益	<u>(14,257)</u>	<u>(521)</u>
綜合損益總額	<u><u>\$ 58,984</u></u>	<u><u>96,584</u></u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(八)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國108年1月1日餘額	\$ 26,676	515,972	382,617	87,215	1,012,480
增添	-	1,648	17,154	13,071	31,873
減少	-	-	(67,731)	(2,008)	(69,739)
匯率變動之影響及重分類	-	(9,322)	(2,327)	(1,655)	(13,304)
民國108年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>508,298</u>	<u>329,713</u>	<u>96,623</u>	<u>961,310</u>
民國107年1月1日餘額	\$ 26,676	517,847	355,953	84,913	985,389
增添	-	3,319	39,941	4,632	47,892
減少	-	-	(10,811)	(1,374)	(12,185)
匯率變動之影響	-	(5,194)	(2,466)	(956)	(8,616)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>515,972</u>	<u>382,617</u>	<u>87,215</u>	<u>1,012,480</u>
累計折舊：					
民國108年1月1日餘額	\$ -	242,666	306,307	64,992	613,965
本期折舊	-	24,218	28,941	11,334	64,493
減少	-	-	(66,680)	(1,883)	(68,563)
匯率變動之影響	-	(2,541)	(3,216)	(1,343)	(7,100)
民國108年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>264,343</u>	<u>265,352</u>	<u>73,100</u>	<u>602,795</u>
民國107年1月1日餘額	\$ -	221,227	293,422	56,011	570,660
本期折舊	-	22,669	24,115	10,814	57,598
減少	-	-	(9,658)	(1,157)	(10,815)
匯率變動之影響	-	(1,230)	(1,572)	(676)	(3,478)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>242,666</u>	<u>306,307</u>	<u>64,992</u>	<u>613,965</u>
帳面價值：					
民國108年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>243,955</u>	<u>64,361</u>	<u>23,523</u>	<u>358,515</u>
民國107年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>273,306</u>	<u>76,310</u>	<u>22,223</u>	<u>398,515</u>
民國107年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>296,620</u>	<u>62,531</u>	<u>28,902</u>	<u>414,729</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(九)使用權資產

合併公司承租土地與房屋及建築等之成本及折舊，其變動明細如下：

	土 地	房屋及 建 築	總 計
使用權資產成本：			
民國108年1月1日餘額	\$ -	-	-
追溯適用IFRS16之影響數	67,341	37,814	105,155
增 添	-	5,601	5,601
減 少	-	(617)	(617)
民國108年12月31日餘額	<u>\$ 67,341</u>	<u>42,798</u>	<u>110,139</u>
使用權資產之折舊：			
民國108年1月1日餘額	\$ -	-	-
本期折舊	3,061	15,259	18,320
減 少	-	(254)	(254)
民國108年12月31日餘額	<u>\$ 3,061</u>	<u>15,005</u>	<u>18,066</u>
帳面價值：			
民國108年12月31日	<u>\$ 64,280</u>	<u>27,793</u>	<u>92,073</u>

合併公司於民國一〇七年度以營業租賃承租土地及辦公室，請詳附註六(十一)。

(十)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	108.12.31
流動	<u>\$ 18,985</u>
非流動	<u>\$ 73,586</u>

到期分析請詳附註六(十九)。

認列於損益之金額如下：

	108年度
租賃負債之利息費用	<u>\$ 1,380</u>
短期租賃之費用	<u>\$ 7,492</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	<u>\$ 695</u>

認列於現金流量表之金額如下：

	108年度
租賃之現金流出總額	<u>\$ 27,389</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

土地、房屋及建築之租賃

合併公司民國一〇八年十二月三十一日承租土地與房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至五年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅合併公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十一)營業租賃

- 1.合併公司於民國一〇七年十二月三十一日依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	<u>107.12.31</u>
一年內	\$ 22,581
一年至二年	18,640
二年以上	<u>8,649</u>
	<u>\$ 49,870</u>

- 2.合併公司廠房之土地係向科學園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇七年二月起租金每年約為3,558千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(十二)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 132,272	127,611
計畫資產之公允價值	<u>(52,542)</u>	<u>(51,009)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 79,730</u>	<u>76,602</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計52,542千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度確定福利義務現值變動如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 127,611	123,354
計畫支付之福利	(3,581)	(4,234)
當期服務成本及利息	1,275	1,480
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損失	4,703	3,225
— 因經驗變動所產生之精算損(益)	<u>2,264</u>	<u>3,786</u>
12月31日確定福利義務	<u><u>\$ 132,272</u></u>	<u><u>127,611</u></u>

(3)計畫資產公允價值之變動

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 51,009	50,416
計畫支付之福利	(3,581)	(4,234)
利息收入	524	622
已提撥至計畫之金額	2,798	2,812
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	<u>1,792</u>	<u>1,393</u>
12月31日計畫資產之公允價值	<u><u>\$ 52,542</u></u>	<u><u>51,009</u></u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(4)認列為損益之費用

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度認列為損益之費用如下：

	108年度	107年度
淨確定福利負債之淨利息	\$ <u>751</u>	<u>858</u>
營業成本	\$ 48	57
推銷費用	59	65
管理費用	115	152
研究發展費用	<u>529</u>	<u>584</u>
	\$ <u>751</u>	<u>858</u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	108年度	107年度
1月1日累積餘額	\$ 21,503	15,885
本期認列	<u>5,175</u>	<u>5,618</u>
12月31日累積餘額	\$ <u>26,678</u>	<u>21,503</u>

(6)精算假設

合併公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	108.12.31	107.12.31
折現率	0.70 %	1.00 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

合併公司預計於民國一〇八年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,870千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為11.8年。

(7)敏感度分析

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日，當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加0.5%	減少0.5%
108年12月31日		
折現率	\$ <u>(7,717)</u>	<u>8,351</u>
未來薪資成長率	\$ <u>7,552</u>	<u>(7,084)</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
107年12月31日		
折現率	\$ (15,127)	17,814
未來薪資成長率	\$ 16,056	(14,039)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2.確定提撥計畫

合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一〇八年度及一〇七年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為22,952千元及21,702千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇八年度及一〇七年度國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為22,768千元及22,704千元。

(十三)所得稅

1.所得稅費用

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度之所得稅費用明細如下：

	108年度	107年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 125,927	142,444
調整前期之當期所得稅	(5,033)	(3,754)
	120,894	138,690
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	24,609	24,376
稅率變動影響數	-	12,157
	24,609	36,533
	\$ 145,503	175,223

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一〇八年度及一〇七年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	108年度	107年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ <u>(1,035)</u>	<u>(1,124)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ (5,074)	(3,870)
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(2,781)</u>	<u>(120)</u>
	\$ <u>(7,855)</u>	<u>(3,990)</u>

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	108年度	107年度
稅前淨利	\$ <u>1,067,816</u>	<u>1,245,589</u>
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	213,563	249,118
外國轄區稅率差異影響數	5,948	1,976
永久性差異調整	(3,139)	(8,244)
免稅所得	(67,733)	(77,572)
投資抵減預期新增數	(3,015)	(2,498)
稅率變動影響數	-	12,157
其他	<u>(121)</u>	<u>286</u>
	\$ <u>145,503</u>	<u>175,223</u>

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	107.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	108.12.31
存貨跌價損失	\$ 10,200	(1,800)	-	12,000	-	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	23,501	(10,920)	-	34,421	(8,325)	-	42,746
淨確定福利負債	12,399	(1,797)	(1,124)	15,320	409	(1,035)	15,946
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	3,403	-	(3,990)	7,393	-	(7,855)	15,248
其他	-	(572)	-	572	(684)	-	1,256
	\$ <u>49,503</u>	<u>(15,089)</u>	<u>(5,114)</u>	<u>69,706</u>	<u>(8,600)</u>	<u>(8,890)</u>	<u>87,196</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

遞延所得稅負債

	107.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	108.12.31
採權益法認列之國外投 資利益	\$ (113,936)	51,556	-	(165,492)	33,319	-	(198,811)
其他	(1,052)	66	-	(1,118)	(110)	-	(1,008)
	<u>\$ (114,988)</u>	<u>51,622</u>	<u>-</u>	<u>(166,610)</u>	<u>33,209</u>	<u>-</u>	<u>(199,819)</u>

3. 本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇五年度。

(十四) 資本及其他權益

1. 股本

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

2. 資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	108.12.31	107.12.31
普通股股本溢價	<u>\$ 142,309</u>	<u>142,309</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1) 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司民國一〇七年度及一〇六年度盈餘分派案，分別於民國一〇八年五月二十九日及一〇七年五月二十八日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	107年度		106年度	
	每股股利 (元)	金 額	每股股利 (元)	金 額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 4.70	1,062,991	4.10	927,290

(十五)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	108年度	107年度
基本每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ 914,902	1,063,990
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	\$ 4.05	4.70

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108年度	107年度
稀釋每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>914,902</u>	<u>1,063,990</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)		
員工酬勞	1,756	2,335
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>227,924</u>	<u>228,503</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.01</u>	<u>4.66</u>

(十六)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一〇八年度及一〇七年度員工酬勞估列金額分別為109,968千元及129,225千元，董事酬勞估列金額分別為12,019千元及14,248千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為129,225千元及14,248千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一〇六年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為111,567千元及12,286千元，皆係以現金發放，其中民國一〇六年度以董事酬勞科目發放為12,176千元，差異係估列計算之差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十七)客戶合約之收入

1.收入之細分

收入之細分請詳附註十四。

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(四)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十八)營業外收入及支出

合併公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	108年度	107年度
外幣兌換損失	\$ (20,631)	(7,530)
其他	14,182	23,001
	<u>\$ (6,449)</u>	<u>15,471</u>

其他主係合併公司向關聯企業收取人力支援等服務之收入，請詳附註七。

(十九)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為328,045千元及404,381千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(3)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(四)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(六)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(合併公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(七))。

2.流動性風險

除應付薪資及其他流動負債項下之應付費用外，其餘之金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
108年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款	\$ 482,608	482,608	482,608	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
租賃負債(含帳列其他流動負債)	92,571	102,269	20,139	82,130
	<u>\$ 583,721</u>	<u>593,419</u>	<u>502,747</u>	<u>90,672</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
107年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款	\$ 614,409	614,409	614,409	-
存入保證金	8,706	8,706	-	8,706
	<u>\$ 623,115</u>	<u>623,115</u>	<u>614,409</u>	<u>8,706</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險

匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	108.12.31			107.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 10,444	29.93	312,577	18,380	30.665	563,619
人民幣	58,098	4.2781	248,548	98,174	4.4459	436,473
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 12,443	29.93	372,441	11,977	30.665	367,289
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 5,924	29.93	177,316	9,311	30.665	285,533
人民幣	7,167	4.2781	30,660	13,886	4.4459	61,737

(2)敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款、其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇八年度及一〇七年度之稅後淨利將分別增加或減少2,825千元及5,223千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇八年度及一〇七年度外幣兌換淨損失(含已實現及未實現)分別為20,631千元及7,530千元。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值及租賃負債，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

108.12.31					
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 491,203	491,203	-	-	491,203
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	302,305	-	-	302,305	302,305
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	1,005,996	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	790,061	-	-	-	-
其他金融資產—流動	986,846	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	8,920	-	-	-	-
	<u>\$ 3,585,331</u>	<u>491,203</u>	<u>-</u>	<u>302,305</u>	<u>793,508</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額	\$ 482,608	-	-	-	-
存入保證金	8,542	-	-	-	-
租賃負債(含帳列其他流動負債)	92,571	-	-	-	-
	<u>\$ 583,721</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107.12.31					
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 486,555	486,555	-	-	486,555
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	265,161	-	-	265,161	265,161
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	1,517,632	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	847,393	-	-	-	-
其他金融資產—流動	784,175	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	11,208	-	-	-	-
	<u>\$ 3,912,124</u>	<u>486,555</u>	<u>-</u>	<u>265,161</u>	<u>751,716</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	107.12.31				
	公 允 價 值				合 計
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款(含關係人) \$	614,409	-	-	-	-
存入保證金	8,706	-	-	-	-
	<u>\$ 623,115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

A.合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

B.合併公司持有之金融工具屬無活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

- 無公開報價之權益工具：屬投資公司者，係使用淨資產價值法估算公允價值，資產法係經由評估評價標的涵蓋之個別資產及個別負債之總價值，以反映企業整體價值。
- 無公開報價之權益工具：其他投資標的，則係使用市場可比公司法估算公允價值，按同業之股價淨值比評估。

(3)民國一〇八年度及一〇七年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(4)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－權益證券投資。

合併公司歸類為第三等級之無活絡市場權益工具投資具有複數重大不可觀察輸入值。無活絡市場之權益工具投資之重大不可觀察輸入值因彼此獨立，故不存在相互關聯性。

重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	市場法(可類比上市櫃公司同業股價淨值比)	• 股價淨值比乘數(108.12.31及107.12.31分別為1.77及2.00) • 缺乏市場流通性折價(108.12.31及107.12.31分別為25%及20%)	• 股價淨值比乘數愈高，公允價值愈高 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－無活絡市場之權益工具投資	淨資產價值法	• 淨資產價值 • 缺乏市場流通性折價(108.12.31及107.12.31均為10%)	• 不適用 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)第三等級間之變動明細

	透過其他綜合損益按公允價值衡量— 無公開報價之權益工具	
	108年度	107年度
1月1日餘額	\$ 265,161	-
追溯適用新準則之調整數	-	326,736
總利益		
認列於其他綜合損益	37,144	(58,603)
處分	-	(2,972)
12月31日餘額	<u>\$ 302,305</u>	<u>265,161</u>

上述總利益，係列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益」。

(二十)財務風險管理

1.概要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十九)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於合併公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十九)。另，截至民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

4.流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇八年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度150,750千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

合併公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1)合併公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

- (2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(廿一)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。
截至民國一〇八年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。
合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	108.12.31	107.12.31
負債總額	\$ <u>1,294,245</u>	<u>1,331,401</u>
權益總額	\$ <u>4,079,423</u>	<u>4,224,099</u>
負債權益比率	<u>31.73%</u>	<u>31.52%</u>

(廿二)非現金交易之籌資活動

合併公司於民國一〇八年度及一〇七年度之非現金交易籌資活動如下：

- 1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(十)。
- 2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	租賃負債
108年1月1日餘額	\$ -
追溯適用新準則之調整數	105,155
來自營業活動之現金流量變動	
利息支出	(1,380)
來自籌資活動之現金流量變動	
償還本金	(17,822)
非現金流量之變動	
租賃負債新增數	5,601
租賃修改	(363)
利息費用	<u>1,380</u>
108年12月31日餘額	\$ <u>92,571</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與合併公司之關係
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	本公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	本公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	本公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	本公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	本公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

關係人名稱	與合併公司之關係
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	本公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	本公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	本公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	本公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	本公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	本公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	本公司之關聯企業
宏達科技有限公司(宏達)	本公司之關聯企業
高聖科技股份有限公司(高聖)(註)	本公司之關聯企業
鈺威科技股份有限公司(鈺威)	本公司之關聯企業

註：合併公司於民國一〇八年五月將所持有之高聖科技股份有限公司之股權全數處分。

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	108年度	107年度
欣宏	\$ 589,840	635,592
CROWN RICH	523,944	544,069
其他	2,255,163	2,409,950
	<u>\$ 3,368,947</u>	<u>3,589,611</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至120天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為83,786千元及101,540千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	108.12.31	107.12.31
CROWN RICH	\$ 129,353	107,074
欣宏	118,752	123,653
TRUETEK	79,940	86,732
其他	364,328	432,330
	<u>\$ 692,373</u>	<u>749,789</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.進貨及其他交易

(1)合併公司向關係人進貨金額如下：

	108年度	107年度
關聯企業	\$ <u>358</u>	<u>-</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

(2)合併公司委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	108年度	107年度
關聯企業	\$ <u>-</u>	<u>13</u>

(3)民國一〇八年度及一〇七年度合併公司向關聯企業收取人力支援等服務之收入分別為8,555千元及12,933千元。合併公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日分別為14,869千元及14,074千元，帳列其他金融資產—流動項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	108年度	107年度
短期員工福利	31,950	34,429
退職後福利	432	432
	\$ <u>32,382</u>	<u>34,861</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	108.12.31	107.12.31
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	\$ <u>5,218</u>	<u>3,712</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	108年度			107年度		
	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	28,973	725,618	754,591	30,468	762,573	793,041
勞健保費用	2,345	43,415	45,760	2,227	39,552	41,779
退休金費用	1,495	44,976	46,471	1,595	43,669	45,264
其他員工福利費用	1,460	20,672	22,132	1,430	20,265	21,695
折舊費用	3,227	79,586	82,813	2,753	54,845	57,598
攤銷費用	16	73,169	73,185	-	55,025	55,025

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇八年度合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高 持股比例	備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值		
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	10,966	168,477	-	168,477	-	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	15,616	262,000	-	262,000	-	
本公司	元大得寶貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	5,034	60,726	-	60,726	-	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資—非流動	2,500	68,627	5.00 %	68,627	5.00 %	
盛凌投資股份有限公司	譜永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資—非流動	23,124	206,714	3.03 %	206,714	3.03 %	
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資—非流動	3,330	26,964	12.33 %	26,964	16.38 %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	金科	本公司之子公司	銷貨	(206,378)	(5) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	119,138	14 %	(註)
金科	本公司	金科之母公司	進貨	206,378	100 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(119,138)	(87) %	(註)
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(405,302)	(10) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	(註)
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	405,302	100 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	(註)
本公司	芯群	本公司之子公司	銷貨	(180,497)	(4) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	107,824	13 %	(註)
芯群	本公司	芯群之母公司	進貨	180,497	78 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(107,824)	(86) %	(註)
本公司	Santek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(103,903)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	6,402	1 %	
Santek	本公司	對SANTEK採權益法評價之投資公司	進貨	103,903	55 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(6,402)	(17) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(339,689)	(8) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	38,938	5 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	339,689	41 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(38,938)	(29) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(185,673)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	5,938	1 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	185,673	53 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(5,938)	(12) %	
本公司	鈺威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(153,496)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	31,846	4 %	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	153,496	8 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(31,846)	(18) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(306,727)	(8) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	9,529	1 %	(註)
優方	本公司	優方之母公司	進貨	306,727	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(9,529)	(100) %	(註)
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(129,484)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
New Wave	本公司	對NEW WAVE採權益法評價之投資公司	進貨	129,484	32 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(157,391)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,352	2 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	157,391	42 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,352)	(20) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(108,147)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	2,890	- %	
Crown Rich	本公司	對CROWN RICH採權益法評價之投資公司	進貨	108,147	17 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(2,890)	(2) %	
本公司	合泰	本公司之子公司	銷貨	(586,707)	(14) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	408,893	49 %	(註)
合泰	本公司	合泰之母公司	進貨	586,707	84 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(408,893)	(91) %	(註)

註：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵銷售金額
					金 額	處理方式		
本公司	合泰	子公司	408,893 (註2)	2.87	-	即期收款	107,354 (註1)	-
本公司	金科	子公司	119,138 (註2)	3.46	-	即期收款	- (註1)	-
本公司	芯群	子公司	107,824 (註2)	3.35	-	即期收款	- (註1)	-

註1：係截至民國一〇九年一月十七日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	586,707	月結120天	12.80 %
0	本公司	合泰	母公司對子公司	應收帳款	408,893	月結120天	7.61 %
0	本公司	Holtek BVI	母公司對子公司	銷貨收入	405,302	月結120天	8.84 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	306,727	月結60天	6.69 %
0	本公司	金科	母公司對子公司	銷貨收入	206,378	月結120天	4.50 %
0	本公司	金科	母公司對子公司	應收帳款	119,138	月結120天	2.22 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	銷貨收入	180,497	月結120天	3.94 %

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	本公司	芯群	母公司對子公司	應收帳款	107,824	月結120天	2.01 %
0	本公司	悠健	母公司對子公司	銷貨收入	63,366	月結60天	1.38 %

註：係揭示交易金額佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇八年合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	608,165	100.00 %	94,549	94,549 註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	127,433	100.00 %	11,287	11,287 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	23,030	100.00 %	798	798 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	23,030	100.00 %	798	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	710,248	100.00 %	73,761	73,761 註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	20,877	40.00 %	422	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	8,578	100.00 %	437	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	ForIC Electronics HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術支持與諮詢服務	866	-	200	100.00 %	1,454	100.00 %	615	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	51,962	40.00 %	24,314	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Truetek Technology Ltd.	Truetek Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術研發與諮詢服務	8,662	-	2,000	100.00 %	11,837	100.00 %	3,262	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司之子公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	1,868	1,868	60	40.00 %	23,834	40.00 %	15,003	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Quanding Technology Holding Ltd.	Quanding Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	2,137	-	500	100.00 %	2,049	100.00 %	(90)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	24,392	40.00 %	23,555	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Santek Holdings Ltd.	Santek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機芯片之應用與技術諮詢	8,662	-	2,000	100.00 %	8,702	100.00 %	93	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,470	3,470	800	40.00 %	22,286	40.00 %	1,130	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newwave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	67,517	40.00 %	26,053	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	62,314	40.61 %	16,769	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Newtek Electronics Ltd.	Newtek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機芯片之應用與技術諮詢	8,662	-	2,000	100.00 %	12,895	100.00 %	43,673	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	65,018	40.00 %	36,973	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	1,850	40.00 %	(1,107)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	4,691	60.00 %	3,891	註1,2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,254	40.00 %	2,930	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滾達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	7,884	33.33 %	11,987	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,404	3,664	1	40.00 %	6,253	40.00 %	1,383	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	20,965	20,965	5	80.00 %	24,555	80.00 %	5,195	註1,2	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片之技術支持與諮詢服務	1,299	-	300	100.00 %	3,069	100.00 %	1,796	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	8,844	8,844	2	100.00 %	8,746	100.00 %	149	註1,2	本公司之孫公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	1	0.10 %	(121)	- 註2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	507,733	100.00 %	7,625	7,625 註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	113,968	40.00 %	20,934	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	59,204	59,204	2,000	100.00 %	69,413	100.00 %	4,985	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	43,810	43,810	800	100.00 %	46,057	100.00 %	6,388	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	14,254	36.88 %	10,644	註1	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資 股份有限 公司	鈺成科技股 份有限公 司	新北市	電子零組件加 工製造、買賣 進出口	37,500	37,500	5,865	22.39 %	70,768	22.39 %	14,740	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資 股份有限 公司	高聖科技股 份有限公 司	新北市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 信器材批發零 售、電腦及其 週邊設備製 造、資訊軟體 服務及國際貿 易	-	2,350	-	- %	-	- %	1,158	註1,3	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資 股份有限 公司	優方科技股 份有限公 司	台北市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 腦及其週邊設 備製造、資訊 軟體服務及國 際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	15,462	40.00 %	10,644	註1,2	本公司之 孫公司
優方科技 股份有限 公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項 事業	6,140	6,140	200	100.00 %	26,748	100.00 %	3,625	註1,2	本公司之 孫公司投 資之子公 司
盛凌投資 股份有限 公司	天宇微機電 股份有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 信器材批發零 售、智慧財產 權業、資訊 軟體服務及國 際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	156	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資 股份有限 公司	芯通科技股 份有限公 司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、國 際貿易業及資 訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	13,787	100.00 %	(7,824)	註1,2,4	本公司之 孫公司
芯通科技 股份有限 公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項 事業	14,054	14,054	30	100.00 %	6,189	100.00 %	(4,548)	註1,2	本公司之 孫公司投 資之子公 司
盛凌投資 股份有限 公司	倍創科技股 份有限公 司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發、無店面 零售業、國際 貿易業	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,020	100.00 %	(875)	註1,2	本公司之 孫公司
盛凌投資 股份有限 公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及 單片機晶片之 技術支持與諮 詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	1,482	99.90 %	(121)	註1,2	本公司之 孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：合併公司於民國一〇八年五月將所持有之高聖科技股份有限公司之股權全數處分。

註4：係盛通科技於民國一〇八年八月變更公司名稱。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	10,359	100 %	100 %	10,359 (註5)	119,164	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元件及單片機芯片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	84,616	100 %	100 %	84,616 (註5)	396,894	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(3,195)	40 %	40 %	(1,278)	14,448	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元件及單片機器件的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	(5,947)	40 %	40 %	(2,379) (註5)	12,981	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	21,577	40 %	40 %	8,631 (註5)	42,334	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(6,479)	40 %	40 %	(2,591)	9,041	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(83)	40 %	40 %	(33)	6,295	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	3,537	40.61 %	40.61 %	1,436 (註5)	31,685	-
信霖電子商務(上海)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(3,396)	40 %	40 %	(1,358)	43,287	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	10,443	(註1)	1,964	-	-	1,964	14,163	40 %	40 %	5,665 (註5)	70,189	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實 收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
				匯出	收回								
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	4,980	40 %	40 %	1,992	23,064	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	11,288	100 %	100 %	11,288 (註5)	127,394	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元件及單片機技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(350)	40 %	40 %	(140)	2,359	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元件及單片機技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	980	60 %	60 %	588	1,615	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元件及單片機技術研發與諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	1,427	40 %	40 %	571	5,588	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元件及單片機技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(5,118)	80 %	80 %	(4,094)	9,644	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	9,214	(註1)	-	-	-	-	(5,246)	100 %	100 %	(5,246) (註5)	1,055	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	4,284	(註1)	-	-	-	-	(1,823)	54.75 %	54.75 %	(998) (註5)	2,462	-

2.轉投資大陸地區限額：

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註4)
盛群	471,089 (美金15,111千元)	524,934 (美金17,539千元)	2,431,599
芯通	9,392 (美金314千元)	9,383 (美金314千元)	8,272

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；盛群經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計450,555千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計74,379千元(美金2,485千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。盛群之限額計算為淨值4,052,665千元 $\times$ 60%=2,431,599千元；芯通之限額計算為淨值13,787千元 $\times$ 60%=8,272千元。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師查核之財務報告認列投資損益。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一〇八年與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	108年度		107年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 4,567,256	100	4,853,674	100
設計及燒Code收入	16,849	-	9,133	-
	<u>\$ 4,584,105</u>	<u>100</u>	<u>4,862,807</u>	<u>100</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	108年度		107年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 3,474,535	76	3,716,948	76
台灣	449,626	10	484,264	10
其他國家	659,944	14	661,595	14
	<u>\$ 4,584,105</u>	<u>100</u>	<u>4,862,807</u>	<u>100</u>
	108.12.31		107.12.31	
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 264,473	5	182,991	3
中國	265,659	5	265,648	5
其他國家	3,055	-	868	-
	<u>\$ 533,187</u>	<u>10</u>	<u>449,507</u>	<u>8</u>

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	108年度		107年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
欣宏	\$ 589,840	13	635,592	13
CROWN RICH	523,944	11	544,069	11
	<u>\$ 1,113,784</u>	<u>24</u>	<u>1,179,661</u>	<u>24</u>

附錄二：

108 年度個體財務報告及會計師查核報告

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如個體財務報告附註三(一)所述，盛群半導體股份有限公司於民國一〇八年一月一日首次適用國際財務報導準則公報第十六號「租賃」，並採用修正式追溯法無須重編比較期間資訊。本會計師未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群半導體股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳個體財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群半導體股份有限公司是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。相關說明請詳個體財務報告附註六(四)(重要會計項目說明－存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群半導體股份有限公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群半導體股份有限公司既訂之會計政策；執行存貨備抵跌價提列之回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群半導體股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盛群半導體股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群半導體股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

游萬勛



曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇九年二月十四日



民國一〇八年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,052,932	100	4,358,758	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十一)、(十五)、七及十二)	2,201,771	54	2,274,449	52
營業毛利	1,851,161	46	2,084,309	48
5910 未實現銷貨利益之變動	41,687	1	33,928	1
已實現營業毛利	1,809,474	45	2,050,381	47
營業費用(附註六(十一)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	106,103	3	98,669	2
6200 管理費用	218,461	5	253,565	6
6300 研究發展費用	635,477	16	643,748	15
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(三))	(3,066)	-	3,066	-
	956,975	24	999,048	23
營業淨利	852,499	21	1,051,333	24
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	(1,418)	-	1,618	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	188,020	5	170,610	4
7100 利息收入	8,887	-	9,349	-
7510 利息費用(附註六(九))	(1,176)	-	-	-
	194,313	5	181,577	4
稅前淨利	1,046,812	26	1,232,910	28
7950 所得稅費用(附註六(十二))	131,910	3	168,920	4
本期淨利	914,902	23	1,063,990	24
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(5,175)	-	(5,618)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	37,144	1	(58,603)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(1,035)	-	(1,124)	-
不重分類至損益之項目合計	33,004	1	(63,097)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	(16,431)	-
8381 採用權益法認列子公司及關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(39,275)	(1)	(521)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(7,855)	-	(3,990)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(31,420)	(1)	(12,962)	-
8300 本期其他綜合損益	1,584	-	(76,059)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 916,486	23	\$ 987,931	23
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.05		\$ 4.70	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.01		\$ 4.66	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通





盛群半

有限公司

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 未實現損益	合計	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	-	(31,756)	4,071,239
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	-	67,290	67,290	67,290
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	67,290	35,534	4,138,529
本期淨利	-	-	-	-	1,063,990	-	-	-	1,063,990
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,494)	(12,962)	(58,603)	(71,565)	(76,059)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,059,496	(12,962)	(58,603)	(71,565)	987,931
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	92,202	-	(92,202)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,445	(7,445)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(104,942)	-	(822,348)	-	-	-	(927,290)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,355	-	(1,355)	(1,355)	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	737,289	34,399	1,060,877	(44,718)	7,332	(37,386)	4,199,170
本期淨利	-	-	-	-	914,902	-	-	-	914,902
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,140)	(31,420)	37,144	5,724	1,584
本期綜合損益總額	-	-	-	-	910,762	(31,420)	37,144	5,724	916,486
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	106,088	-	(106,088)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,987	(2,987)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(111,275)	-	(951,716)	-	-	-	(1,062,991)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	732,102	37,386	910,848	(76,138)	44,476	(31,662)	4,052,665

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



民國一〇八年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,046,812	1,232,910
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	50,088	33,247
攤銷費用	72,609	54,186
預期信用減損(迴轉利益)損失	(3,066)	3,066
利息費用	1,176	-
利息收入	(8,887)	(9,349)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(188,020)	(170,610)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	41,687	33,928
其他不影響現金流量之損費淨額	4,953	6,379
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(2,853)	97,382
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)(增加)減少	(85,649)	32,993
存貨減少(增加)	62,743	(53,019)
其他營業資產增加	(285)	(12,247)
應付票據及帳款(減少)增加	(158,181)	17,579
淨確定福利負債減少	(2,798)	(1,953)
其他營業負債(減少)增加	(16,652)	9,231
營運產生之現金流入	813,677	1,273,723
收取之利息	9,000	9,263
收取之股利	18,526	-
支付之利息	(1,176)	-
支付之所得稅	(148,476)	(119,958)
營業活動之淨現金流入	691,551	1,163,028
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(3)
取得不動產、廠房及設備	(22,817)	(19,502)
處分不動產、廠房及設備	-	33
存出保證金減少(增加)	544	(724)
其他金融資產(增加)減少	(97,306)	105,908
其他非流動資產增加	(87,137)	(64,107)
投資活動之淨現金(流出)流入	(206,716)	21,605
籌資活動之現金流量：		
租金本金償還	(11,254)	-
發放股東現金股利	(1,062,991)	(927,290)
籌資活動之淨現金流出	(1,074,245)	(927,290)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(589,410)	257,343
期初現金及約當現金餘額	1,178,768	921,425
期末現金及約當現金餘額	\$ 589,358	1,178,768

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇八年度及一〇七年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇九年二月五日經提報董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一〇八年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇八年生效之國際財務報導準則編製個體財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第16號「租賃」	2019年1月1日
國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」	2019年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	2019年1月1日
國際會計準則第19號之修正「計畫修正、縮減或清償」	2019年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	2019年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	2019年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則對個體財務報告未造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1. 國際財務報導準則第十六號「租賃」

國際財務報導準則第十六號「租賃」(以下簡稱國際財務報導準則第十六號)取代現行國際會計準則第十七號「租賃」(以下簡稱國際會計準則第十七號)、國際財務報導解釋第四號「決定一項安排是否包含租賃」(以下簡稱國際財務報導解釋第四號)、解釋公告第十五號「營業租賃：誘因」及解釋公告第二十七號「評估涉及租賃之法律形式之交易實質」。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司採修正式追溯法過渡至國際財務報導準則第十六號，相關會計政策變動之性質及影響說明如下：

(1)租賃定義

本公司先前係依據國際財務報導解釋第四號於合約開始日判斷一項協議是否屬或包含租賃。變更會計政策後則係以國際財務報導準則第十六號之租賃定義評估合約是否屬或包含租賃，會計政策詳附註四(十一)。

過渡至國際財務報導準則第十六號時，本公司選擇採用權宜作法豁免評估初次適用日前之交易是否為租賃，亦即，將先前已辨識為租賃之合約直接適用國際財務報導準則第十六號之規定。先前已依據國際會計準則第十七號及國際財務報導解釋第四號辨識非屬租賃之合約則不再重新評估是否為租賃。因此，國際財務報導準則第十六號所規定之租賃定義僅適用於初次適用日及之後所簽訂或變更之合約。

(2)承租人

本公司為承租人之交易，先前係依據租賃合約是否已移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬評估其分類。於國際財務報導準則第十六號下，則針對租賃合約於資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。

本公司選擇將承租公務車及員工宿舍等適用短期租賃及低價值資產之認列豁免。

先前於國際會計準則第十七號下分類為營業租賃之合約於過渡時，租賃負債係以剩餘租賃給付現值衡量，並使用初次適用日本公司增額借款利率折現。使用權資產則以租賃負債之金額，調整與該租賃有關之所有預付或應付之租賃給付金額衡量。

此外，本公司採用以下權宜作法過渡至國際財務報導準則第十六號：

- a. 針對具有類似特性之租賃組合採用單一折現率。
- b. 依其於初次適用日前刻依據國際會計準則第三十七號「負債準備、或有負債及或有資產」有關虧損性合約之評估結果，作為對使用權資產減損評估之替代方法。
- c. 針對租賃期間於初次適用日後12個月內結束之租賃，適用豁免而不認列使用權資產及租賃負債。
- d. 不將原始直接成本計入初次適用日之使用權資產衡量中。
- e. 於租賃合約包含租賃延長或終止選擇權下，決定租賃期間時，採用後見之明。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3) 出租人

本公司無須針對其為出租人之交易於過渡至國際財務報導準則第十六號時進行任何調整，而係自初次適用日起適用國際財務報導準則第十六號處理其出租交易。

(4) 對財務報告之影響

過渡至國際財務報導準則第十六號時，本公司於初次適用日認列使用權資產及租賃負債之金額均為89,863千元。租賃負債係以本公司初次適用日之增額借款利率將租賃給付折現，所使用之利率其加權平均數為1.4%。

初次適用日之前一年度揭露之營業租賃承諾金額與初次適用日認列之租賃負債金額調節如下：

	108.1.1
107.12.31個體財務報告揭露之營業租賃承諾金額	\$ 34,317
認列豁免：	
短期租賃	(3,474)
可合理確定將行使之租賃延長或終止之選擇權	<u>71,165</u>
	\$ 102,008
以108.1.1增額借款利率折現後之金額	\$ 89,863
107.12.31認列之融資租賃負債金額	<u>-</u>
於108.1.1認列之租賃負債金額	<u>\$ 89,863</u>

2. 國際財務報導解釋第二十三號「所得稅務處理之不確定性」

新解釋闡明於評估具不確定性之租稅處理對課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率之影響時，應假設租稅主管機關將依法審查相關金額，並且於審查時已取得所有相關資訊。

若評估後認為租稅主管機關很有可能接受一項具不確定性之租稅處理，則應以與租稅申報時所使用之處理一致之方式決定課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率；反之，若並非很有可能，則得以最有可能金額或期望值兩者較適用者，反映每一項具不確定性之租稅處理之影響。

適用新準則對本公司並無重大影響。

(二) 尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇八年七月二十九日金管證審字第1080323028號令，公開發行以上公司應自民國一〇九年起全面採用經金管會認可並於民國一〇九年生效之國際財務報導準則。國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報導準則第7號之修正「利率指標變革」	2020年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大之定義」	2020年1月1日

本公司評估適用上述新認可之國際財務報導準則，將不致對個體財務報告造成重大變動。

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

理事會已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；及
- (2)淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2.功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)外 幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。於後續每一報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

對國外營運機構之貨幣性應收或應付項目，若尚無清償計畫且不可能於可預見之未來予以清償時，其所產生之外幣兌換損益視為對該國外營運機構淨投資之一部分而認為其他綜合損益。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

應收帳款及所發行之債務證券原始係於產生時認列。所有其他金融資產及金融負債原始係於本公司成為金融工具合約條款之一方時認列。非透過損益按公允價值衡量之金融資產(除不包含重大財務組成部分之應收帳款外)或金融負債原始係按公允價值加計直接可歸屬於該取得或發行之交易成本衡量。不包含重大財務組成部分之應收帳款原始係按交易價格衡量。

1.金融資產

金融資產之購買或出售符合慣例交易者，本公司對以相同方式分類之金融資產，其所有購買及出售一致地採交易日或交割日會計處理。

原始認列時，金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產或透過損益按公允價值衡量之金融資產。本公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始自下一個報導期間之首日起重分類所有受影響之金融資產。

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

該等資產後續以原始認列金額加減計採有效利息法計算之累積攤銷數，並調整任何備抵損失之攤銷後成本衡量。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。

(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。本公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

該等資產後續按公允價值衡量，其淨利益或損失(包含利息收入)係認列為損益。

持有供交易及以公允價值基礎管理並評估績效之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)金融資產減損

本公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，本公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據本公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若合約款項逾期超過九十天，本公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予本公司時，本公司視為該金融資產發生違約。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，本公司視為該債務證券之信用風險低。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

衡量預期信用損失之最長期間為本公司暴露於信用風險之最長合約期間。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即本公司依據合約可收取之現金流量與本公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除。

當本公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。對公司戶，本公司係以是否合理預期可回收之基礎個別分析沖銷之時點及金額。本公司預期已沖銷金額將不會重大迴轉。然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合本公司回收逾期金額之程序。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業，或既未移轉亦未保留所有權之幾乎所有風險及報酬且未保留該金融資產之控制時，始將金融資產除列。

本公司簽訂移轉金融資產之交易，若保留已移轉資產所有權之所有或幾乎所有風險及報酬，則仍持續認列於資產負債表。

2.金融負債

(1)負債之分類

本公司發行之債務係依據合約協議之實質與金融負債定義分類為金融負債。

(2)金融負債

金融負債係分類為攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。金融負債若屬持有供交易、衍生工具或於原始認列時指定，則分類為透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係以公允價值衡量，且相關淨利益及損失，包括任何利息費用，係認列於損益。

其他金融負債後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。利息費用及兌換損益係認列於損益。除列時之任何利益或損失亦係認列於損益。

(3)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。當金融負債條款修改且修改後負債之現金流量有重大差異，則除列原金融負債，並以修改後條款為基礎按公允價值認列新金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司目前有法律上有可執行之權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(八)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，僅在非關係人投資者對關聯企業之權益範圍內，認列於企業財務報表。

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

本公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。

(九)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備項目係依成本(包括資本化之借款成本)減累計折舊及任何累計減損衡量。

不動產、廠房及設備之重大組成部分耐用年限不同時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分利益或損失係認列於損益。

2.後續成本

後續支出僅於其未來經濟效益很有可能流入本公司時始予以資本化。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值計算，並採直線法於每一組成部分之估計耐用年限內認列於損益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築：20~30年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

本公司於每一報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，並於必要時適當調整。

(十一)租賃

民國一〇八年一月一日開始適用

1.租賃之判斷

本公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。為評估合約是否係屬租賃，本公司針對以下項目評估：

- (1)該合約涉及使用一項已辨認資產，該已辨認資產係於合約中被明確指定或藉由於可供使用之時被隱含指定，其實體可區分或可代表實質所有產能。若供應者具有可替換該資產之實質性權利，則該資產並非已辨認資產；且
- (2)於整個使用期間具有取得來自使用已辨認資產之幾乎所有經濟效益之權利；且
- (3)於符合下列情況之一時，取得主導已辨認資產之使用之權利：
 - 客戶在整個使用期間具有主導已辨認資產之使用方式及使用目的之權利。
 - 有關該資產之使用方式及使用目的之攸關決策係預先決定，且：
 - 客戶在整個使用期間具有操作該資產之權利，且供應者並無改變該等操作指示之權利；或
 - 客戶設計該資產之方式已預先決定其整個使用期間之使用方式及使用目的。

於租賃成立日或重評估合約是否包含租賃時，本公司係以相對單獨價格為基礎將合約中之對價分攤至個別租賃組成部份。惟，於承租土地及建物時，本公司選擇不區分非租賃組成部分而將租賃組成部分及非租賃組成部分視為單一租賃組成部分處理。

2.承租人

本公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，本公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用本公司之增額借款利率。一般而言，本公司係採用其增額借款利率為折現率。

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1) 固定給付，包括實質固定給付；
- (2) 取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3) 預期支付之殘值保證金額；及
- (4) 於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1) 用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2) 預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3) 標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4) 對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5) 租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

本公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對公務車及員工宿舍租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，本公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

3. 出租人

本公司為出租人之交易，係於租賃成立日將租賃合約依其是否移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬分類，若是則分類為融資租賃，否則分類為營業租賃。於評估時，本公司考量包括租賃期間是否涵蓋標的資產經濟年限之主要部分等相關特定指標。

若協議包含租賃及非租賃組成部分，本公司使用國際財務報導準則第十五號之規定分攤合約中之對價。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

民國一〇七年十二月三十一日以前適用

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.認列及衡量

研究活動相關支出於發生時認列為損益。

發展支出僅於其能可靠衡量、產品或流程之技術或商業可行性已達成、未來經濟效益很有可能流入本公司，及本公司意圖且具充足資源以完成該發展且加以使用或出售該資產時，始予以資本化。其他發展支出則於發生時認列於損益。原始認列後，資本化之發展支出以其成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。

本公司取得其他有限耐用年限之無形資產，係以成本減除累計攤銷與累計減損後之金額衡量。

2.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產之未來經濟效益時始予以資本化。

3.攤銷

攤銷係依資產成本減除估計殘值計算，並自無形資產達可供使用狀態起，按直線法於其估計耐用年限內認列為損益。

本公司於每一報導日檢視無形資產之攤銷方法、耐用年限及殘值，並於必要時，適當調整。

(十三)非金融資產減損

本公司於每一報導日評估是否有跡象顯示非金融資產(除存貨及遞延所得稅資產外)之帳面金額可能有減損。若有任一跡象存在，則估計該資產之可回收金額。

為減損測試之目的，係將現金流入大部分獨立於其他個別資產或資產群組之現金流入之一組資產作為最小可辨認資產群組。企業合併取得之商譽係分攤至預期可自合併綜效受益之各現金產生單位或現金產生單位群組。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則認列減損損失。

商譽以外之非金融資產則僅在不超過該資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)之範圍內迴轉。

(十四)收入認列

客戶合約之收入

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。本公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。本公司依主要收入項目說明如下：

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

1.銷售商品

本公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。本公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或本公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

本公司於交付商品時認列應收帳款，因本公司在該時點具無條件收取對價之權利。

2.財務組成部分

本公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，本公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供服務期間內認列為費用。

2.確定福利計畫

本公司對確定福利計畫之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或以前期間服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算，並減除任何計畫資產之公允價值。

確定福利義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司可能有利時，認列資產係以從該計畫退還提撥金或對該計畫減少未來提撥金之形式可得之任何經濟效益之現值為限。計算經濟效益現值時，係考量任何最低資金提撥要求。

淨確定福利負債之再衡量數包含精算損益、計畫資產報酬(不包括利息)，及資產上限影響數之任何變動(不包括利息)係立即認列於其他綜合損益，並累計於保留盈餘。本公司決定淨確定福利負債之淨利息費用，係使用年度報導期間開始時所決定之淨確定福利負債及折現率。確定福利計畫之淨利息費用及其他費用係認列於損益。

計畫修正或縮減時，所產生與前期服務成本或縮減利益或損失相關之福利變動數，係立即認列為損益。本公司於清償發生時，認列確定福利計畫之清償損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係於服務提供時認列為費用。若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十六)所得稅

所得稅包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括依據當年度課稅所得(損失)計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅或應收退稅款之調整。其金額係按報導日之法定稅率或實質性立法之稅率衡量預期將支付或收取款項之最佳估計值。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期暫時性差異迴轉時之稅率衡量，採用報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；

(1)同一納稅主體；或

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減；或在變成很有可能有足夠課稅所得之範圍內迴轉原已減少之金額。

(十七)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十八)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依「證券發行人財務報告編製準則」編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，本公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。本公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。

衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十八)金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	108.12.31	107.12.31
現金及活期存款	\$ 66,536	151,095
定期存款	522,822	1,027,673
	<u>\$ 589,358</u>	<u>1,178,768</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	108.12.31	107.12.31
受益憑證	\$ 491,203	486,555

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少3,930千元及3,892千元。

(三)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
應收票據	\$ 1,122	278
應收帳款	72,244	93,180
應收關係人款	<u>772,278</u>	<u>666,537</u>
	845,644	759,995
減：備抵損失	<u>(7,393)</u>	<u>(10,459)</u>
	<u><u>\$ 838,251</u></u>	<u><u>749,536</u></u>

本公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。本公司應收款項之預期信用損失分析如下：

	<u>108.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 834,035	0.5%~1.5%	6,812
逾期90天以下	<u>11,609</u>	5%	<u>581</u>
合計	<u><u>\$ 845,644</u></u>		<u><u>7,393</u></u>

	<u>107.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 743,494	0.5%~1.5%	7,287
逾期90天以下	<u>2,118</u>	5%	<u>106</u>
合計	<u><u>\$ 745,612</u></u>		<u><u>7,393</u></u>

民國一〇七年十二月三十一日因個別客戶應收帳款14,383千元，經評估有違約風險，故針對該客戶提列3,066千元預期信用損失；截至民國一〇八年十二月三十一日，該客戶業已依付款計畫支付款項，故迴轉3,066千元之預期信用損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
期初餘額	\$ 10,459	7,393
認列之減損損失	-	3,066
減損損失迴轉	<u>(3,066)</u>	<u>-</u>
期末餘額	<u><u>\$ 7,393</u></u>	<u><u>10,459</u></u>

(四)存貨

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
原料及物料	\$ 167,012	155,344
在製品	232,872	248,246
製成品及商品	<u>63,608</u>	<u>128,706</u>
	<u><u>\$ 463,492</u></u>	<u><u>532,296</u></u>

營業成本組成明細如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
銷貨成本	\$ 2,195,710	2,266,994
報廢成本	<u>6,061</u>	<u>7,455</u>
	<u><u>\$ 2,201,771</u></u>	<u><u>2,274,449</u></u>

(五)其他金融資產－流動

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 655,700	559,900
受限制銀行存款	5,118	3,612
其他	<u>13,432</u>	<u>13,240</u>
	<u><u>\$ 674,250</u></u>	<u><u>576,752</u></u>

本公司於民國一〇八年度及一〇七年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十八)。

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
子公司	\$ 1,976,610	1,809,247
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(213,730)</u>	<u>(172,107)</u>
	<u><u>\$ 1,762,880</u></u>	<u><u>1,637,140</u></u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

子公司相關資訊，請參閱民國一〇八年度合併財務報告。

本公司民國一〇八年度及一〇七年度所享有子公司利益之份額分別為188,020千元及170,610千元。

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 設 備</u>	<u>其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
成本：					
民國108年1月1日 餘額	\$ 26,676	268,982	257,317	43,422	596,397
增添	-	1,648	12,862	8,307	22,817
減少	-	-	(57,532)	(1,132)	(58,664)
民國108年12月31日 餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>270,630</u>	<u>212,647</u>	<u>50,597</u>	<u>560,550</u>
民國107年1月1日 餘額	\$ 26,676	265,663	247,694	42,502	582,535
增添	-	3,319	15,188	995	19,502
減少	-	-	(5,565)	(75)	(5,640)
民國107年12月31日 餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>268,982</u>	<u>257,317</u>	<u>43,422</u>	<u>596,397</u>
累計折舊：					
民國108年1月1日 餘額	\$ -	183,821	228,550	32,778	445,149
本期折舊	-	15,845	16,592	5,872	38,309
減少	-	-	(57,532)	(1,132)	(58,664)
民國108年12月31日 餘額	<u>\$ -</u>	<u>199,666</u>	<u>187,610</u>	<u>37,518</u>	<u>424,794</u>
民國107年1月1日 餘額	\$ -	169,688	220,104	27,693	417,485
本期折舊	-	14,133	13,954	5,160	33,247
減少	-	-	(5,508)	(75)	(5,583)
民國107年12月31日 餘額	<u>\$ -</u>	<u>183,821</u>	<u>228,550</u>	<u>32,778</u>	<u>445,149</u>
帳面價值：					
民國108年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>70,964</u>	<u>25,037</u>	<u>13,079</u>	<u>135,756</u>
民國107年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>85,161</u>	<u>28,767</u>	<u>10,644</u>	<u>151,248</u>
民國107年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>95,975</u>	<u>27,590</u>	<u>14,809</u>	<u>165,050</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(八)使用權資產

本公司承租土地與房屋及建築等之成本及折舊，其變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房屋及 建 築</u>	<u>總 計</u>
使用權資產成本：			
民國108年1月1日餘額	\$ -	-	-
追溯適用IFRS16之影響數	<u>67,341</u>	<u>22,522</u>	<u>89,863</u>
民國108年12月31日餘額	<u><u>\$ 67,341</u></u>	<u><u>22,522</u></u>	<u><u>89,863</u></u>
使用權資產之折舊：			
民國108年1月1日餘額	\$ -	-	-
本期折舊	<u>3,061</u>	<u>8,718</u>	<u>11,779</u>
民國108年12月31日餘額	<u><u>\$ 3,061</u></u>	<u><u>8,718</u></u>	<u><u>11,779</u></u>
帳面價值：			
民國108年12月31日	<u><u>\$ 64,280</u></u>	<u><u>13,804</u></u>	<u><u>78,084</u></u>

本公司於民國一〇七年度以營業租賃承租土地及辦公室，請詳附註六(十)。

(九)租賃負債

本公司租賃負債之帳面金額如下：

	<u>108.12.31</u>
流動	<u>\$ 11,413</u>
非流動	<u><u>\$ 67,196</u></u>

到期分析請詳附註六(十八)。

認列於損益之金額如下：

	<u>108年度</u>
租賃負債之利息費用	<u>\$ 1,176</u>
短期租賃之費用	<u>\$ 4,838</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	<u><u>\$ 571</u></u>

認列於現金流量表之金額如下：

	<u>108年度</u>
租賃之現金流出總額	<u><u>\$ 17,839</u></u>

土地、房屋及建築之租賃

本公司民國一〇八年十二月三十一日承租土地與房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至五年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅本公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十)營業租賃

- 1.本公司於民國一〇七年十二月三十一日依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	<u>107.12.31</u>
一年內	\$ 15,458
一年至二年	12,885
二年以上	<u>5,974</u>
	<u>\$ 34,317</u>

- 2.本公司廠房之土地係向科學園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇七年二月起租金每年約為3,558千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(十一)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 132,272	127,611
計畫資產之公允價值	<u>(52,542)</u>	<u>(51,009)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 79,730</u>	<u>76,602</u>

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計52,542千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇八年度及一〇七年度確定福利義務現值變動如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 127,611	123,354
計畫支付之福利	(3,581)	(4,234)
當期服務成本及利息	1,275	1,480
淨確定福利負債再衡量數		
一因財務假設變動所產生之精算損失	4,703	3,225
一因經驗變動所產生之精算損(益)	<u>2,264</u>	<u>3,786</u>
12月31日確定福利義務	<u><u>\$ 132,272</u></u>	<u><u>127,611</u></u>

(3)計畫資產公允價值之變動

本公司民國一〇八年度及一〇七年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 51,009	50,416
計畫支付之福利	(3,581)	(4,234)
利息收入	524	622
已提撥至計畫之金額	2,798	2,812
淨確定福利負債之再衡量數		
一計畫資產報酬(不含當期利息)	<u>1,792</u>	<u>1,393</u>
12月31日計畫資產之公允價值	<u><u>\$ 52,542</u></u>	<u><u>51,009</u></u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇八年度及一〇七年度認列為損益之費用如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
淨確定福利負債之淨利息	<u><u>\$ 751</u></u>	<u><u>858</u></u>
營業成本	\$ 48	57
推銷費用	59	65
管理費用	115	152
研究發展費用	<u>529</u>	<u>584</u>
	<u><u>\$ 751</u></u>	<u><u>858</u></u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司民國一〇八年度及一〇七年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	108年度	107年度
1月1日累積餘額	\$ 21,503	15,885
本期認列	5,175	5,618
12月31日累積餘額	<u>\$ 26,678</u>	<u>21,503</u>

(6)精算假設

本公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	108.12.31	107.12.31
折現率	0.70 %	1.00 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

本公司預計於民國一〇八年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,870千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為11.8年。

(7)敏感度分析

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日，當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加0.5%	減少0.5%
108年12月31日		
折現率	\$ (7,717)	8,351
未來薪資成長率	\$ 7,552	(7,084)
精算假設	增加1% 減少1%	
107年12月31日		
折現率	\$ (15,127)	17,814
未來薪資成長率	\$ 16,056	(14,039)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一〇八年度及一〇七年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為22,180千元及21,105千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇八年度及一〇七年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為786千元及2,247千元。

(十二)所得稅

1.所得稅費用

本公司民國一〇八年度及一〇七年度之所得稅費用明細如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 109,398	138,171
調整前期之當期所得稅	<u>(5,033)</u>	<u>(3,754)</u>
	<u>104,365</u>	<u>134,417</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	27,545	23,202
稅率變動影響數	<u>-</u>	<u>11,301</u>
	<u>27,545</u>	<u>34,503</u>
	<u>\$ 131,910</u>	<u>168,920</u>

本公司民國一〇八年度及一〇七年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	<u>\$ (1,035)</u>	<u>(1,124)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ -	(3,870)
採用權益法認列子公司及關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(7,855)</u>	<u>(120)</u>
	<u>\$ (7,855)</u>	<u>(3,990)</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	108年度	107年度
稅前淨利	\$ 1,046,812	1,232,910
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	209,362	246,582
永久性差異調整	(1,671)	(4,459)
免稅所得	(67,733)	(77,572)
投資抵減預期新增數	(3,015)	(2,498)
稅率變動影響數	-	11,301
其他	(5,033)	(4,434)
	<u>\$ 131,910</u>	<u>168,920</u>

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	107.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	108.12.31
存貨跌價損失	\$ 10,200	(1,800)	-	12,000	-	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	23,501	(10,920)	-	34,421	(8,325)	-	42,746
淨確定福利負債	12,399	(1,797)	(1,124)	15,320	409	(1,035)	15,946
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	3,403	-	(3,990)	7,393	-	(7,855)	15,248
其他	-	(572)	-	572	(508)	-	1,080
	<u>\$ 49,503</u>	<u>(15,089)</u>	<u>(5,114)</u>	<u>69,706</u>	<u>(8,424)</u>	<u>(8,890)</u>	<u>87,020</u>

遞延所得稅負債

	107.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	108.12.31
採權益法認列之國外投 資利益	\$ (109,085)	49,526	-	(158,611)	36,079	-	(194,690)
其他	(1,052)	66	-	(1,118)	(110)	-	(1,008)
	<u>\$ (110,137)</u>	<u>49,592</u>	<u>-</u>	<u>(159,729)</u>	<u>35,969</u>	<u>-</u>	<u>(195,698)</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇五年度。

(十三)資本及其他權益

1.股本

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	108.12.31	107.12.31
普通股股本溢價	\$ <u>142,309</u>	<u>142,309</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1) 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2) 特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3) 盈餘分派

本公司民國一〇七年度及一〇六年度盈餘分派案，分別於民國一〇八年五月二十九日及一〇七年五月二十八日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	107年度		106年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 4.70	1,062,991	4.10	927,290

(十四) 每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	108年度	107年度
基本每股盈餘：		
本期淨利	914,902	1,063,990
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	4.05	4.70
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	914,902	1,063,990
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
員工酬勞	1,756	2,335
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	227,924	228,503
稀釋每股盈餘(元)	4.01	4.66

(十五) 員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一〇八年度及一〇七年度員工酬勞估列金額分別為109,968千元及129,225千元，董事酬勞估列金額分別為12,019千元及14,248千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為129,225千元及14,248千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一〇六年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為111,567千元及12,286千元，皆係以現金發放，其中民國一〇六年度以董事酬勞科目發放為12,176千元，差異係估列計算之差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十六) 客戶合約之收入

1. 收入之細分

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
主要地區市場		
中國	\$ 2,972,782	3,331,122
臺灣	435,967	570,137
其他國家	<u>644,183</u>	<u>457,499</u>
	<u>\$ 4,052,932</u>	<u>4,358,758</u>
主要產品		
積體電路銷售	\$ 4,018,449	4,296,835
設計收入	<u>34,483</u>	<u>61,923</u>
	<u>\$ 4,052,932</u>	<u>4,358,758</u>

2. 合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十七) 營業外收入及支出

本公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
外幣兌換損失	\$ (8,432)	(3,977)
其他	<u>7,014</u>	<u>5,595</u>
	<u>\$ (1,418)</u>	<u>1,618</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十八)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險及集中狀況

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為2,598,804千元及2,997,897千元。

本公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

本公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日佔本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為635,855千元及410,501千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(2)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(三)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(五)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(本公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(六))。

2.流動性風險

除應付薪資及其他流動負債項下之應付費用外，其餘之金融負債之合約到期日分析：

	<u>帳面金額</u>	<u>合 約 現金流量</u>	<u>1年以內</u>	<u>超過1年</u>
108年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 416,878	416,878	416,878	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
租賃負債(含帳列其他流動負債)	<u>78,609</u>	<u>88,770</u>	<u>12,430</u>	<u>76,340</u>
	<u>\$ 504,029</u>	<u>514,190</u>	<u>429,308</u>	<u>84,882</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
107年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款	\$ 575,059	575,059	575,059	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
	<u>\$ 583,601</u>	<u>583,601</u>	<u>575,059</u>	<u>8,542</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險

匯率風險

(1)匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	108.12.31			107.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 2,505	29.93	74,988	10,924	30.665	334,987
人民幣	177,957	4.2781	761,317	162,242	4.4459	721,313
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 49,077	29.93	1,468,877	42,996	30.665	1,318,474
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 5,924	29.93	177,316	9,311	30.665	285,533
人民幣	7,167	4.2781	30,660	13,886	4.4459	61,737

(2)敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款、其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇八年度及一〇七年度之稅後淨利將分別增加或減少5,027千元及5,672千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於本公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇八年度及一〇七年度外幣兌換淨損失(含已實現及未實現)分別為8,432千元及3,977千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

本公司透過損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值及租賃負債，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

108.12.31					
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 491,203	491,203	-	-	491,203
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	589,358	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	838,251	-	-	-	-
其他金融資產—流動	674,250	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	5,742	-	-	-	-
	<u>\$ 2,598,804</u>	<u>491,203</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>491,203</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額	\$ 416,878	-	-	-	-
存入保證金	8,542	-	-	-	-
租賃負債(含帳列其他流動負債)	78,609	-	-	-	-
	<u>\$ 504,029</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107.12.31					
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 486,555	486,555	-	-	486,555
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	1,178,768	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	749,536	-	-	-	-
其他金融資產—流動	576,752	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	6,286	-	-	-	-
	<u>\$ 2,997,897</u>	<u>486,555</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>486,555</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

按攤銷後成本衡量之金融負債

應付票據及帳款(含關係人)

\$ 575,059

-

-

-

-

存入保證金

8,542

-

-

-

-

\$ 583,601

-

-

-

-

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

(3)民國一〇八年度及一〇七年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十九)財務風險管理

1.概要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

(1)信用風險

(2)流動性風險

(3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十八)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十八)。另，截至民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇八年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度150,750千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

本公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

- (2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(二十)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇八年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於報導日之負債權益比率如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
負債總額	\$ <u>1,164,251</u>	<u>1,247,665</u>
權益總額	\$ <u>4,052,665</u>	<u>4,199,170</u>
負債權益比率	<u>28.73%</u>	<u>29.71%</u>

(廿一)非現金交易之籌資活動

本公司於民國一〇八年度及一〇七年度之非現金交易籌資活動如下：

- 1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(八)。
- 2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	<u>租賃負債</u>
108年1月1日餘額	\$ -
追溯適用新準則之調整數	89,863
來自營業活動之現金流量變動	
利息支出	(1,176)
來自籌資活動之現金流量變動	
償還本金	(11,254)
非現金流量之變動	
利息費用	<u>1,176</u>
108年12月31日餘額	<u>\$ 78,609</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本個體財務報告之涵蓋期間內本公司之子公司及其他與本公司有交易之關係人如下：

<u>關係人名稱</u>	<u>與本公司之關係</u>
MCU Holdings Ltd. (MCU)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	本公司之合併子公司
Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	本公司之合併子公司
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	本公司之合併子公司
盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	本公司之合併子公司
Best Health Electronics Corp. (Best Health)	本公司之合併子公司
Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	本公司之合併子公司
悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	本公司之合併子公司
Anchip Technology Corporation (Anchip)	本公司之合併子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

關係人名稱	與本公司之關係
安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	本公司之合併子公司
Best Power Electronics Corp. (Best Power)	本公司之合併子公司
芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	本公司之合併子公司
合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	本公司之合併子公司
金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	本公司之合併子公司
優方科技股份有限公司(優方)	本公司之合併子公司
Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	本公司之合併子公司
優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	本公司之合併子公司
倍創科技股份有限公司(倍創)	本公司之合併子公司
芯通科技股份有限公司(芯通)(註1)	本公司之合併子公司
BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	本公司之合併子公司
芯通電子科技(東莞)有限公司(芯通東莞)	本公司之合併子公司
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	本公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	本公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	本公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	本公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	本公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	本公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	本公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	本公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	本公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	本公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	本公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	本公司之關聯企業
浚達科技有限公司(浚達)	本公司之關聯企業
高聖科技股份有限公司(高聖)(註2)	本公司之關聯企業
鉛威科技股份有限公司(鉛威)	本公司之關聯企業

註1：係盛通科技於民國一〇八年八月變更公司名稱。

註2：本公司之子公司盛凌於民國一〇八年五月將所持有之高聖科技股份有限公司之股權全數處分。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
合泰	\$ 586,707	-
HOLTEK(BVI)	405,302	784,925
欣宏合併子	339,689	512,531
優方合併子	306,727	455,152
其他	<u>1,537,358</u>	<u>1,601,100</u>
	<u>\$ 3,175,783</u>	<u>3,353,708</u>

本公司與合泰、芯群及金科之銷貨交易係透過第三地公司間接銷貨。

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至120天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日止，本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為213,730千元及172,043千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
HOLTEK(BVI)	\$ -	220,903
合泰	408,893	-
金科	119,138	-
芯群	107,824	-
欣宏合併子	38,938	96,514
優方合併子	9,529	93,263
其他	<u>87,956</u>	<u>255,857</u>
	<u>\$ 772,278</u>	<u>666,537</u>

2.進貨

本公司向關係人進貨金額如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
合併子公司	<u>\$ 6,712</u>	<u>9,447</u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司委託關係人提供積體電路銷售服務支出金額如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
合併子公司	\$ 29,278	15,584
關聯企業	<u>-</u>	<u>13</u>
	<u><u>\$ 29,278</u></u>	<u><u>15,597</u></u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付款項如下：

	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
應付帳款-合併子公司(帳列應付帳款-關係人)	\$ 10,622	4,816
其他應付款-關聯企業(帳列其他流動負債)	<u>-</u>	<u>17,630</u>
	<u><u>\$ 10,622</u></u>	<u><u>22,446</u></u>

3.其他交易

(1)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日，本公司因出售機器設備予合泰所產生之未實現利益分別為0千元及64千元，帳列採權益法之投資項下，已於民國一〇八年十二月三十一日全數實現。

(2)民國一〇八年度及一〇七年度本公司向合併子公司及關聯企業收取人力支援等服務之收入分別為2,412千元及0千元。本公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日分別為11,968千元及12,436千元，帳列其他金融資產—流動項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	<u>108年度</u>	<u>107年度</u>
短期員工福利	\$ 21,603	28,073
退職後福利	<u>432</u>	<u>432</u>
	<u><u>\$ 22,035</u></u>	<u><u>28,505</u></u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>108.12.31</u>	<u>107.12.31</u>
定期存款(帳列其他 金融資產—流動)	進口關稅保證金	<u><u>\$ 5,118</u></u>	<u><u>3,612</u></u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	108年度			107年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	28,974	506,969	535,943	30,468	569,315	599,783
勞健保費用	2,345	35,215	37,560	2,227	34,307	36,534
退休金費用	1,495	22,222	23,717	1,595	22,615	24,210
董事酬金	-	12,019	12,019	-	14,138	14,138
其他員工福利費用	1,460	16,915	18,375	1,430	16,942	18,372
折舊費用	3,227	46,861	50,088	2,753	30,494	33,247
攤銷費用	16	72,593	72,609	-	54,186	54,186

本公司民國一〇八年度及一〇七年度員工人數及員工福利費用額外資訊如下：

	108年度	107年度
員工人數	415	407
未兼任員工之董事人數	4	4
平均員工福利費用	\$ 1,498	1,684
平均員工薪資費用	\$ 1,304	1,488
平均員工薪資費用調整情形	(12)%	

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇八年度本公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產一流 動	10,966	168,477	-	168,477	
本公司	統一強棒貨幣市場 基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產一流 動	15,616	262,000	-	262,000	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
本公司	元大得寶貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,034	60,726	-	60,726	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	2,500	68,627	5.00 %	68,627	
盛凌投資股份有限公司	諧永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	23,124	206,714	3.03 %	206,714	
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	3,330	26,964	12.33 %	26,964	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	金科	本公司之子公司	銷貨	(206,378)	(5) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	119,138	14 %	(註)
金科	本公司	金科之母公司	進貨	206,378	100 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(119,138)	(87) %	(註)
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(405,302)	(10) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	(註)
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	405,302	100 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	(註)
本公司	芯群	本公司之子公司	銷貨	(180,497)	(4) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	107,824	13 %	(註)
芯群	本公司	芯群之母公司	進貨	180,497	78 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(107,824)	(86) %	(註)
本公司	Santek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(103,903)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	6,402	1 %	
Santek	本公司	對Santek採權益法評價之投資公司	進貨	103,903	55 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(6,402)	(17) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(339,689)	(8) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	38,938	5 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	339,689	41 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(38,938)	(29) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(185,673)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	5,938	1 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	185,673	53 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(5,938)	(12) %	
本公司	銘威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(153,496)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	31,846	4 %	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
鈺成	本公司	對鈺成採權益法評價之投資公司	進貨	153,496	8 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(31,846)	(18) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(306,727)	(8) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	9,529	1 %	(註)
優方	本公司	優方之母公司	進貨	306,727	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(9,529)	(100) %	(註)
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(129,484)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	129,484	32 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	-	- %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(157,391)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,352	2 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	157,391	42 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,352)	(20) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(108,147)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	2,890	- %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	108,147	17 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(2,890)	(2) %	
本公司	合泰	本公司之子公司	銷貨	(586,707)	(14) %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	408,893	49 %	(註)
合泰	本公司	合泰之母公司	進貨	586,707	84 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(408,893)	(91) %	(註)

註：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵銷售金額
					金 額	處理方式		
本公司	合泰	子公司	408,893 (註2)	2.87	-	即期收款	107,354 (註1)	-
本公司	金科	子公司	119,138 (註2)	3.46	-	即期收款	- (註1)	-
本公司	芯群	子公司	107,824 (註2)	3.35	-	即期收款	- (註1)	-

註1：係截至民國一〇九年一月十七日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇八年本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	608,165	94,549	94,549 註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	127,433	11,287	11,287 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	23,030	798	798 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA), INC.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	23,030	798	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	710,248	73,761	73,761 註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	Foric Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	20,877	422	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Foric Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	8,578	437	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
Foric Electronics Holding Ltd.	ForIC Electronics HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術支持與諮詢服務	866	-	200	100.00 %	1,454	615	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	51,962	24,314	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Truetek Technology Ltd.	Truetek Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術研發與諮詢服務	8,662	-	2,000	100.00 %	11,837	3,262	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	1,868	1,868	60	40.00 %	23,834	15,003	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Quanding Technology Holding Ltd.	Quanding Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術研發與諮詢服務	2,137	-	500	100.00 %	2,049	(90)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	24,392	23,555	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Santek Holdings Ltd.	Santek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	-	2,000	100.00 %	8,702	93	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc	B.V.I.	投資海外各項事業	3,470	3,470	800	40.00 %	22,286	1,130	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newwave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	67,517	26,053	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	62,314	16,769	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Newtek Electronics Ltd.	Newtek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	-	2,000	100.00 %	12,895	43,673	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	65,018	36,973	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	1,850	(1,107)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	4,691	3,891	註1,2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濤高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,254	2,930	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	宏達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	7,884	11,987	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,405	3,664	1	40.00 %	6,253	1,383	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	20,965	20,965	5	80.00 %	24,555	5,195	註1,2	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片的技術支持與諮詢服務	1,299	-	300	100.00 %	3,069	1,796	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	8,844	8,844	2	100.00 %	8,746	149	註1,2	本公司之孫公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機蕊片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	1	(121)	- 註2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	507,733	7,625	7,625 註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	113,968	20,934	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	59,204	59,204	2,000	100.00 %	69,413	4,985	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	43,810	43,810	800	100.00 %	46,057	6,388	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	14,254	10,644	註1	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	鈺威科技股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,865	22.39 %	70,768	14,740	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	-	2,350	-	- %	-	1,158	註1,3	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	15,462	10,644	註1,2	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,140	6,140	200	100.00 %	26,748	3,625	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
盛凌投資股份有限公司	天宇微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	156	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	芯通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、國際貿易業及資訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	13,787	(7,824)	註1,2,4	本公司之孫公司
芯通科技股份有限公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	14,054	14,054	30	100.00 %	6,189	(4,548)	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無店面零售業、國際貿易業	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,020	(875)	註1,2	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	1,482	(121)	註1,2	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：本公司於民國一〇八年五月將所持有之高聖科技股份有限公司之股權全數處分。

註4：係盛通科技於民國一〇八年八月變更公司名稱。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被 投資公 司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 投資損益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	10,359	100 %	10,359 (註5)	119,164	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元器件及單片機芯片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	84,616	100 %	84,616 (註5)	396,894	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(3,195)	40 %	(1,278)	14,448	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	(5,947)	40 %	(2,379) (註5)	12,981	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	21,577	40 %	8,631 (註5)	42,334	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(6,479)	40 %	(2,591)	9,041	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(83)	40 %	(33)	6,295	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	3,537	40.61 %	1,436 (註5)	31,685	-
信霖電子商務(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(3,396)	40 %	(1,358)	43,287	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	10,443	(註1)	1,964	-	-	1,964	14,163	40 %	5,665 (註5)	70,189	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	4,980	40 %	1,992	23,064	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	11,288	100 %	11,288 (註5)	127,394	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(350)	40 %	(140)	2,359	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	980	60 %	588	1,615	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	1,427	40 %	571	5,588	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(5,118)	80 %	(4,094)	9,644	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	9,214	(註1)	-	-	-	-	(5,246)	100 %	(5,246) (註5)	1,055	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	4,284	(註1)	-	-	-	-	(1,823)	54.75 %	(998) (註5)	2,462	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註4)
471,089 (美金15,111千元)	524,934 (美金17,539千元)	2,431,599

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計450,555千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計74,379千元(美金2,485千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。限額計算為淨值4,052,665千元 $\times 60\% = 2,431,599$ 千元。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師查核之財務報告認列投資損益。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇八年與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇八年度合併財務報告。

盛群半導體股份有限公司



負責人： 吳啟勇

